

公司代码：688521

公司简称：芯原股份



芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司合并报表累计未分配利润为-24.16 亿元，母公司财务报表累计未分配利润为-6.34 亿元，且经营性现金流量净额为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会审议通过，尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标10

第三节 管理层讨论与分析 15

第四节 公司治理 90

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 114

第六节 重要事项 126

第七节 股份变动及股东情况 157

第八节 优先股相关情况 164

第九节 债券相关情况 165

第十节 财务报告 166

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、芯原、芯原股份	指	芯原微电子（上海）股份有限公司
芯原有限	指	芯原微电子（上海）有限公司，公司的前身
美国思略	指	美国思略科技有限公司（Celestry Design Technologies, Inc.）
图芯上海	指	图芯芯片技术（上海）有限公司，公司的境内子公司
图芯美国	指	Vivante Corporation，原名为 Giquila Corporation，公司的美国子公司
芯原成都	指	芯原微电子（成都）有限公司，公司的境内子公司
芯原北京	指	芯原微电子（北京）有限公司，公司的境内子公司
芯原南京	指	芯原微电子（南京）有限公司，公司的境内子公司
芯原海南	指	芯原微电子（海南）有限公司，公司的境内子公司
芯原科技	指	芯原科技（上海）有限公司，公司的境内子公司
芯思原	指	芯思原微电子有限公司，公司的境内联营企业
台湾分公司	指	香港商芯原有限公司台湾分公司，公司的中国台湾分公司
芯原开曼	指	VeriSilicon Holdings Co., Ltd.，原名为 VeriSilicon Holdings (Cayman Island) Co.,Ltd.，报告期内曾经为公司前身的唯一股东，为公司在开曼设立的境外子公司
芯原香港	指	VeriSilicon (HongKong) Limited，公司的中国香港子公司
芯原美国	指	VeriSilicon, Inc.，公司的美国子公司
共青城原天	指	共青城原天投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原厚	指	共青城原厚投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原德	指	共青城原德投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
兴橙投资	指	上海兴橙投资管理有限公司
VantagePoint	指	Vantage Point Venture Partners 2006(Q), L.P.，公司股东
SVIC No.33	指	SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P.，公司首次公开发行前股东
Jovial	指	Jovial Victory Limited，公司首次公开发行前股东
Intel	指	Intel Capital (Cayman) Corporation，公司首次公开发行前股东
IDG	指	IDG Technology Venture Investments, LP，公司首次公开发行前股东
Anemoui	指	Anemoui Capital Limited，公司首次公开发行前股东
SVIC No.25	指	SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P.，公司首次公开发行前股东
IDG III	指	IDG Technology Venture Investment III, L.P.，公司首次公开发行前股东
Focuspower	指	Focuspower Investment Inc.，公司首次公开发行前股东
IDG IV	指	IDG Technology Venture Investment IV L.P.，公司首次公开发行前股东
华电联网	指	华电联网股份有限公司，公司首次公开发行前股东

Miven	指	Miven Venture Partners Fund I, LLC，公司首次公开发行前股东
Korus	指	Koruspartners，公司首次公开发行前股东
上海艾欧特	指	上海艾欧特投资有限公司，公司首次公开发行前股东
申毅创合	指	宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
西藏德远	指	西藏德远实业有限公司，公司首次公开发行前股东
兴橙投资方	指	共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：嘉兴海橙投资合伙企业（有限合伙））、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）中的一家/几家或全体，视上下文而定
嘉兴君祥	指	嘉兴君祥投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
嘉兴君朗	指	嘉兴君朗投资管理合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
合肥华芯	指	合肥华芯宜原投资中心合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司，公司首次公开发行前股东
浦东新兴	指	上海浦东新兴产业投资有限公司，公司首次公开发行前股东
共青城原道	指	共青城原道投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原酬	指	共青城原酬投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原勤	指	共青城原勤投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原载	指	共青城原载投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原物	指	共青城原物投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原吉	指	共青城原吉投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
隆玺壹号	指	广州隆玺壹号投资中心（有限合伙），公司首次公开发行前股东
小米基金	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
华为	指	华为投资控股有限公司或其有关实体
英特尔	指	Intel Corporation
博世	指	Robert Bosch GmbH 或其有关主体
恩智浦	指	NXP USA, Inc.
香港比特	指	HongKong Bite Co., Limited，为亿邦国际全资子公司
新思科技	指	Synopsys International Limited
格罗方德	指	GlobalFoundries U.S. Inc.或其有关主体，现更名为格芯
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd.或其有关实体
铿腾电子	指	Cadence Design Systems, Inc.
亚马逊	指	亚马逊公司（Amazon com, Inc.），美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：AMZN.O）或其有关实体
报告期、报告期内	指	自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止的期间
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日

证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》
A 股	指	获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
中国香港	指	中国香港特别行政区
中国台湾	指	中国台湾地区
中国、境内	指	中华人民共和国，为本报告之目的，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
半导体器件	指	利用半导体材料特殊电特性完成特定功能电子器
芯片、集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
晶圆、晶圆片	指	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
裸片、芯片裸片	指	Die，晶圆经过切割测试后没有经过封装的芯片
芯片设计	指	包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
芯片封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
芯片测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
工艺节点、制程	指	集成电路内电路与电路之间的距离，精度越高，同等功能的 IC 体积越小、成本越低、功耗越小，当前工艺节点已达 nm 级
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，需要进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程试作样片流片。在工程试作样片流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
RTL	指	Register-Transfer Level，即寄存器转换级电路描述，是芯片设计中的一种实现形式
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，指原始设备制造商，意为通常拥有充裕、廉价的劳动力，提供国际市场所需的制造、组装产品之委托服务的厂商，即代工厂
系统厂商	指	面向终端应用提供整机系统设备的厂商，本报告中系统厂商包括 OEM 和 ODM
芯片设计公司	指	无晶圆生产设计公司，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门从事晶圆加工代工的工厂、企业
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进

		行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商
IP、半导体 IP	指	Semiconductor Intellectual Property，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
处理器 IP	指	用于完成取指令、执行指令，以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作的数字 IP
模拟 IP	指	基于晶圆厂工艺的，用于处理连续性的光、声音、速度、温度等自然模拟信号的 IP
内核	指	处理器 IP 指令集架构的电路实现，是处理器 IP 的一部分
卷积运算核	指	一种电路实现，主要由数量可配置的乘加器及储存单元组成，目的是进行高效的神经网络加速运算，是 NPU IP 的一部分
FinFET	指	Fin Field-Effect Transistor 简称，又称鳍式场效应晶体管，是一种新的互补式金氧半导体晶体管，一种集成电路制造工艺
FD-SOI	指	Fully Depleted-Silicon-On-Insulator，即完全耗尽型绝缘体上硅，是一种实现平面晶体管结构的工艺技术，具有减少硅几何尺寸同时简化制造工艺的优点
CPU	指	Central Processing Unit，微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术。本报告中，传统 CMOS 指平面基体型 CMOS 工艺
GPU IP	指	图形处理器 IP，专用于绘图运算工作的数字 IP
NPU IP	指	神经网络处理器 IP，专用于加速神经网络运算、机器视觉和机器学习等人工智能应用的数字 IP
VPU IP	指	视频处理器 IP，专用于进行视频编解码，并结合视频增强处理和压缩技术的数字 IP
DSP IP	指	数字信号处理器 IP，专用于将数字信号进行高速实时处理的数字 IP
ISP IP	指	图像信号处理器 IP，专用于对图像传感器的原始数据进行处理以获得优质视觉图像的数字 IP
Display Processing IP	指	显示处理器 IP，是一种进行图像显示处理的数字 IP
RFIP、射频 IP	指	射频IP指用于处理由天线发送接收的一定频率射频信号的IP
SoC、系统级芯片	指	System on Chip，即片上系统，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
蓝牙、经典蓝牙、Bluetooth	指	一种支持设备短距离通信（一般 10m 内）的 2.4GHz 无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
低功耗蓝牙、BLE	指	Bluetooth Low Energy，与经典蓝牙使用相同的 2.4GHz 无线电频率的一种局域网技术，旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴领域
SerDes	指	Serializer（串行器）/Deserializer（解串行器），是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术
传感器	指	Sensor，用于侦测环境中所生事件或变化，并将此讯息传出至其他电子设备（如 CPU）的装置，通常由敏感元件和转换元件组成
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
版图	指	Integrated Circuit Layout，集成电路版图，是真实集成电路物

		理情况的平面几何形状描述。
布图设计	指	集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程
纳米（nm）	指	长度单位，1nm（纳米）=0.001μm（微米）
fps	指	Frames Per Second，每秒帧数，每秒钟帧数愈多，所显示的动作就会越流畅
RISC	指	Reduced Instruction Set Computer 的缩写，精简指令集计算机，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高
RISC-V	指	基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件
EDA 工具	指	Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具
MCU、微控制器、单片机	指	Microcontroller Unit，即微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。
存储器、存储芯片、Memory	指	电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。例如计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息
HD	指	High Definition，即通常意义上的高清，分辨率在 720p 或以上
SDK	指	Software Development Kit，即软件开发工具包
物联网、IoT	指	一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
AI、人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
Linux	指	一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议
VP9	指	由谷歌开发的开放格式的视频压缩标准
AVS	指	Audio Videocoding Standard，即音频视频编码标准，是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准，是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称，其包括系统、视频、音频、数字版权管理等四个主要技术标准和符合性测试等支撑标准
4K	指	一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 4096×2160 像素
8K	指	一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 7680×4320 像素
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
大数据	指	巨型多元化的数据集，可透过新处理模式，发掘隐藏模式、未知的关连、市场趋势、客户喜好及其他有用信息资产，增强决策力、洞察力及处理优化能力
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。

		它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会。
IC Insights	指	IC Insights, Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司
IPnest	指	知名 IP 领域调研机构
IBS	指	International Business Strategies，国际商业战略公司
2020 年限制性股票激励计划	指	芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
2022 年限制性股票激励计划	指	芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
Chiplet	指	预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，是半导体 IP 在硅级别的实现
云服务	指	基于云计算而为用户提供服务
TWS	指	True Wireless Stereo 的缩写，即真正无线立体声，TWS 技术是基于蓝牙芯片技术的应用发展
边缘人工智能	指	将人工智能技术和边缘计算能力相结合，使人工智能算法运行在可进行边缘计算的设备上而不必上传云端进行处理
Sub1G	指	频率为 1GHz 以下
GNSS	指	所有导航定位卫星的总称，凡是可以通过捕获跟踪其卫星信号实现定位的系统，均可纳入 GNSS 系统的范围
Alphawave	指	Alphawave IP Inc.
LVGL	指	Light and Versatile Graphics Library，是一个轻量级、多功能的开源嵌入式图形库，用于为微控制器和嵌入式系统创建图形用户界面（GUI）
新基讯	指	上海新基讯通信技术有限公司
赛昉科技	指	上海赛昉半导体科技有限公司
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
威视芯	指	威视芯半导体（合肥）有限公司
智瀚星途	指	智瀚星途（苏州）科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	芯原微电子（上海）股份有限公司
公司的中文简称	芯原股份
公司的外文名称	VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	VeriSilicon
公司的法定代表人	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
公司办公地址的邮政编码	201203

公司网址	http://www.verisilicon.com/
电子信箱	IR@verisilicon.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施文茜	石为路
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
电话	021-68608521	021-68608521
传真	021-68608889	021-68608889
电子信箱	IR@verisilicon.com	IR@verisilicon.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯原股份	688521	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	陈颂、黄宇翔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的保荐代表人姓名	陈启明、邬凯丞
	持续督导的期间	处于募集资金持续督导期间

注 1：2024 年 2 月，公司变更持续督导机构及保荐代表人，由海通证券股份有限公司担任公司持续督导机构，陈启明先生、邬凯丞先生为签字的保荐代表人。报告期初至 2024 年 2 月，由招商证券股份有限公司担任公司持续督导机构。

注 2：2025 年 4 月，海通证券股份有限公司存量客户与业务整体迁移并入国泰海通证券股份有限公司，海通证券股份有限公司承接的投资银行业务均由国泰海通证券股份有限公司完整承继，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行。

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	2,321,885,572.72	2,337,996,408.69	-0.69	2,678,990,094.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,316,975,603.43	2,328,953,201.99	-0.51	2,673,538,781.81
归属于上市公司股东的净利润	-600,879,358.50	-296,466,724.17	不适用	73,814,259.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-643,427,174.53	-318,070,037.57	不适用	13,290,603.50
经营活动产生的现金流量净额	-345,990,209.33	-8,523,893.46	不适用	-329,457,559.81
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,122,317,675.16	2,700,293,620.73	-21.40	2,907,220,371.57
总资产	4,629,859,316.97	4,406,380,975.42	5.07	4,426,160,135.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-1.20	-0.59	不适用	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	-1.20	-0.59	不适用	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.29	-0.64	不适用	0.03
加权平均净资产收益率（%）	-24.98	-10.54	减少14.45个百分点	2.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-26.75	-11.30	减少15.45个百分点	0.47
研发投入占营业收入的比例（%）	53.72	40.82	增加12.90个百分点	31.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现营业收入 23.22 亿元，与上年度基本持平。2024 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润-6.01 亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-6.43 亿元。
截至 2024 年末，公司总资产为 46.30 亿元、归属于上市公司股东的净资产为 21.22 亿元。公司报
告期内经营情况分析详见“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

八、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	318,132,960.41	613,862,278.16	717,976,225.54	671,914,108.61
归属于上市公司股东的 净利润	-206,983,900.85	-77,820,811.37	-111,053,782.15	-205,020,864.13
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-216,223,015.61	-88,257,688.41	-117,598,698.86	-221,347,771.65
经营活动产生的现金流 量净额	-217,432,979.47	-119,820,284.43	-56,127,749.58	47,390,804.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注 (如适 用)	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括	796.50		-80,364.68	2,980.26

已计提资产减值准备的冲销部分				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	43,064,097.16		43,030,832.04	20,792,825.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,791,192.44		-18,299,176.05	37,547,008.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的				

或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,222,111.68		1,495,022.07	3,166,916.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
合营/联营企业政府补助影响	897,200.21		2,468,252.10	5,038,724.50
减：所得税影响额	7,427,581.96		7,011,252.08	6,024,799.07
少数股东权益影响额（税后）				
合计	42,547,816.03		21,603,313.40	60,523,655.86

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
☐适用 ☒不适用

十、非企业会计准则财务指标情况

☐适用 ☒不适用

十一、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	400,130,371.00	112,275,721.57	-287,854,649.43	5,302,153.94
其他非流动金融资产	199,633,824.73	201,122,863.23	1,489,038.50	-510,961.50
合计	599,764,195.73	313,398,584.80	-286,365,610.93	4,791,192.40

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

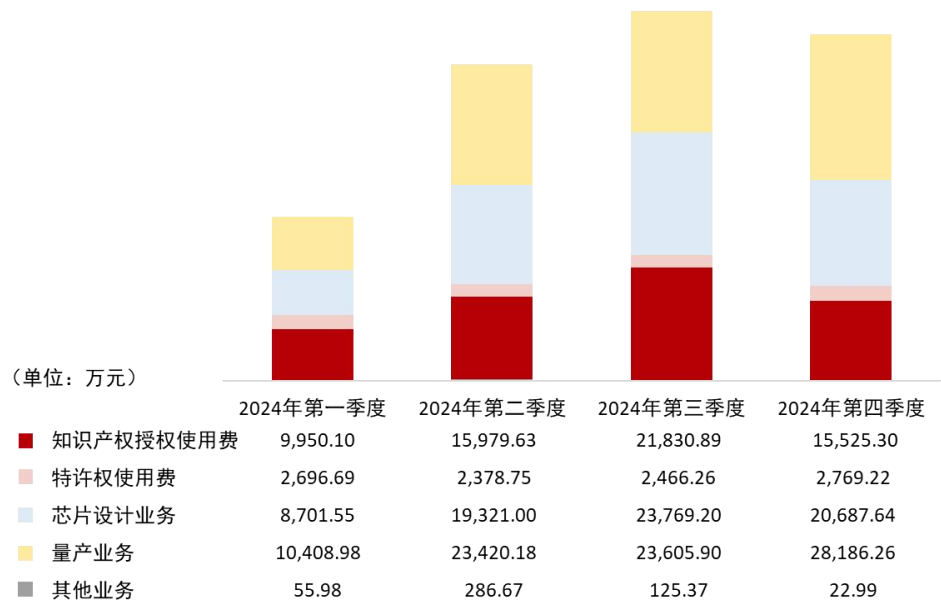
一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要财务表现

1、营业收入情况

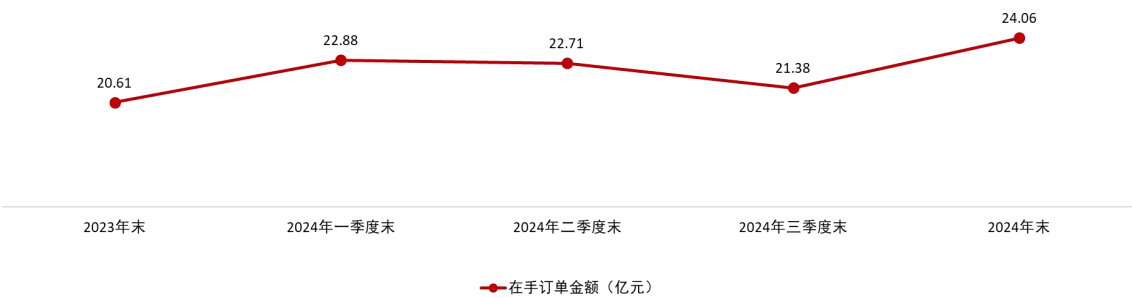
2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年第三季度收入新高，同

比增长 23.60%，第四季度收入同比增长超 17%，全年实现营业收入 23.22 亿元，基本与 2023 年持平。



图：2024 年各季度营业收入（按业务划分）构成情况

截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年第四季度公司新签订单超 10.8 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 50%，较 2023 年下半年同比提升超 48%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 80%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。



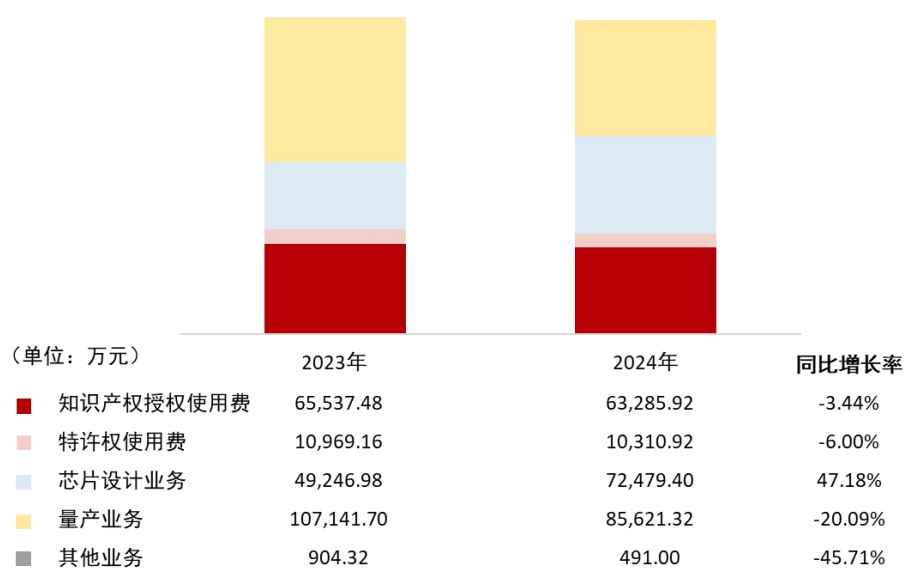
图：近期公司在手订单情况

2024 年度，公司主要财务表现具体情况如下：

(1) 业务构成情况分析

2024 年度，公司实现半导体 IP 授权业务收入（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）7.36 亿元，同比下降 3.80%，一站式芯片定制业务收入（包括芯片设计业务收入、量产业务收入）15.81 亿元，同比增长 1.09%。

2024 年下半年，公司芯片设计业务收入同比增长 81.00%，知识产权授权使用费业务收入同比增长 20.52%，量产业务收入同比下降 4.03%。2024 年第四季度，公司芯片设计业务收入同比增长 80.70%，知识产权授权使用费业务收入同比下降 28.23%，量产业务收入同比增长 32.05%，体现了公司收入受行业下行周期影响较晚、恢复增长较早的特点。



图：2024 年度营业收入（按业务划分）构成情况

① 半导体 IP 授权业务

报告期内，公司知识产权授权使用费收入 6.33 亿元，同比下降 3.44%，半导体 IP 授权次数 216 次，较 2023 年增加 82 次。芯原的处理器 IP 系列产品能够满足多样的人工智能计算需求，报告期内公司与 AI 算力相关的知识产权授权使用费收入为 2.56 亿元，占比约 40%。报告期内，公司特许权使用费收入 1.03 亿元，同比下降 6.00%。

在芯原的核心处理器 IP 相关营业收入中，图形处理器 IP、神经网络处理器 IP 和视频处理器 IP 收入占比较高，这三类 IP 在 2024 年度半导体 IP 授权业务收入（包括知识产权授权使用费收入、特许权使用费收入）中占比合计约七成，上述 IP 已获得国内外众多知名企业的广泛采用，在各应用领域发挥了重要作用。

- 芯原图形处理器（GPU）IP 已经耕耘嵌入式市场近 20 年，在多个市场领域中获得了客户的采用，包括数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC 等，内置芯原 GPU 的客户芯片

已在全球范围内出货近 20 亿颗。

- 芯原神经网络处理器（NPU）IP 已被 82 家客户用于其 142 款人工智能芯片中，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，这些内置芯原 NPU 的芯片主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 余个市场领域，奠定了芯原在人工智能领域全球领先的根基。
- 芯原视频处理器（VPU）IP 已被中国前 5 大互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 大云平台解决方案提供商中的 12 家所采用。通过引入超分辨率、高清图像增强处理，以及视频去抖动方案，芯原正在进一步增强和扩展其数据中心智能像素处理 IP 平台的能力。

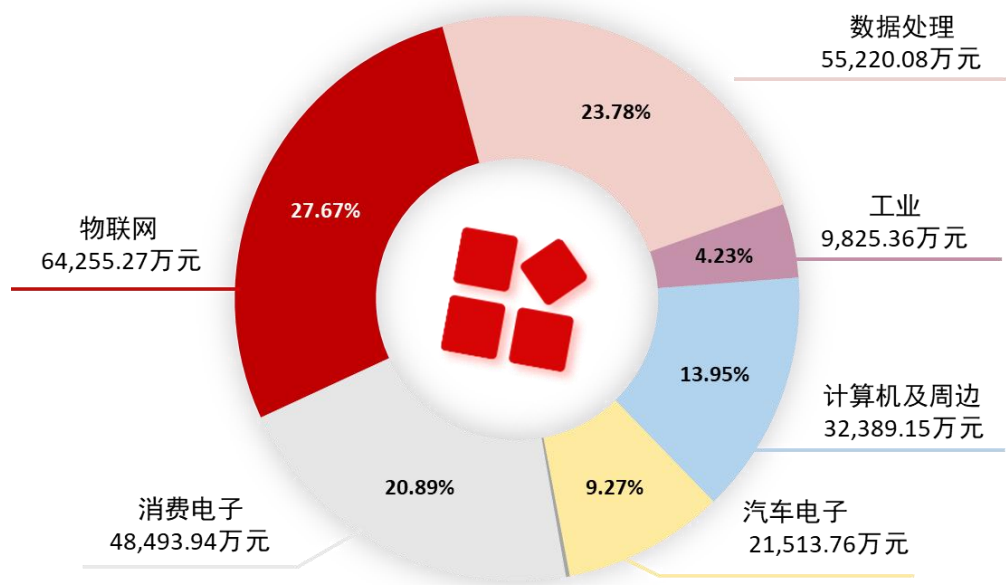
② 一站式芯片定制业务

报告期内，公司实现芯片设计业务收入 7.25 亿元，同比增长 47.18%，其中 28nm 及以下工艺节点收入占比 96.50%，14nm 及以下工艺节点收入占比 84.99%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目 85 个，其中 28nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 57.65%，14nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 32.94%。报告期内，公司与 AI 算力相关的芯片设计业务收入为 4.95 亿元，占比约 68%。

报告期内，公司实现量产业务收入 8.56 亿元，同比下降 20.09%。报告期内，为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量 98 款，均来自公司自身设计服务项目，另有 33 个现有芯片设计项目待量产。公司报告期内量产业务收入下降主要系部分下游客户受到去库存周期影响，2023 年上半年新签订单较少；自 2023 年末起，下游客户库存情况已明显改善，公司量产业务新签订单迅速恢复并维持于较高水平，2024 年新签订单合计 12.05 亿元（2024 年第四季度新签订单超 6 亿元），较 2023 年大幅增长超 180%，为未来量产业务收入奠定基础。

（2）下游应用领域分析

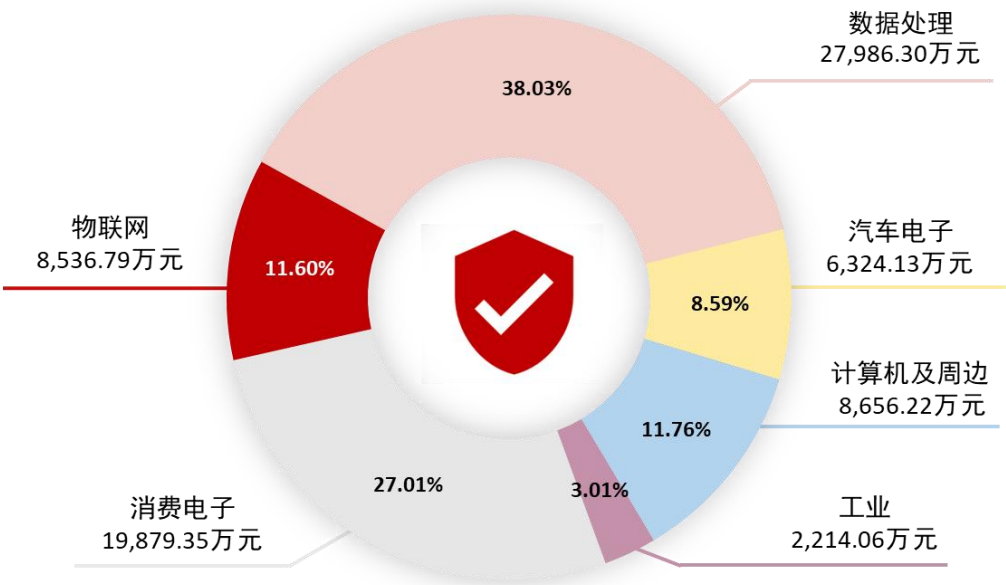
报告期内，受 AI 算力等市场需求带动，公司数据处理领域、计算机及周边领域、汽车电子领域分别实现收入 5.52 亿元、3.24 亿元、2.15 亿元，同比分别上涨 75.46%、64.07%、37.32%。上述领域收入占营业收入比重分别为 23.78%、13.95%、9.27%，收入占比同比分别提升 10.32、5.51、2.56 个百分点。



图：2024 年度营业收入（按下游不同行业划分）构成情况

① 半导体 IP 授权业务（包括知识产权授权使用费、特许权使用费收入）下游应用领域情况

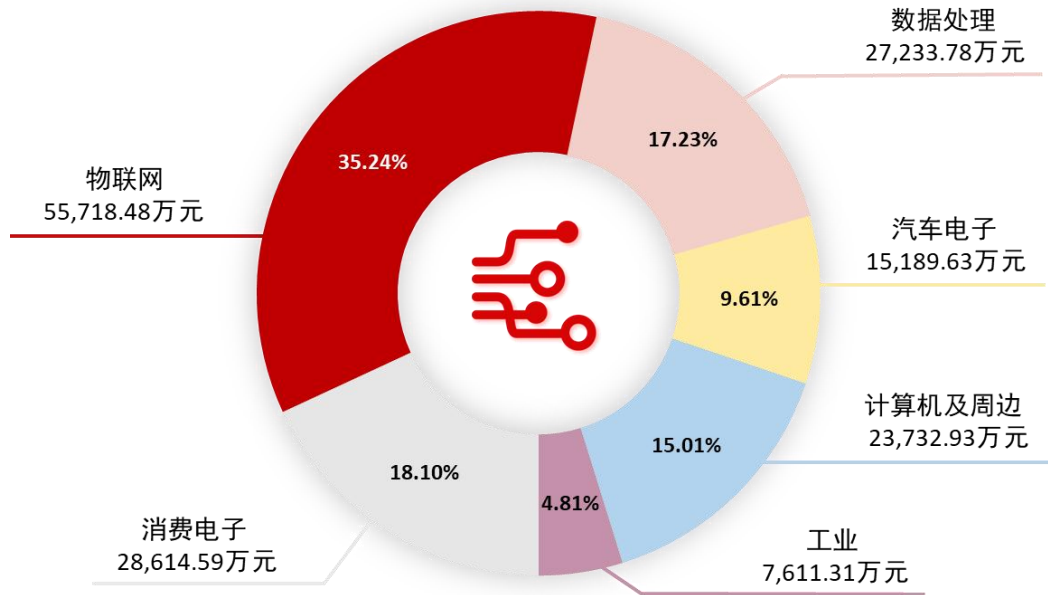
报告期内，公司半导体 IP 授权业务应用于数据处理领域的收入占半导体 IP 授权业务整体营业收入的 38.03%，同比提升 8.38 个百分点；应用于消费电子领域的收入占半导体 IP 授权业务整体营业收入的 27.01%，同比基本持平。



图：2024 年度半导体 IP 授权业务收入（按下游不同行业划分）构成情况

② 一站式芯片定制业务（包括芯片设计业务、量产业务收入）下游应用领域情况

报告期内，公司一站式芯片定制业务应用于物联网领域的收入占一站式芯片定制业务整体营业收入的 35.24%；应用于数据处理领域、计算机及周边领域的收入分别占一站式芯片定制业务整体营业收入的 17.23%、15.01%，同比分别提升 11.60、9.56 个百分点。



图：2024 年一站式芯片定制业务收入（按下游不同行业划分）构成情况

（3）按地区构成分析

2024 年度，公司实现境内销售收入 14.53 亿元，同比下降 19.59%，占营业收入比重为 62.57%，较去年同期下降 14.71 个百分点；公司境外市场逐步复苏，实现境外销售收入 8.69 亿元，同比提升 63.59%，占营业收入比重为 37.43%。

（4）客户群体及数量分析

随着公司提供硬件和软件完整系统解决方案的能力不断提升，迎合了系统厂商、互联网企业、云服务提供商和车企等客户群体的需求，2024 年度来自上述非芯片公司客户群体的收入达到 9.17 亿元，占总收入比重约四成。

2024 年度，公司半导体 IP 授权服务新增客户数量 33 家，截至报告期末累计半导体 IP 授权服务客户总数量超 445 家；一站式芯片定制服务新增客户数量 12 家，截至报告期末累计一站式芯片定制服务客户总数量超 330 家。

（5）在手订单分析

截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较第三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年第四季度公司新签订单超 10.8 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 50%，较 2023 年下半年同

比提升超 48%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 80%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

2、毛利及毛利率情况

2024 年度，公司实现毛利 9.26 亿元，同比下降 11.54%。公司 2024 年综合毛利率 39.86%，较去年同期下降 4.89 个百分点，主要由于收入结构变化及一站式芯片定制业务毛利率下降等因素所致。

3、期间费用情况

2024 年度，公司期间费用合计 14.97 亿元，同比增长 27.20%。经过 20 多年的持续高研发投入，公司已经拥有丰富且优质的人才和技术储备，并在别的公司不招人、少招人的情况下，芯原逆向思维，在 2024 届校招中近 1 万人进行了全球统一在线笔试，约 1,800 人进入面试环节，公司最终录取了 200 多名应届毕业生，其中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，去年招聘的应届毕业生已完成内部培训并对今年已经展开和正要承接的多个芯片大项目提供了必要的人力资源。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。因此，长期来看，一定规模人才储备是公司生存和发展的关键，为公司下一阶段做好充分的准备。

公司潜心投入关键应用领域技术研发，如五年前开始布局 Chiplet 技术及其在生成式人工智能和智慧驾驶上的应用。公司在三年前就开始研发超轻量、超低功耗的 AI/AR 眼镜芯片设计平台，为全球知名的互联网企业定制了 AR 眼镜专用芯片，还与其始终在线的开源项目展开深度合作，形成了完整的技术平台。

在产业下行周期客户项目短期有所减少，公司较以往加大了研发投入的比重，2024 年度研发费用同比增加约 32%。随着公司芯片设计业务订单增加，2024 年下半年芯片设计业务收入同比大幅增加约 81%，研发资源已逐步投入至客户项目中，预计未来公司研发投入比重将会下降，恢复到正常水平。目前公司已积累了充分的技术和人力资源，技术能力业界领先，并持续获得全球优质客户的认可。

（二）报告期内经营管理主要工作

1、依托资本市场，开展资本运作，向特定对象发行股票事项已获注册批文

公司于 2024 年 1 月经 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年 12 月经 2024 年第三次临时股东大会审议通过 2023 年度向特定对象发行股票事项（以下简称“向特定对象发行股票”），相关发行 A 股股票申请已于 2025 年 2 月通过上海证券交易所审核，并于 2025 年 3 月收到中国证监会的注册批文。公司董事会将按照注册批文和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

公司向特定对象发行股票事项拟募集不超过 180,685.69 万元（含本数），募集资金投资投向为 AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目和面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目。

“AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目”，将针对数据中心、智慧出行等市场需求，从 Chiplet 芯片架构等方面入手，使公司既可持续从事半导体 IP 授权业务，同时也可升级为 Chiplet 供应商，充分结合公司一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的技术优势，提高公司的 IP 复用性，有效降低了芯片客户的设计成本、风险和研发迭代周期，可以帮助客户快速开发自己的定制芯片产品并高效迭代，发展核心科技基础，保障产业升级落实。

“面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目”，将通过研发新一代自主可控的高性能 IP，包括面向 AIGC 和数据中心应用的高性能图形处理器（GPU）IP、AIIP、新一代集成神经网络加速器的图像信号处理器 AI-ISP 等，增强我国自主研发设计具备高性能芯片的能力，为本土集成电路设计企业提供自主可控的 IP 授权，推动国内集成电路设计产业高质量发展，同时致力于打造完善的应用软件生态系统，满足下游市场大模型研发对高性能、低能耗的技术需求。

通过本次向特定对象发行股票，公司将借助资本市场平台增强资本实力、优化资产负债结构，本次募投项目将在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础，有利于增强公司的核心竞争力、提升盈利能力，为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值，推动公司长远发展。报告期内，公司已根据上述项目实施安排开始投入研发工作，目前已稳步取得阶段性进展，相关研发工作将持续推进。

2、持续核心技术研发，不断迭代升级

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

1) AIGC 应用领域

截至报告期末，芯原全球领先的 NPU IP 已在 82 家客户的 142 款芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货超过 1 亿颗。报告期内，芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。

公司基于约 20 年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的 GPGPU IP 可提供从低功耗嵌入式设备到高性能服务器的计算能力，以高度可扩展的 IP 核重新定义了计算市场，以满足广泛的人工智能计算需求。报告期内，芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内获得了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。报告期内，公司还推出了全新 Vitality 架构的 GPU IP 系列，集成了诸多先进功能，如一个可配置的张量计算核心（Tensor Core）AI 加速器和一个 32MB 至 64MB 的三级（L3）缓存，提供强大的处理能力和出色的能效表现，并支持多核扩展，广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等应用领域。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，报告期内，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。目前公司还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

2) 数据中心领域

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 12 家的采用。目前，公司面向数据中心应用的视频转码平台项目进展顺利，第一代平台已于 2021 年第二季度完成研发工作，并以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得多家客户的采用，已完成适配并陆续量产；目前，基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K，增加了对 AV1 格式的支持，并新增了 AI 处理能力，此外，还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。

报告期内，芯原推出面向下一代数据中心的全新 VC9800 系列 IP，该系列 IP 具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力，可支持最高 256 路码流，并兼容所有的主流视频格式，包括新一代先进格式 VVC 等；该系列 IP 还可针对 AI 计算，与芯原的 NPU IP 实现无缝交互，达到了 OpenCV 级别的精度，并在视频处理子系统中引入了超分辨率技术，大幅提升了图像质量，可满足包括视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求。

3) 汽车电子领域

公司已耕耘多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。多家全球知名的汽车 OEM 厂商都采用了芯原的 GPU 用于车载信息娱乐系统或是仪表盘；芯原的神经网络处理器 IP 也已经获得了多家客户用于其 ADAS 产品；芯原的第一代 ISP IP 已获得 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证。报告期内，芯原的第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证；芯原的畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO

26262 ASIL B 认证；芯原的显示处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证，公司其他 IP 也正在逐一通过车规认证的进程中，并预计将在近期陆续通过各类车规认证。报告期内，公司的各类处理器 IP 获众多汽车芯片企业采用，例如，合肥杰发科技有限公司在其新一代智能座舱域控 SoC AC8025 中采用了芯原的高性能 IP 组合，包括 NPU IP、VPU IP，以及显示处理器 IP。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。报告期内，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

4) 智慧可穿戴设备领域

芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和基于虚拟现实技术的智能眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低功耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。芯原还拥有面向 AR/VR 领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。截至报告期末，已有超过 20 家核心智能手表芯片客户采用了芯原的 IP，并广泛应用于市面在售的各类主流智能手表品牌中。芯原正在着力 AI/AR 眼镜的技术平台优化和产业化，除了已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务之外，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。

芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，以期推动可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

此外，芯原正在全面搭建基于芯原技术的可穿戴系统生态。报告期内，专注于提供图形用户界面（GUI）软件服务的趣戴科技（QDay Technology）宣布加入芯原的全球手表 GUI 生态系统，双方共同开发适用于各种应用的智能手表 GUI 解决方案。芯原还与嵌入式系统领域领先的开源图形库 LVGL 达成战略合作，在 LVGL 库中支持芯原的低功耗 3D 和 VGLite 2.5D GPU 技术，旨在为广泛的嵌入式应用提供优化和扩展的图形处理能力；低功耗 AIoT 芯片设计厂商炬芯科技股份有限公司是首批采用这一解决方案的企业之一，其智能手表系统级芯片结合芯原低功耗 GPU 技术与 LVGL 图形库，提升新一代可穿戴设备的用户体验。

5) 物联网领域

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台。公司持续拓展其在 22nm FD-SOI 工艺

上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。目前上述所有射频 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，大部分已在客户芯片中与基带 IP 集成，形成完整的连接技术方案，应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

报告期内，芯原持续推进公司物联网无线连接技术的升级以增强市场竞争力，包括：芯原的低功耗蓝牙整体 IP 解决方案已全面支持蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）发布的 LE Audio 规范，其中包括通过了 LE Audio 协议栈和 LC3 编解码器的认证，该方案适用于手机、包括真无线立体声（TWS）耳机在内的蓝牙耳机、音箱及其他广泛的音频应用场景；芯原与无线通信技术和通信芯片提供商新基讯已正式达成战略合作，芯原将能够为客户同时提供 4G 和 5G Modem IP 解决方案，进一步丰富了其无线通信 IP 产品组合，双方还将为客户提供一系列完整的终端系统参考设计，包含射频收发器和电源管理套片等关键组件。未来芯原将继续拓展相关 IP 种类，将陆续推出包括 LTE-Cat1 和 Wi-Fi6 在内的更多高性能射频 IP 产品及方案，支持更丰富的物联网连接应用场景。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术多年。截至报告期末，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 42 个客户授权了 290 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 41 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 31 个项目已经进入量产。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

6) Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，相关测试芯片已流片，即将返回进行封装和测试；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，

为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

3、深化客户合作，积极开拓 RISC-V 市场并推动生态发展

报告期内，公司积极开拓 RISC-V 市场，基于芯原的半导体 IP 和芯片定制平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值，并积极推动 RISC-V 产业生态的发展。

以下为报告期内的部分合作案例：

赛昉科技基于 RISC-V 架构的量产 SoC 昉·惊鸿-7110（JH-7110）采用了芯原的显示处理器 IP DC8200。该 SoC 具有高性能、低功耗和高安全性的特点，为云计算、工业控制、网络附加存储（NAS）、平板电脑、人机界面（HMI）等多种应用提供完整的智能视觉处理平台解决方案。

嘉楠科技全球首款支持 RISC-V Vector 1.0 标准的商用量产端侧 AIoT 芯片 K230 集成了芯原的 ISP IP ISP8000、畸变矫正（DeWarp）处理器 IP DW200，以及 2.5D GPU IP GCNanoV。该合作极大地优化了高精度、低延迟的端侧 AIoT 解决方案，可广泛适用于各类智能产品及场景，如边缘侧大模型多模态接入终端、3D 结构光深度感知模组、交互型机器人、开源硬件，以及智能制造、智能家居和智能教育相关硬件设备等。

先楫半导体的 HPM6800 系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能 2.5D GPU IP。HPM6800 系列产品基于 RISC-V CPU 内核，具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能，适用于汽车仪表、人机交互界面（HMI），以及电子后视镜（CMS）等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。

此外，为了推动 RISC-V 生态的快速发展，芯原于 2024 年 5 月 27 日主办了“‘链聚浦东·芯启未来’ RISC-V 产业技术研讨会暨 RISC-V 专利导航成果发布会”，与业界交流 RISC-V 产业发展情况，分享 RISC-V 产业专利导航的最新成果；于 2024 年 7 月 6 日举办了世界人工智能大会的分论坛“‘智’由‘芯’生——RISC-V 和生成式 AI 论坛”，与业界探讨 RISC-V 和生成式 AI 技术融合的技术趋势和市场机遇，分享前沿技术及应用案例；于 2024 年 8 月 19 日主办了第四届滴水湖中国 RISC-V 产业论坛，向业界推荐了 10 款优秀的本土 RISC-V 芯片等。

非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。

公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

2、主要服务情况

公司主要服务为面向消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛应用市场所提供的一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，具体情况如下：

（1）一站式芯片定制服务

一站式芯片定制服务是指向客户提供平台化的芯片定制方案，并可以接受委托完成从芯片设计到晶圆制造、封装和测试的全部或部分服务环节，充分利用半导体 IP 资源和芯片研发能力，满足不同客户的芯片定制需求，帮助客户降低设计风险，缩短设计周期。其中，半导体 IP 除在一站式芯片定制服务中使用外，也可以单独对外授权。

一站式芯片定制服务具体可分为两个主要环节，分别为芯片设计业务和芯片量产业务。

①芯片设计业务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户对芯片在功

能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片样片生产，最终将经过公司技术人员验证过的样片交付给客户的全部过程。

②芯片量产业务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户需求委托晶圆厂进行晶圆制造、委托封装厂及测试厂进行封装和测试，并提供以上过程中的生产管理服务，最终交付给客户晶圆片或者芯片的全部过程。

按照客户特征类型区分，芯原主要为芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等客户提供一站式芯片定制业务。

此外，公司还为客户提供软件开发平台、面向应用的软件解决方案、软件开发包、定制软件、软件维护与升级等服务，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市场。

通过将公司的半导体 IP、芯片定制服务和软件支持服务等全面有机结合，芯原可为客户提供系统平台解决方案，包括高端应用处理器系统平台解决方案、高性能车规 ADAS 系统平台解决方案、视频转码加速系统平台解决方案、智慧可穿戴设备/健康监测系统平台解决方案、AR/VR 系统平台解决方案等。

（2）半导体 IP 授权服务

除在一站式芯片定制业务中使用自主半导体 IP 之外，公司也向客户单独提供处理器 IP、数模混合 IP、射频 IP、IP 子系统、IP 平台和 IP 定制等半导体 IP 授权服务。

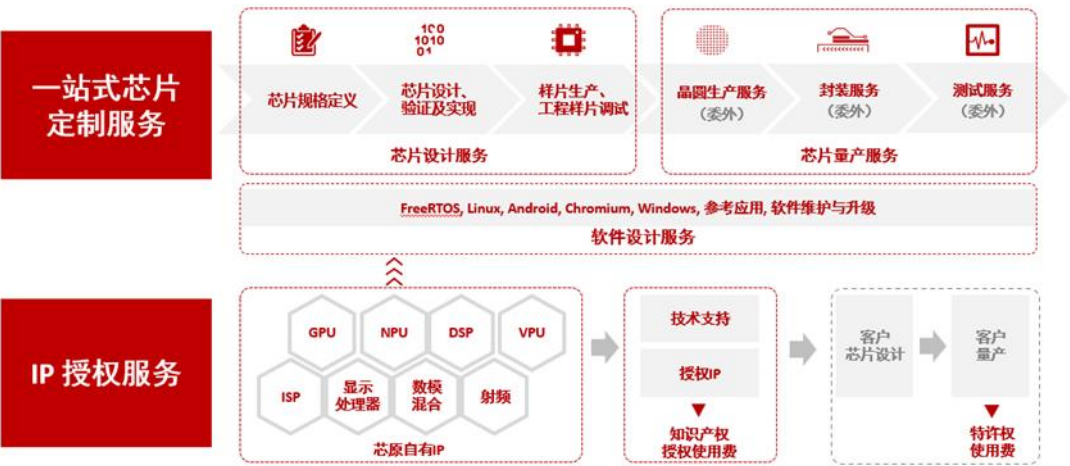
半导体 IP 授权服务主要是将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块（即半导体 IP）授权给客户使用，并提供相应的配套软件。

芯原的处理器 IP 主要包括图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号处理器 IP 和显示处理器 IP。

公司还拥有数模混合 IP 和物联网连接 IP（含射频）共计 1,600 多个。芯原针对物联网应用领域开发了多款低功耗高性能的射频 IP 和基带 IP，支持包括蓝牙、Wi-Fi、蜂窝物联网、多模卫星导航定位等在内的多种技术标准及应用，采用 22nm FD-SOI 等多种工艺，部分射频 IP 已在多款客户 SoC 芯片中集成并大规模量产。

此外，公司还可根据客户需求，为部分芯片定制客户提供定制 IP 的服务。

为降低客户开发成本、风险和缩短产品上市周期，芯原根据客户和市场需求，还推出了半导体 IP 平台授权服务。该授权平台通常含有公司的多个 IP 产品，IP 之间有机结合形成了子系统解决方案和平台解决方案，优化了 IP 之间协处理的效率、降低了系统功耗，简化了系统设计。



图：公司提供的主要服务图

(二) 主要经营模式

公司商业模式以及具体盈利、采购、研发、营销、管理及服务模式如下：

1、商业模式

芯原的主要经营模式为芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS®）模式（以下简称“SiPaaS 模式”）。

与传统的芯片设计服务公司经营模式不同，芯原自主拥有的各类处理器 IP、数模混合 IP 和射频 IP 是 SiPaaS 模式的核心。通过对各类 IP 进行工艺节点、面积、带宽、性能和软件等系统级优化，芯原打造出了灵活可复用的芯片设计平台，从而降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率。

此外，公司与芯片设计公司经营模式亦有一定差异，通常行业内芯片设计公司主要以设计并销售自有品牌芯片产品而开展业务运营。SiPaaS 模式并无自有品牌的芯片产品，而是通过积累的芯片定制技术和半导体 IP 技术为客户提供一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，而产品的销售则由客户自身负责。该种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小。

SiPaaS 模式具有平台化、全方位、一站式三个主要特点，这三个特点分别带来了可复用性、应用领域扩展性、可规模化的独特优势，这些优势共同形成了芯原较高的竞争壁垒。

2、盈利模式

公司主要通过向客户提供一站式芯片定制服务（含软件支持）和半导体 IP 授权服务取得业务收入。

一站式芯片定制服务收入主要系公司根据客户芯片和软件定制需求，完成客户芯片设计和制造中的全部或部分业务流程环节，以及相关软件设计所获取的收入。在芯片设计阶段，公司主要负责芯片硬件和软件设计工作，以及按客户需求为其定制部分 IP（通常为模拟 IP），并获取相关收入。

当芯片设计和软件完成并通过验证后，客户将根据终端市场情况向公司下达量产芯片的订单，订单通常包含量产芯片的名称、规格、数量、单价等要素，公司将依据客户订单为其提供芯片的委外生产管理服务，交付符合规格要求的芯片产品并获取芯片量产业务收入，该阶段通常在客户下达生产订单时预收一部分款项，待芯片完工发货后收取剩余款项。

半导体 IP 授权服务收入主要系公司将其研发的半导体 IP 以单个 IP 或 IP 平台的方式授权给客户使用所获取的收入。在客户芯片设计阶段，公司直接向客户交付半导体 IP 或 IP 平台，并获取知识产权授权使用费收入。该阶段通常在签署合同时收取一部分款项，待 IP 或 IP 平台交付完成后收取剩余款项。客户利用该 IP 或 IP 平台完成芯片设计并量产后，公司依照合同约定，根据客户芯片的销售情况，按照量产芯片的单位数量获取特许权使用费收入，该阶段客户通常按季度向公司提交芯片销售情况作为结算依据。

3、采购模式

公司建立了完整稳定的采购管理流程，并使用企业级资源管理系统 SAP 作为基本工具来执行公司采购业务。公司的采购模式主要包括一般采购模式和客户订单需求采购模式。

一般采购模式主要适用于公司研发所需的通用软硬件采购，主要采购内容包含 EDA/设计工具、验证工具、仪器设备、服务器、存储以及网络设备等。客户订单需求采购模式主要适用于一站式芯片定制服务，公司将根据客户的量产芯片订单需求，以委外的形式向晶圆厂采购晶圆，并向封装及测试厂采购封装及测试服务，以完成芯片制造。

供应商选择方面，公司实施严格的供应商准入制度，设有合格供应商名单，并对该名单中的合格供应商服务进行定期考核和评定。在具体项目执行时，通常会综合考虑供应商生产工艺节点的稳定性、成本结构以及交货周期等因素，以保证产品的质量，协助客户做出最佳的选择。

4、研发模式

公司采用以市场和客户需求为导向的研发模式，结合未来技术及相关行业发展方向，开展关键性、先进性的芯片定制技术、半导体 IP 技术和软件技术的研发，并建立了中国上海、成都、北京、南京和海口，美国硅谷和达拉斯，以及越南胡志明市八个研发中心。

（1）一站式芯片定制服务研发流程

公司一站式芯片定制服务研发方向包括应用于设计平台的设计方法论，以 IP 为核心的功能子系统。公司结合自有或第三方 IP，针对不同应用场景，开发了相应的设计平台并应用于实际客

户的项目实现中。设计平台包括功能子系统、相应的设计及验证方法论和工艺节点实现流程。设计平台的研发流程主要包含需求收集、项目立项、项目研发、项目验收及成果推广，研发成果主要应用于设计平台的预研及改进。

（2）软件研发流程

公司软件开发流程主要包括需求分析、软件规格制定、软件开发计划制定、软件架构设计、软件开发、代码审核与测试、软件质量评审以及软件发布。

公司已经建立了完善的自动化测试和严格的质量管控流程，实现软件快速持续迭代与发布，确保按照客户要求交付高质量的软件。

（3）半导体 IP 研发流程

公司半导体 IP 研发流程主要包括产品市场调研、技术可行性分析、产品规格制定、研发计划制定、IP 架构设计、IP 设计实现、IP 设计验证、IP 性能测试以及设计验收。

5、服务模式

（1）一站式芯片定制服务的服务模式

①设计规格定义

根据客户提交的产品规格要求书，细化芯片的设计规格，包括 IP 选型、功能及性能指标、芯片架构方案等，并制定芯片设计规格书。芯片设计规格书通常由双方经过反复讨论及修订，形成书面文件，并由双方审核确认。

②设计实现及样片验证

根据芯片设计规格书进行设计实现，包括但不限于 IP 的采购及定制、逻辑设计、设计整合、设计验证、原型验证、物理实现及封测设计。在设计过程中，根据芯片设计规格书，并按照与客户约定的设计审核里程碑，定期或在关键节点对项目进展及阶段性设计成果进行讨论及审核。依据审核结果决定是否进入下一阶段。如果芯片设计规格需要更改，在双方同意下，更新相应的芯片设计规格书，并对设计计划做相应调整。

设计完成并通过流片审核后，芯片进入样片试生产阶段，设计数据交付给相应晶圆厂、封装测试厂进行样片流片。

样片流片完成后，进入样片验证阶段。公司与客户的设计及系统团队，根据设计规格，完成样片的测试验证，并在双方审核后签署样片确认书。

③产品量产及配套支持

完成样片验证后，项目进入量产阶段。按照与客户约定的下单流程，接受客户订单，制定生

产计划，将相应订单分解为各委外供应商（晶圆厂、封测厂、物流及其他供应商）的订单，安排产品生产。同时监控各阶段生产状况（生产进程及相关数据），并定期将生产状况向客户汇报。当生产需求或状况发生变动时，协调客户及委外供应商，调整生产计划、调查变动原因，保证生产的正常进行。

④软件设计支持

根据客户的需求，在芯片设计的同时，开展相应的软件设计服务。按照与客户的约定，为客户设计应用软件、软件开发平台、软件开发包等，亦可根据客户需求提供定制软件、软件维护与升级等服务。在软件设计过程中，按照与客户约定的设计审核里程碑，定期或在关键节点对项目进展及阶段性设计成果进行讨论及审核。依据审核结果决定是否进入下一阶段。如果设计需求发生更改，在双方同意下，对设计计划做相应调整，然后进行下一步的开发。

设计完成后，将所有设计数据交由客户进行验收测试，并根据客户的反馈进行相应的调试工作。设计通过客户审核后，双方签署软件确认书。

（2）半导体 IP 授权服务的服务模式

①半导体 IP 或 IP 平台客户交付

在根据协议向客户交付授权的半导体 IP 或 IP 平台时，主要交付该 IP 或 IP 平台的数据文件，并附以全套功能说明文档和用户 IP 或 IP 平台的集成和实现使用手册。

②交付后配套支持

一般情况下，根据协议，半导体 IP 或 IP 平台交付后客户享有一年的技术支持期，芯原为客户提供半导体 IP 或 IP 平台集成和使用过程中所需的技术支持。技术支持期结束后，客户可根据实际需要延长技术支持期或采购其他后续服务。

6、营销模式

公司建立了全球化的市场销售体系，在中国大陆、中国台湾、美国硅谷、欧洲、日本、韩国等目标客户集中区域设置了销售和技术支持中心，能及时了解市场动向和客户需求，便于推广和销售公司各项服务。同时，根据芯原分区域销售原则，芯原通常以境外主体与境外客户签署协议、境内主体与境内客户签署协议。在销售过程中，各区域的销售团队和技术支持中心保持紧密沟通和协作，就近为客户提供相关销售及技术支持，以提高客户服务的响应速度和满意度。

7、管理模式

公司采用一站式全流程管理模式，为客户提供从芯片和软件定义、IP 选型及工艺评估，到芯片和软件设计、验证、实现、样片流片、小生产测试，直至大规模量产的全流程服务。一站式全流程管理模式主要包括芯片设计（含软件设计）、流片/小批量生产测试及量产三个阶段。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于“软件和信息技术服务业”下的“集成电路设计”（行业代码：I6520）。公司所处行业情况具体如下：

（1）全球集成电路市场需求旺盛

集成电路产业发展的大环境为半导体产业，二者的发展景气度高度一致。受全球经济、国际形势起伏的影响，近期半导体行业周期波动明显，但长期的增长趋势始终未发生变化，其最重要的原因是以技术进步为基石而带来的新兴应用的推陈出新。

从个人电脑和宽带互联网，到智能手机和移动互联网的技术更替，使得半导体产业的市场前景和发展机遇越来越广阔。目前，半导体产业已进入智能手机后的下一个发展周期，其最主要的发展动力源自于人工智能、大数据、云计算、5G 通信、物联网、智慧汽车和新能源等新应用的兴起。根据 IBS 报告，全球半导体市场在 2023 年市场规模为 5,237 亿美元，而上述应用将驱动着该市场在 2030 年达到 11,834 亿美元，呈稳定快速增长态势。

就具体终端应用而言，无线通信为最大市场，其中智能手机是关键产品，5G 和 AI 技术对相关半导体市场起到了很大的促进作用；计算机市场类别中，近几年主要的半导体消费增长驱动力为含服务器和 HPC 系统在内的数据中心，AIGC 在云端训练时所需的算力系统，以及 AI PC 等端侧计算设备的逐步渗透；包括电视、视听设备和虚拟家庭助理在内的消费类应用，为智能家居物联网提供了主要发展机会；由于电动汽车市场的快速增长和汽车的数字化与智慧化演进，汽车应用中的半导体消费出现了高速增长；此外，AR/VR 设备正在不断向一体化、低功耗、轻量化演进，并受到 AIGC 相关技术快速演进的推动，其市场也逐步从游戏、教育、电商、工业类应用市场，向更加广阔的以社交为中心的消费类市场拓展。

虽然近两年半导体市场受到公共卫生事件、地缘政治等因素影响出现波动，但自 2024 年起，该市场正在逐步复苏。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2024 年半导体市场规模预计同比大幅增长 19.0%，2025 年半导体市场增幅则为 11.2%，全球市场估值估计将达到 6970 亿美元。2025 年，所有地区的市场规模都将继续扩张，美洲和亚太地区预计将保持两位数的同比增长。

（2）中国集成电路产业生态快速发展

中国大陆是全球最大的电子设备生产基地，也是集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续保持较高水平。强劲的市场需求，以及本土化安全可控的供应链管理趋势，促使中国大陆集成电路生态得到快速发展，进而扩大了中国集成电路整体产业规模。

从上游集成电路制造端来看，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的 2024 年第四季度《全球晶圆厂预测》报告指出，在中国大陆芯片自给自足战略以及汽车和物联网应用预期需求的推动

下，2025 年全球主流制程节点（8nm~45nm）的产能预计将在 2025 年将再增加 6%的容量，达到 1500 万片/月的里程碑；成熟的技术节点（50nm 及以上）目前正在经历略保守的扩张，预计这一细分市场 2025 年的产能将达到 1400 万片/月，同比将增长 5%。Trend Force 预计，2023 年至 2027 年，全球成熟（28nm 及以上）与先进（16nm 及以下）半导体制程的比例约为 7 比 3。预计到 2027 年，中国大陆成熟制程产能的全球占比将从 29%增长至 33%。

从下游集成电路设计端来看，中国大陆晶圆产能的快速提升，为国内集成电路设计行业在降低成本、扩大产能、提高地域便利性等方面提供了支持，对整个集成电路产业的发展起到了拉动作用。同时，大陆市场的旺盛需求和投资热潮也促进了我国集成电路设计行业专业人才的培养及配套产业的发展。集成电路产业环境的良性发展为我国集成电路设计产业的扩张和升级提供了机遇。在上述大环境下，中国的芯片设计公司数量稳步增加。中国半导体行业协会集成电路设计分会公布的数据显示，自 2016 年以来，我国芯片设计公司数量大幅提升，2015 年仅为 736 家，2024 年快速增长到了 3626 家。



图：2010-2024 年芯片设计企业数量增长情况

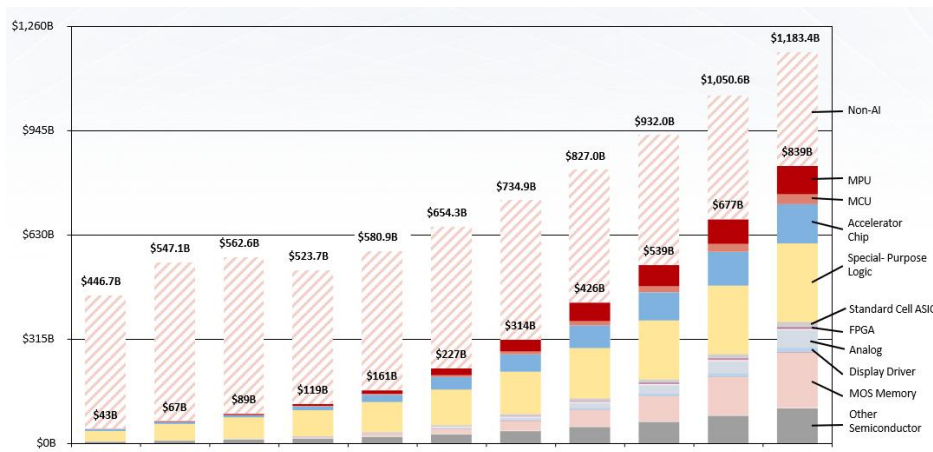
数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会

根据 IBS 报告，2023 年中国芯片设计公司规划中的设计项目数为 1,248 项，占全球总设计项目数的 24.75%，该数据预计将于 2030 年达到 2,435 项，占全球总设计项目数的 31.86%。2030 年，中国规划中的设计项目数居全球各国之首，美国排名第二（美国 2030 年规划中的设计项目数为 2,280 项，占全球总设计项目数的 29.83%）。

（3）人工智能产业驱动半导体产业进入高速增长期

近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（AIGC）模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。研究机构 IBS 的数据显示，到 2030 年，全球半导体市场规模预计将从 2024 年的约 5800 亿美元增长到 1.2 万亿美元；这其中，AI 类半导体市场规模将从 2024 年的 1610 亿美元增长到 2030 年的 8392 亿美元——也即到 2030 年，AI 类半导体将占据总体半导体市场超过 70%的份额。这一增长受到了包括 OpenAI 的 GPT 系列、DeepSeek 等在内的 AIGC 模型快

速迭代和商业化落地的极大驱动。



图：全球半导体市场规模和 AI 半导体市场规模，按产品分类

数据来源：IBS

因复杂的算法和需要进行海量数据处理，AIGC 模型在云侧进行训练、端侧进行微调和推理时，产生了很大的算力需求，直接推动了半导体企业加速研发更先进的制程工艺、创新的芯片架构（如 Chiplet）和各类专用的 AI ASIC 芯片。

值得一提的是，2024 年底本土推出的 DeepSeek 大模型，采用了更优化的硬件使用策略、创新的训练方法、高效的模型压缩技术，充分符合端侧设备对 AI 模型紧凑、高效、易用的需求，将推动 AI 大语言模型在广泛的端侧设备上快速部署，将进一步促进端侧 AI 芯片的快速发展。

此外，AIGC 的普及还带动了存储芯片、传感器芯片等相关领域的增长。

随着 AI 应用场景的扩展，半导体产业链上下游企业纷纷加大投入，以抓住这一历史性机遇。可以预见，在 AI 技术的持续驱动下，半导体产业将迎来更广阔的发展空间。

（4）系统厂商、互联网厂商、云服务提供商、车企自主设计芯片的趋势明显

近年来，系统厂商、互联网公司、云服务提供商、车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因多寻求与芯片设计服务公司进行合作。例如小米、苹果等系统厂商都拥有自己的芯片设计团队或者希望依托集成电路设计服务企业帮助自己开发专用芯片；谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、快手等互联网公司，纷纷着手开发与其业务相关的自有芯片；国内知名的新能源车企如蔚来、小鹏、理想等，都纷纷推出了自研智驾芯片等，这种趋势为集成电路设计产业中半导体 IP 和芯片设计服务的发展扩展了市场空间。

此外，该类企业因其核心业务为应用端的产品或是服务，因此在寻求芯片设计服务时，多倾向于采用含硬件和软件的完整的系统解决方案，以缩短开发周期和降低风险。

（5）安全、可控的迫切需求

集成电路产业是国家战略性产业，集成电路芯片被运用在社会的各个角落，只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的IP授权或架构授权基础上。核心技术和知识产权的受制于人具有较大的技术风险。由于这些芯片底层技术不被国内企业掌握，因此在安全和供应问题上得不到根本保障。IP和芯片底层架构国产化是解决上述困境的有效途径，市场对国产芯片的“安全、可控”的迫切需求为本土半导体IP供应商提供了发展空间。

（6）良好的半导体产业扶持政策

国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，如国务院于2020年8月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。在2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，则进一步提出了要加强在人工智能、量子计算、集成电路前沿领域的前瞻性布局。2024年《政府工作报告》则围绕“加快发展新质生产力”做出了三大具体部署，其中包括推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；以及积极培育新兴产业和未来产业。

在良好的政策环境下，我国集成电路行业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国集成电路设计产业技术水平的提高和行业的快速发展。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯原的主要业务为一站式芯片定制和半导体IP授权两类业务，且占比均较为重要，两者具有较强的协同效应，共同促进公司研发成果价值最大化，加之行业内类似供应商的市场策略及目标客户群体有所不同，因此芯原不存在完全可比公司。规模化运营的芯片设计服务提供商或是半导体IP提供商基本都集中在海外，芯原是我国企业中极少数能与同行业全球知名公司直接竞争并不断扩大市场占有率的公司。

（1）公司的客户群体逐步转变，系统厂商、互联网企业、云服务提供商和车企占比保持高位

近年来，系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因，多寻求与芯片设计服务公司进行合作。

芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设

计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、微软、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业。报告期内，公司来自系统厂商、互联网企业、云服务提供商和车企客户的收入占总收入比重约四成。

（2）公司是中国排名第一的半导体 IP 供应商

根据 IPnest 在 2024 年的统计，从半导体 IP 销售收入角度，芯原是 2023 年中国排名第一、全球排名第八的半导体 IP 授权服务提供商；在全球排名前十的企业中，IP 种类排名前二。2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。随着后续客户产品的逐步量产，公司将进一步提升特许权使用费收入，公司 IP 授权业务的规模效应将进一步扩大。

目前，芯原的神经网络处理器（NPU）IP 已被 82 家客户用于其 142 款人工智能芯片中，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，这些内置芯原 NPU 的芯片主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等 10 余个市场领域，奠定了芯原在人工智能领域全球领先的根基。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。

芯原 GPU IP 已经耕耘嵌入式市场近 20 年，在多个市场领域中获得了客户的采用，包括数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC 等，内置芯原 GPU 的客户芯片已在全球范围内出货超过 20 亿颗。具体来看，芯原在汽车电子领域与全球知名的头部企业合作，已被广泛应用于车载娱乐系统和可重构仪表盘；公司的 2D GPU 可以达到 3D 的效果，被大量应用于可穿戴领域产品，例如智能手表，支持显示功能的 MCU 等；此外，芯原在桌面显示渲染方面也有长期的技术积累，可为 PC / 服务器领域的客户提供服务。芯原 GPU 还可以和公司自主知识产权的神经网络处理技术融合，支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器提供大算力通用处理器平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理器单元。芯原自主知识产权的通用图形处理器（GPGPU）可以支持大规模通用计算和生成式 AI（AIGC）相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内已获得多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。报告期内，公司还推出了全新 Vitality 架构的 GPU IP 系列，集成了诸多先进功能，如一个可配置的张量计算核心（Tensor Core）AI 加速器和一个 32MB 至 64MB 的三级（L3）缓存，提供强大的处理能力和出色的能效表现，并支持多核扩展，广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等应用领域。

芯原的 Hantro 视频处理器 IP 已被全球前 20 大云平台解决方案提供商中的 12 个采用，并被中国前 5 大互联网提供商中的 3 个采用，这反映了公司在服务器、数据中心市场占据了有利地位，这一市场也逐步成为芯原的主力市场之一。报告期内，芯原还推出了面向下一代数据中心的全新 VC9800 系列 IP，该系列 IP 具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力，可支持最高 256 路码流，并兼容所有的主流视频格式，包括新一代先进格式 VVC 等；该系列 IP 还可针对 AI 计算，与芯原的 NPU IP 实现无缝交互，达到了 OpenCV 级别的精度，并在视频处理子系统中引入了超分辨率技术，大幅提升了图像质量，可满足包括视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求。

芯原的第一代 ISP IP 已获得 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证。报告期内，芯原的第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证；芯原的畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证；芯原的显示处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证，公司其他 IP 也正在逐一通过车规认证的进程中，并预计将在近期陆续通过各类车规认证。目前，公司的各类处理器 IP 获众多汽车芯片企业采用。

公司在 FD-SOI 工艺上拥有较为丰富的 IP 积累。截至目前，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 42 个客户授权了 290 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 41 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 31 个项目已经进入量产。

面向物联网多样化场景应用，芯原在 22nm FD-SOI 工艺上还布局了较为完整的射频类 IP 产品及平台方案，支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。所有射频 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，大部分已在客户芯片中与基带 IP 集成，形成完整的连接技术方案，应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。目前 NB-IoT、低功耗蓝牙 BLE、GNSS、802.11ah 和 802.15.4g 射频 IP 都已有客户授权，且采用芯原 802.11ah 和 802.15.4g 射频 IP 的客户芯片已量产。在此基础上，芯原将继续拓展 IP 种类，正在开发包括 LTE-Cat1 和 Wi-Fi 6 在内的更多高性能射频 IP 产品及方案，支持更多物联网连接应用场景。

（3）公司具有全球领先的芯片设计服务能力

在一站式芯片定制服务方面，芯原拥有从先进 5nm FinFET、22nm FD-SOI 到传统 250nm CMOS 制程的设计能力，所掌握的工艺可涵盖全球主要晶圆厂的主流工艺、特殊工艺等，已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。同时，公司还提供芯片设计相关的全套软件解决方案。此外，为满足面向汽车应用的定制芯片的特殊要求，芯原的芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证。公司还推出了功能安全 (FuSa) SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。

芯原一站式芯片定制服务的整体市场认可度不断提高，已开始占据有利地位，经营成果不断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、亚马逊、谷歌、微软等众多在其各自领域具有较强的代表性和先进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应的服务成果后，公司在品牌方面的竞争能力进一步增强。

基于公司先进的芯片设计能力，芯原还推出了一系列面向快速发展市场的平台化解决方案。以芯原的高端应用处理器平台为例，该平台基于高性能总线架构和全新的先进内存方案（终极内存/缓存技术），为高性能计算、笔记本电脑、平板电脑、移动计算、自动驾驶等提供一个全新的实现高性能、高效率和低功耗的计算平台，并可显著地降低系统总体成本。公司设计的该处理器的样片，从定义到流片只用了约 12 个月的时间，回片的当天就顺利点亮，相关的操作系统、应用软件都在这个平台上得到了顺利的运行。这个项目不仅对先进内存方案（终极内存/缓存技术）成功进行了首次验证，还充分证明了公司拥有设计国际领先的高端应用处理器芯片的能力，这将有助于公司拓展平板电脑、笔记本电脑、服务器、自动驾驶等业务市场。目前，公司正在面向 AIGC 和智慧出行领域推进 Chiplet 平台解决方案的研发和产业化工作。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

1) FinFET 和 FD-SOI 工艺技术逐步获得广泛采用

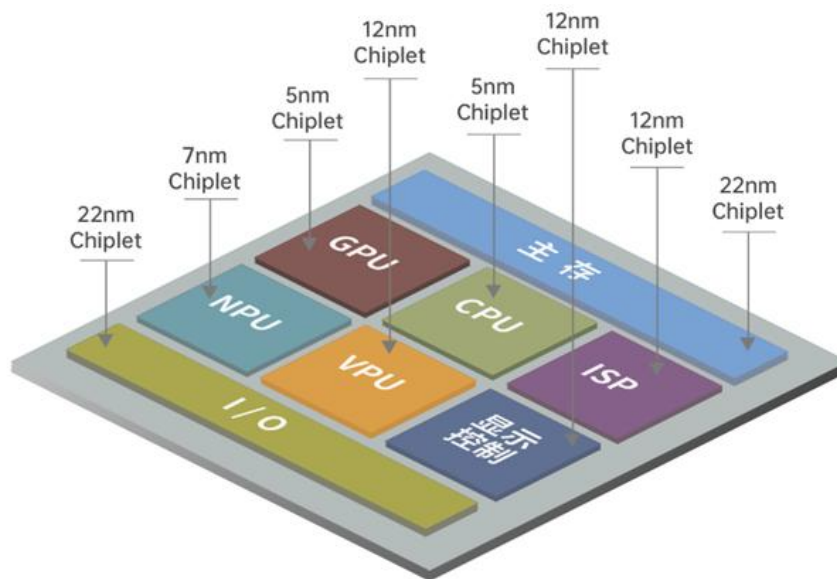
近年来，为继续延续摩尔定律的演进，两种集成电路新工艺节点技术的诞生打破了技术瓶颈，分别是 FinFET 和 FD-SOI。FinFET 和 FD-SOI 两种技术都是晶体管进一步缩小所需要发展的核心手段。

2001 年，加州大学伯克利分校的 Chenming Hu 教授，Ts-Jae King-Liu 和 Jeffrey Brokor 提出了 FinFET 和 FD-SOI 两种解决方案，以将 CMOS 工艺技术扩展到 20nm 以下。其中 FinFET 采用 3D 架构，可大幅改善电路控制并减少漏电流，以及大幅缩短晶体管的栅长。FD-SOI 具有超薄的全耗尽通道，以实现更好的栅极控制，但其顶层硅厚度均匀性必须保证在几个原子层内。FinFET 和 FD-SOI 都是关键的先进工艺技术。FinFET 具有高计算性能的特点，适用于云服务、高性能计算、人工智能等需要长时间保持高计算性能的应用；FD-SOI 具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势，适用于物联网、通讯、传感器、自动驾驶等待机时间较长，偶尔需要高性能，但更多地强调低功耗和高集成的应用。目前 FinFET 技术在智能手机、平板电脑、高性能计算等领域已经获得了广泛的采用；而 FD-SOI 技术则在图像传感器、图像信号处理器和众多物联网相关领域开拓了市场空间。博世的汽车毫米波雷达，亚马逊的家用监控摄像头、索尼的相机摄像头、瑞萨和意法半导体的 MCU 等均已采用了 FD-SOI 技术。FD-SOI 的技术特点和优势已经获得了市场的广泛关注与重视。例如，2022 年 7 月，法国总统马克龙、欧盟专员、格芯 CEO Thomas Caulfield 及意法半导体总裁兼 CEO Jean-Marc Chery 共同宣布意法半导体和格芯将在法国新建 12 英寸晶圆

厂，以推进FD-SOI生态系统建设；2024年3月19日，意法半导体宣布与三星联合推出18nm FD-SOI工艺，该工艺支持嵌入式相变存储器(ePCM)；2024年6月11日，法国CEA-Leti宣布推出FAMES中试生产线，43家公司已正式表示支持，该生产线将开发包括10nm和7nm FD-SOI在内的五套新技术等。

2) 高性能计算需求与日俱增，Chiplet 技术将在 AIGC 和智慧出行领域率先落地

Chiplet（芯粒）是一种可平衡大规模集成电路的计算性能与成本，提高设计灵活性，且提升IP模块经济性和复用性的技术之一。Chiplet实现原理如同搭积木一样，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的封装技术（如2.5D、3D封装技术等）集成封装在一起，从而形成一个系统芯片。



图：基于 Chiplet 异构架构的应用处理器示意图

Chiplet 在继承了 SoC 的 IP 可复用特点的基础上，更进一步开启了 IP 的新型复用模式，即硅片级别的 IP 复用。不同功能的 IP，如 CPU、存储器、模拟接口等，可灵活选择不同的生产工艺分别进行生产，从而可以灵活平衡计算性能与成本，实现功能模块的最优配置而不必受限于晶圆厂工艺。基于 Chiplet 模式的芯片设计具备开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点；可将不同工艺节点、材质、功能、供应商的具有特定功能的商业化裸片集中封装，以解决 7nm、5nm 及以下工艺节点中性能与成本的平衡，有效缩短芯片的设计时间和降低风险，并提高供应链管理的灵活性。Chiplet 的发展演进为 IP 供应商，尤其是具有芯片设计能力的 IP 供应商，拓展了商业灵活性和发展空间。

研究机构 Omdia 的报告显示，2024 年，采用 Chiplet 的处理器芯片的全球市场规模预计达 58 亿美元，到 2035 年将达到 570 亿美元。Chiplet 主要适用于大规模计算和异构计算。以 AMD、英特尔、台积电等为代表的多家集成电路领导厂商已先后发布了相关 Chiplet 解决方案、接口协议或

封装技术。2022年3月2日，英特尔、AMD、ARM、高通、台积电、三星、日月光、Google云、Meta(Facebook)、微软这十家行业领导企业共同成立了 Chiplet 标准联盟，正式推出了通用 Chiplet 的高速互联标准，芯原已经成为大陆首批加入 UCIE 联盟的企业之一。

Chiplet 会在 AIGC 和自动驾驶领域率先获得应用，主要由于该技术可解决 AIGC 和智慧出行领域现阶段所面临的主要痛点。

对于 AIGC 应用来说，云侧（如服务器）的训练和推理，以及端侧（如手机、汽车、物联网设备）的微调和推理，对算力的需求均正在快速增长。一方面，目前满足云端训练需求的大算力单芯片，因成本、良率、设计资源和供应等因素，必须拆分成算力相对较低的 Chiplet 模块，再通过先进封装集成成大算力芯片，以及进行后续迭代；另一方面，端侧对算力的要求较为多样化，比如汽车、智能手表等不同端侧会因为产品形态和应用场景不同，对算力的需求不尽相同，因此 Chiplet 架构的芯片更能灵活满足 AIGC 类应用的实际需求。

目前，新能源汽车正在全球范围内快速发展，其带来的先进 ADAS 和自动驾驶技术需求，使得汽车芯片在汽车中的价值和价格比重均日益增加。高端智驾芯片面临设计周期长、单芯片（大芯片）良率较低、生产受限以及算力扩展困难等挑战，采用 Chiplet 技术可以有效解决这些问题，并已在汽车产业界达成共识，相关技术获得了积极部署。例如，2023年11月，瑞萨发布了第五代汽车芯片战略，明确表示将会采用 Chiplet 架构，并在2027年提供基于 Chiplet 架构的 SoC、MCU 等系列产品；国内蓝洋智能、北极雄芯都已经推出了 Chiplet 架构的汽车芯片（北极雄芯推出了基于 Chiplet 架构的 Qiming935 系列车规级芯片，并于2023年7月通过了 SGS 功能安全产品认证 ISO 26262:2018 ASIL B，这是国内首款获得此认证的基于 Chiplet 的车规级芯片）；2023年10月10日和11日，汽车生态系统在比利时微电子研究中心（IMEC）召开第二届汽车 Chiplet 会议，各方形成共识：“无论如何，Chiplet 都将成为未来汽车的一部分”；2024年10月，博世与 Tenstorrent 宣布合作，开发用于汽车芯片的 Chiplet 标准化平台，该合作旨在通过标准化 Chiplet 降低成本并加速汽车芯片的上市等。

3) 开源的 RISC-V 促进集成电路产业的开放与创新

RISC-V 是一个免费、开放的指令集架构，是加州大学伯克利分校图灵奖得主 David Patterson 教授及其课题组，历经三十多年研发的第五代基于 RISC 的 CPU 指令集架构。2015年，加州伯克利大学将 RISC-V 指令集架构开源，并成立由工业界和学术界成员组成的非营利组织 RISC-V 基金会，来指导 RISC-V 的发展方向并促进其在不同行业的应用。目前，RISC-V 基金会已经有来自 70 多个国家的近 4000 家会员，这些会员包括谷歌、英特尔、西部数据、IBM、英伟达、华为、高通、三星、腾讯等国际领军企业，以及加州大学伯克利分校、麻省理工学院、中科院计算所等顶尖学术机构。2018年9月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头建立的中国 RISC-V 产业联盟(CRVIC)，截至2024年12月底，会员单位已达到 198 家。

RISC-V 的出现极大地促进了开源硬件的发展。到目前为止，业内已经有众多基于 RISC-V 的开源 CPU 设计可供免费学习和使用。目前，全球已有大量的集成电路设计公司将 RISC-V 用在自己的芯片中，如西部数据、英伟达、英特尔、兆易创新、全志科技等，这些企业把 RISC-V 技术从嵌入式场景成功拓展到了工业控制、自动驾驶、人工智能、通信、数据中心等对算力要求更高的场景中。谷歌已公开表示，将把 RISC-V 架构作为 Android 操作系统的主要硬件平台，进行深度支持。Semico Research 预测，2025 年全球基于 RISC-V 架构处理器核的芯片出货量将达到 800 亿颗。

由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届。每届会议上，十家本土企业集中发布十余款国产 RISC-V 芯片新品，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。

（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

集成电路产业经过了数十年的发展，在技术上的不断突破带来持续的应用迭代，改变了许多传统行业，亦催生出众多新产业，如 AI PC、AI 手机、AR/VR 眼镜等可穿戴设备、智慧家居、智慧出行，以及其他 AIGC 相关应用等。上述集成电路设计产业新技术的快速发展直接推动了集成电路产品的推陈出新，促成新兴产业的诞生。

1）物联网

以广义物联网为代表的新兴产业，在可预见的未来内发展趋势明朗。可穿戴设备、智能家电、自动驾驶汽车、智能机器人、3D 显示等应用的发展将促使数以百亿计的新设备进入这些领域，万物互联的时代正在加速来临。研究机构 Analytics 最新的《物联网企业支出跟踪更新报告》显示，从 2022 年到 2027 年，全球物联网市场规模将以 19.4% 的复合年增长率增长，并在 2027 年达到 4830 亿美元。其中亚太地区将在 2022 年至 2027 年间以 22% 的复合年增长率增长，超过世界其他地区。

2）云侧与端侧生成式人工智能（AIGC）

人类正在步入数字化社会，所产生的数据呈指数级增长。随着信息技术的高速发展，数据价值挖掘是大势所趋，AIGC 是将这些数据转化成为高价值的重要手段。

2022 年 11 月，OpenAI 推出的聊天机器人 ChatGPT 受到了业界的广泛关注。这类基于 AI 技术的自然语言处理应用成为了 AIGC 技术的重要应用突破口，快速在各行各业取得应用。大算力支撑 AIGC 应用快速发展演进的根基。OpenAI 预估人工智能应用对算力的需求每 3.5 个月翻一倍，每年增长近 10 倍，这极大地提升了 NPU、GPU、GPGPU 和相关高性能计算技术的市场应用空间，并对其性能持续提出更高的要求。

2024 年底，本土大语言模型 DeepSeek 所取得的成就获得了全球的广泛关注。DeepSeek 采用

了更优化的硬件使用策略、创新的训练方法、高效的模型压缩技术，充分符合端侧设备对 AI 模型紧凑、高效、易用的需求，将推动 AI 大语言模型在端侧的快速部署。DeepSeek 为发展端侧的“小的大模型”或者“小模型”提供了很好的技术条件：比如，DeepSeek 部署在 AI/AR 眼镜中可以很好地解决用户隐私和安全问题；DeepSeek 部署在汽车中，还能解决智驾系统的时延问题等。

在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。

3) 数据中心与高速数据传输

数据已经成为信息化时代中重要的生产要素和社会财富，甚至关乎国家安全。近年来，信息技术产业加速向万物互联、万物感知、万物智能时代演进，海量数据资源集聚增速远超摩尔定律。据 IBS 的报告，2018 年至 2030 年，数据量将成长 1455 倍，这给以数据存储和通信为核心业务的数据中心带来巨大的压力，同时也带来了巨大的市场发展潜力。

此外，IDC Data Sphere 数据显示，到 2027 年，全球非结构化数据将占到数据总量的 86.8%，达到 246.9ZB。全球数据总量从 103.67ZB 增长至 284.30ZB，CAGR 为 22.4%，呈现稳定增长态势。AI 与数据分析融合将是未来五年的重点。人工智能将改变数据原有的查询、分析、开发、预测方式，而当前 AI 与数据分析融合仅处于初期阶段。

随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的高速 SerDes 接口 IP 已经成为了近年来研究的热点。该接口 IP 实现了高速串行通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定基础。

4) 超高清视频

随着短视频、直播、移动办公/会议、电竞、云游戏、视频社交等应用的快速发展，以及网络影视剧内容的不断丰富，视频已经成为了重要的信息媒介。在无线通信技术、高速数据传输技术和高清显示技术的发展驱动下，超高清视频显示已经成为了电视、电脑、手机等具备多媒体功能的设备的标配。

这类应用既需要优质的视频图像显示效果，也需要兼顾从云到端的带宽资源占用、功耗和时延等问题。上述各类应用将为支持超高清视频标准的视频编解码芯片、显示处理芯片、音视频处理芯片、应用处理器芯片等芯片产品开辟出广阔的市场空间。

5) 智慧出行与 V2X

汽车行业正经历“电动化、智能化、无人化、网联化”的变革，智能出行时代已经到来。在上述趋势推动下，汽车电子元件价值量得到提升，汽车电子领域也有所拓宽。中商产业研究院数据

显示，2020年汽车电子占整车成本比例为34.32%，至2030年有望达到49.55%，汽车电子行业前景广阔。IC Insights的数据显示，汽车专用模拟IC和汽车专用逻辑IC为近年来增长最快的两个IC细分领域。随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均半导体器件价格也将提高到550美元以上。

汽车的智能化、电动化使得车联网成为必然趋势，而车联网也是未来汽车实现自动驾驶的重要基础。车联网（V2X, Vehicle-to-Everything）是以车辆为主体，依靠通信网络互连实现车间（V2V）、车与人（V2P）、车与网（V2N）、车与基础设施（V2I）的互通互联、信息共享，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验、拓展智能服务等目标的智慧交通解决方案。C-V2X

（Cellular Vehicle-to-Everything，基于蜂窝网络的车联网通信技术）是中国主推的车联网技术标准，也是目前全球车联网的唯一标准。当前我国在车联网方面走在了世界前列，未来我国有望凭借产业链领先优势，引领全球车联网产业发展，抢占V2X的全球市场份额。

6) 5G

5G技术的日益成熟开启了物联网万物互联的新时代，已融入人工智能、大数据等多项技术，并成为了推动交通、医疗、传统制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。高性能、低延时、大容量是5G网络的突出特点，这对高性能芯片提出了海量需求，且5G在物联网以及消费终端的大量使用，还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗芯片技术正处于快速发展期，5G市场正在推动集成电路设计行业进入新一波发展高峰。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测，就中国市场而言，在直接产出方面，按照2020年5G正式商用算起，当年带动近5,000亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长至3.3万亿元和6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%；在间接产出方面，2020年、2025年、2030年，5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元，年均复合增长率为24%。

（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

随着集成电路产业的不断发展，集成电路产业链上下游企业在运营模式上，均出现了新的变化，具体体现为半导体产业的三次转移，以及第三次转移带来的“轻设计”趋势。

始于1960年代的世界半导体发展至今，共发生三次转移，分别是美国到日本，从日本到韩国、中国台湾以及从韩国、中国台湾到中国大陆的转移。正在进行过程中的第三次转移，也即向中国的转移，是在智能手机、移动互联网快速发展的契机下，全球半导体产业从韩国、中国台湾地区向中国大陆转移，而物联网、人工智能、5G、新能源汽车等应用的兴起，进一步促进了该转移。虽然近年来有国际局势、地缘政治等因素的影响，但中国传统产业的全面数字化转型，5G的快速部署，电动汽车和新能源产业的快速发展，以及快速兴起的云上/远程办公、教育、娱乐和社交等应用，都带动了相关产业的发展。从国家和地方政策、产业基金到科创板，也都充分展示了国家发展半导体产业的意志和决心。

在产业转移的过程中，产业链的分工不断细化。因此集成电路产业正在进行轻设计（Design-Lite）这一运营模式的升级。与目前相对“重设计”的 Fabless 模式不同，在轻设计模式下，芯片设计公司将专注于芯片定义、芯片架构、软件/算法，以及市场营销等，将芯片前端和后端设计，量产管理等全部或部分外包给设计服务公司，以及更多地采用半导体 IP，减少运营支出，实现轻量化运营。在集成电路产业“轻设计”的趋势下，芯片设计公司的设计工作将更加灵活便捷，从而促进集成电路产业的快速发展。

(四) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术为芯片定制技术、软件技术和半导体 IP 技术。其中，芯片定制技术主要包括架构评估技术、大规模 SoC 验证技术、先进工艺设计技术、符合 ISO 26262 标准要求的设计流程建设；软件技术包括平台化软件开发技术、快速迭代软件开发技术、基于芯原 IP 以及软件开发包的参考应用解决方案、完善通信领域 IP 解决方案的软件技术；半导体 IP 技术主要包括图形处理器技术、神经网络处理器技术、视频处理器技术、数字信号处理器技术、图像信号处理器技术、显示处理器技术、智能像素处理平台，基于 FLEXA 的 IP 子系统，以及多种物联网连接（射频）技术等。具体情况如下：

（1）芯片定制技术

芯片定制技术包括架构评估技术、大规模 SoC 验证技术和先进工艺设计技术。

1) 架构评估技术

架构评估主要指在设计的前期，根据产品规格要求定义的应用场景，对设计结构、主要功能模块、IP 性能指标、设计指标进行定性及定量的评估，并以此为基础定义芯片的架构。

目前芯原基于公司已有的设计经验及平台结构，综合先进的 EDA 工具和其自有功能模块性能模型，结合已有产品的实测数据，早期架构的评估精度较纸面计算已有较大提高，评估误差基本控制在 10%以内；并已经在现有 ASIC 设计服务中利用评估平台，完成了架构设计。该技术避免了由于架构不完善导致的设计返工或过约设计，缩短了设计周期，并将在更多的项目中使用。

2) 大规模 SoC 验证技术

设计验证是芯片设计实现过程中必不可少的一环，对确保设计质量非常重要，也有利于缩短设计周期。大规模 SoC 的设计规模和设计复杂度大幅增加，导致设计验证的难度显著增加，传统的验证方法已经不能满足设计验证的需求。

结合 ASIC 仿真、FPGA 平台、硬件加速仿真器平台等多种验证方法，公司构建的大规模 SoC 验证平台可以支持超过十亿逻辑门，支持应用处理器级别复杂 SoC 的验证，同时支持驱动程序及

开发套件（SDK）的早期开发及验证，满足验证完备性和验证周期的要求。

3）先进工艺设计技术

随着制造工艺的发展，设计流程的复杂度显著增加。针对不同的晶圆厂和工艺节点，需要定义相应的设计流程、设计方法论，并通过实际流片来验证。

公司现有设计技术既可以支持传统 28nm CMOS，也可以支持先进的 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 及 28/22nm FD-SOI 工艺节点的设计和实现；在 22nm FD-SOI 上实现的自适应衬底偏置电压技术，对超低功耗 IoT 应用有显著效果。

4）符合 ISO 26262 标准要求的设计流程建设

芯原在 2022 年一季度初步完成了符合 ISO 26262 标准的设计流程建设，并获得国际独立的第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的资格认证。芯原现可按照国际标准，遵循车载芯片的功能安全性设计流程，为客户提供满足各类汽车安全完整性等级的芯片设计服务。该设计流程建设为进一步提升芯原的芯片设计能力、拓展芯原的业务领域打下了良好的基础。

（2）软件技术

1）平台化软件开发技术

根据公司不同类型客户以及市场的需求，设计开发基于主流操作系统的层次化、模块化、易重用的针对不同类型高性能应用处理器、系统级芯片以及微控制器的驱动软件、中间件开发包，可以满足笔记本电脑、媒体播放盒、物联网、无线蓝牙耳机以及其它可穿戴式设备的产品需求。

芯原设计了针对应用处理器的 Linux 软件开发包以及 Chromium OS、Android 系统软件开发包；针对低功耗系统级芯片以及 MCU 的基于 FreeRTOS 的物联网系统软件平台，帮助客户快速开发应用软件，缩短产品的量产周期。

2）快速迭代软件开发技术

芯片软件开发周期长，发布速度慢，出现质量缺陷尤其是质量回归问题时难以排除，从而导致软件难以按时发布。

芯原设计了一套完备的软件开发、自动化测试以及软件发布流程，在开发芯原的软件开发包（SDK）以及帮助客户设计开发软件的过程中实施，能够显著缩短软件测试与发布周期，第一时间发现质量回归，帮助软件团队及时发现并解决软件质量问题，从而加快软件开发与迭代，及时发布高质量软件，最终帮助客户缩短芯片软件开发周期以及加快产品上市时间。

3）基于芯原 IP 以及软件开发包的参考应用解决方案

基于芯原自有的 IP 以及物联网嵌入式软件平台，芯原设计了针对不同市场需求的参考硬件设计以及应用软件解决方案。比如低功耗健康监测方案以及相关的算法，可以提供从芯片到系统软

硬件的一体化解决方案，进一步帮助客户实现从芯片到软件方案的快速定制与量产。目前公司在低功耗蓝牙、无线蓝牙耳机以及健康监测等领域，已经累积了多项核心发明专利。

4) 完善通信领域 IP 解决方案的软件技术

在蓝牙、LTE Cat1 等物联网通信领域，完成了蓝牙主机协议栈以及 LTE 上层通信协议栈的软件设计与开发，使公司具备了从射频到基带再到软件协议栈的全套通信 IP 解决方案，进一步提升公司在通信领域的技术和市场竞争力。

(3) 半导体 IP 技术

芯原的核心半导体 IP 技术主要包括图形处理器技术、神经网络处理器技术、视频处理器技术、数字信号处理器技术、图像信号处理器技术，显示处理器技术，像素处理 IP 平台，基于芯原低功耗延迟同步接口通信技术 FLEXA 的 IP 子系统等，以及芯原针对物联网应用领域所开发的低功耗蓝牙技术、蜂窝窄带物联网技术、1GHz 以下公用频段射频技术和 GNSS 多模多频段射频技术等。

1) 图形处理器技术

芯原的图形处理器技术是一种专门进行图形运算及渲染、3D 建模、2.5D 或 3D 图形加速等图形处理方面的微处理器技术，在浮点运算、并行运算等方面能力突出，因此也适用于除图形外的一些大型并行运算应用，如人工智能算法。

芯原图形处理器技术的具体表征如下：

- ①支持业界主流的嵌入式图形加速标准 Vulkan 1.3、OpenCL 3.0 FP、OpenGL ES3.2、OpenVG1.1 和 OpenCV 等；
- ②支持业界主流的桌面图形加速标准 DX12FL_11 和 OpenGL 4.6
- ③具有自主可控的指令集及专用编译器；
- ④支持每秒 6 万亿次浮点运算能力和 2048 个并行着色处理器单元。

2) 神经网络处理器技术

芯原的神经网络处理器采用融合 DSA 和 GPGPU 的架构体系，利用其可编程、可扩展及并行处理能力，为各类主流人工智能算法提供硬件加速，在单位功耗下的矩阵和卷积计算能力突出。

芯原神经网络处理器技术的具体表征如下：

- ①芯原神经网络处理器技术包括自主可控的卷积神经网络和 Transformer 网络加速、可编程的浮点运算加速、指令集和可编程的浮点运算专用编译器、优化器等工具设计；
- ②支持国际标准 OpenVX1.3 和 OpenCL3.0 FP；

③支持最大 32 位浮点精度数据处理和张量处理的硬件加速；

④支持 0.5 TOPs 到 100 TOPs 性能的单卷积运算核的可扩展架构设计，多卷积运算核扩展后，NPU IP 的运算能力可以达到 400 TOPs；

⑤具有自主可控的指令集及专用编译器。

3) Hantro 视频处理器技术

芯原的 Hantro 视频处理器技术是用于视频编解码器和视频处理的微处理器技术，在主流视频格式支持、多核可扩展性、帧压缩、编码质量和码率控制等方面的能力突出。

芯原视频处理器技术的具体表征如下：

①单核支持 8K@30fps 或 4K@120fps 实时视频编解码，并可通过多核扩展技术实现单路更高性能的编解码（如通过双核扩展达到单路 8K@60fps 或 4K@240fps 编解码），且可根据客户需求灵活配置产品功能；

②采用硬件处理方式的视频编码器技术在相同视频质量下的编码码率能达到与软件处理方式的高质量 x265（x265slow）编码码率相同的水平，在保证低码率高质量的视频编码、降低带宽需求的同时，实现实时编码能力；

③视频编码技术可提供灵活多样的码率控制方式，以适应多种应用场景,并支持了 AV1、VP9 编码；

④视频解码技术支持 HEVC、VP9、AV1、VVC、AVS3.0、LCEVC 等多种标准；

⑤支持码流的错误检测、视频缩放等后处理功能；

⑥具备完备的多种多媒体框架（V4L2/VA-API/FFmpeg/Android 等）软件的支持。

4) ZSP 数字信号处理器技术

芯原的 ZSP 数字信号处理器（DSP）技术为可编程的、对各种数字化的信号数据进行运算处理的处理器及配套技术。关键技术模块包括 DSP 内核读取并高效执行指令、进行内存数据读写及运算、内存及缓存管理、与外部其他子系统交互、软件开发及调试、应用软件库。

芯原数字信号处理器技术的具体表征如下：

①基于超标量(superscalar)架构。目前的标量 DSP IP 产品 ZSPNano 系列，除了针对低成本、超低功耗应用设计的 ZSP Nano、中端应用需求的 ZSP Nano Plus，公司还在 2023 年继续开发了高性能的 DSP 产品 ZSPNanoUltra，目前已经向市场推广。ZSPNanoUltra 具有更强的标量数字信号处理能力，单时钟周期可完成 8 个 16×16 bit 或者 4 个 32×32 bit 的乘累加运算，可被广泛应用于高清音频语音及通讯类芯片。其拥有的高代码密度、低功耗的优点，可以让客户的芯片面积更小，

能耗更低。软件开发环境以及应用软件库也在持续地更新迭代中，同时公司也在开发 AI 算法的性能加速模块，可在 ZSPNano 系列中选配；

②公司正在继续开发针对图像、机器视觉及先进无线通讯应用的矢量 DSP IP 产品 ZSP5000 系列，包括针对不同级别性能要求的内核产品的开发和优化，业界通用嵌入式机器视觉库 OpenCV、OpenVX 等的开发和优化，以及其它矢量 DSP 应用方案的规划和实施。

5) 图像信号处理器技术

芯原的图像信号处理器技术是控制图像传感器输出 RAW 图像并进行数字处理，优化图像质量，便于编码、显示和用于机器学习的技术。关键技术模块包括 ISP 高动态范围处理、去镜头阴影、去坏点、时域和空域去噪声、彩色噪声抑制、动态范围压缩、去马赛克插值、伽马校正、对比度增强、边缘增强、色彩校正、图像缩放、自动曝光、自动白平衡、自动对焦、与传感器系统交互以及标定，调试软件工具开发。

芯原图像信号处理器技术的具体表征如下：

①芯原图像信号处理器产品线种类丰富，可针对不同的应用市场，以优化相应的芯片面积和成本；

在 2021 年推出的获得 ISO 26262 ASIL-B 级别汽车功能安全标准认证的 ISP8000L-FS 版本，在 2022 年 6 月再度获得 IEC 61508:2011SIL2 级工业功能安全标准认证，以上证书均由功能安全咨询公司 Resil Tech 颁发；

研发成功了基于 Tile 机制的多核架构，可以支持 8K@30fps 的高分辨率和 4K@120fps 的高帧率摄像机需求；

研究并定义了新一代的 ISP8200 系列产品，单个 ISP IP 支持高达 8 颗摄像头和 2.0G Pixel/s 的高吞吐率像素计算，基于 ISO 26262 开发流程并设计实现车规安全机制，可以满足无人驾驶领域的应用需求，在市场上具备较强的竞争力；

2023 年 12 月第 2 代面向电动汽车应用的 ISP8200L-FS 和 ISP8200-FS 通过 ISO 26262 认证，达到随机故障安全等级 ASIL B 级和系统性故障安全等级 ASIL D 级。

2024 年 9 月基于畸变矫正技术的 DW200-FS 产品通过了 ISO 26262 认证，达到随机故障安全等级 ASIL B 级。

研发成功了基于 NeuroBrick 引擎的 AI 降噪技术，该技术以硬件加速器的形式实现并集成于 ISP 流水线，实现在低照度场景下的高性能噪声去除和抑制。

②核心技术包括符合 ISO26262 规定的 IP 开发流程、结合 ISP 流水线的安全架构和安全机制、多摄像头数据时分复用处理的调度技术、可扩展的多核控制技术、支持多曝光控制的高动态范围

（HDR）处理技术、动态范围压缩技术、局部色调映射技术、空域-时域运动自适应噪声去除技术、AI 降噪技术、去马赛克插值技术、高清晰度锐化和边缘增强、色彩管理和调制技术、镜头畸变矫正、缩放和格式转换、支持鱼眼镜头和多码流输出，基于 FLEXA 机制的低延迟处理和子系统设计；

③具备完善的软件控制，支持 V4L2 接口，拥有完备的标定和调试工具。

6) 显示处理器技术

芯原的显示处理器技术是一种进行图像显示处理的微处理器技术，支持高动态范围（HDR）的视频和图像处理，可以为 VGA 到 8K 的显示设备提供图像叠加、混合，色度、饱和度调整，伽马矫正，高动态范围色彩空间转换以及图像质量调优，支持超分辨率技术，局部动态对比度增强。

芯原显示处理器技术的具体表征如下：

①支持业界主流的 HDR 格式，例如 HLG、HDR10 和 HDR10+；

②支持从 VGA 到 8K 的显示分辨率，支持 8K@30FPS 和 8K@60FPS；

③支持多显示设备，可以同时驱动 2~5 个显示设备；

④支持主流 Linux 和安卓操作系统，提供 DRM 驱动程序，支持在自动驾驶领域广泛应用的 QNX 操作系统，支持 Windows 桌面操作系统，支持 Free RTOS，为可穿戴设备和 MCU 方案提供有效解决方案

⑤支持 AI 超分辨率技术，支持局部色调映射和全局色域映射，可以为汽车智能座舱及智能手机提供 HDR 效果的显示体验。

7) Vivante 智能像素处理 IP 平台

Vivante 智能像素处理 IP 平台包括从摄像头输入到显示输出（Glass to Glass）的像素处理关键技术。其中的关键 IP（GPU、VPU、NPU、ISP、DSP 和显示处理器 IP）高度可扩展，以满足从低功耗（如可穿戴设备）到需要高图像质量的高性能计算（如服务器和数据中心）等不同市场的需求。

除了关键 IP 外，芯原还开发了统一帧缓冲压缩（Unified Frame Buffer Compression）技术，通过无损或有损压缩来连接所有像素处理器 IP，以最大限度地减少 SoC 的整体 DDR 带宽。

芯原还开发了 FLEXA 同步接口通信技术，用以高效地连接多个 IP，从而形成面向低延时、低带宽和低功耗应用的子系统解决方案。

为应对汽车领域不断增长的市场需求，芯原为整个智能像素处理 IP 组合均部署了汽车功能安全计划。其中部分 IP 已获得汽车功能安全认证。芯原对汽车功能安全方面的前瞻性部署，使其 IP 组合处于有利地位，以捕捉汽车行业的商业机会，并加强公司在汽车电子领域的竞争优势。目前，

芯原的 IP 已授权给了全球 20 多家汽车电子客户。

凭借芯原在像素处理方面的关键技术和先进的嵌入式人工智能解决方案，公司已开发了 AI-ISP、AI-GPU 和 AI-Video 技术。

芯原的高端 VPU、NPU 和 GPGPU IP 被广泛应用于服务器和数据中心市场。公司的 Hantro VPU 被中国前 5 大互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 大云平台解决方案提供商中的 12 家所采用。通过引入超分辨率、高清图像增强处理，以及视频去抖动方案，芯原正在进一步增强和扩展其数据中心智能像素处理 IP 平台的能力。

芯原的低功耗 IP 和 IP 子系统解决方案已被作为手表等可穿戴设备和先进 AR 设备的事实行业标准解决方案，同时也很好地支持低功耗 IPC、智能门铃等产品。

8) 基于 FLEXA 的 IP 子系统

芯原 IP 子系统系列是由公司多种 IP 技术与芯原自有的 FLEXA 接口技术共同构建的一系列 IP 子系统。FLEXA 接口允许 IP 之间进行低延时、无 DDR 的数据交换，这使得芯原可以 IP 子系统的形式提供创新的技术，将传统的处理器 IP 与嵌入式人工智能技术深度融合，实现低功耗和高性能的混合计算，超低延时的从摄像头输入到显示输出的数据路径，以及无需 DRAM 的低功耗系统。

IP 子系统包括：

①AI-ISP:人工智能技术解决了传统 ISP 面临的挑战，如低光、降噪、去马赛克、HDR 和快速准确的自动对焦。芯原的 FLEXA 技术将 AI 引擎与 ISP IP 相结合，形成的 AI-ISP IP 可以显著增强传统 ISP 的功能，同时在 ISP 和 AI 引擎之间不引入额外的帧缓冲延时和 DDR 带宽。芯原的 AI-ISP 技术可帮助客户在智能手机、安防摄像头、汽车等产品和应用领域实现低功耗 AI 降噪。

②AI-GPU：混合计算是有效利用芯片计算资源的重要技术。芯原的 AI-GPU 致力于利用硬件之间的协作接口来提供高效率计算。通过在 AI 引擎和 GPU 之间灵活地共享资源，AI-GPU 可以运行比单独运行 AI 引擎或 GPU 引擎更大的 AI 或通用计算任务。此外，AI-GPU 还可优化并行的 AI 和计算任务，同时降低协作延时和数据传输功率。

③光线追踪 GPU：带光线追踪的 GPU 既需要光线追踪加速，也需要传统 GPU 渲染。FLEXA 支持 GPU 和光线追踪引擎之间的高吞吐量、低延时和低功耗集成。通过光线追踪扩展，芯原的 GPU 可以为 PC 和数据中心等应用场景提供高效的图形解决方案。

④ISP+视频编码器：通过 FLEXA 连接 ISP 和视频编码器，可优化摄像机系统的延时和功率。由面向可穿戴设备的 ISPNano 和 VCNano IP，以及 FLEXA 组合的子系统可提供无 DDR 和低延时的视频捕获和编码，这对 AR 眼镜和智慧手表非常重要。基于 FLEXA 的高性能 ISP 和编码器子系统可实现超低延时高分辨率视频编码，为 AR/VR、无人机和汽车等应用提供先进的解决方案。

⑤视频解码器+矢量 GPU：在 AR/VR 应用中，显示内容可以在手机或服务器中远程渲染，并通过视频流传输；而 AR/VR 可穿戴设备中的本地显示则需要超低延时和超低功耗。基于 FLEXA 的视频解码器+矢量 GPU 子系统提供了低功耗和低延时的显示解决方案，具有内联屏幕信息显示（OSD）绘制能力，这其中 GPU 功能作为视频后期处理器。

⑥ISP 子系统：通过在 ISP 和芯原自有的鱼眼畸变矫正 IP 之间采用 FLEXA 技术，可以使 ISP 子系统实现低延时处理路径，以及降低内存带宽并节省功耗。

9)低功耗蓝牙技术

芯原的低功耗蓝牙技术是基于 FD-SOI 工艺节点研发，能实现低功耗低成本的蓝牙连接和数据传输的技术。

芯原低功耗蓝牙技术的具体表征如下：

①低功耗蓝牙技术支持国际标准组织 SIG 定义的 BLE 标准，拥有包括低功耗射频收发机 IP、基带 IP、协议软件等；

②公司基于 22nm FD-SOI 工艺节点的高性能低功耗射频收发机 IP 和低功耗数字基带 IP 已通过 5.4 和 5.3 BQB 认证，可在各种 SoC 系统中快速集成；

③基于低功耗蓝牙 BLE 射频收发机 IP 开发了支持双模蓝牙 BTDM（经典蓝牙+低功耗蓝牙）的射频收发机 IP，兼容经典蓝牙的数据语音传输，为蓝牙无线耳机应用提供平台 IP 支持。

10)窄带物联网技术

芯原的窄带物联网技术是可支持各类物联网设备以超低功耗，并基于蜂窝通信网进行连接和互传数据的技术。该技术使得物联网设备具有超长待机时间，并具有可靠的通信网络连接和广泛覆盖。

芯原窄带物联网技术的具体表征如下：

①窄带物联网技术支持国际标准组织 3GPP 定义的 Cat-NB1 标准，实现远程低功耗物联网通信；

②射频收发机 IP 结合 22nm FD-SOI 工艺特点，采用先进电路架构，实现高集成度和高性能设计；数字基带 IP 实现标准 3GPP 定义的 Cat-NB1 标准，实现完整信号处理链路 RTL 实现，自主知识产权内核及协处理器子系统，以及实现物理层过程的固件。

2023 年，集成 NB-IoT IP 的 SoC 芯片通过电信入网认证测试，获得入网许可；同年，Turnkey 项目产品进入小批量试产并在模组中应用。

11)蜂窝物联网

蜂窝物联网是基于蜂窝网络基础设施的广域物联网连接的一个蓬勃发展的细分市场。芯原在这一领域拥有多种 IP 技术，包括 LTE-Cat4、LTE-Cat1 和 NB-IoT。Cat4 和 Cat1 广泛应用于便携式物联网设备，提供数十 Mbps 吞吐量的可靠数据通信，特别是具有语音通话的独特功能。它通过优化物联网应用的成本和功耗，与 4G/5G 手机调制解调器区别开来。基于运营商 4G 网络的无缝覆盖，LTECat4 和 Cat1 技术可以为许多无线连接场景提供最佳解决方案，包括空中视频流、语音通话智能手表和车到一切(“V2X”)通信。

芯原的蜂窝物联网技术具有以下特点：

①公司的技术分别支持 UE 类别 4 和类别 1，符合国际标准化组织 3GPP，其中特征和功能被严格定义。公司的设计支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)模式及其动态模式切换；

②公司的 LTE-Cat4 和 Cat1 技术涵盖数字基带处理和软件协议栈，包括可用于系统级芯片集成的完整调制解调器解决方案；

③公司自主研发的数字基带基于完善的算法模型，在 3GPP36.211、212、213 标准中实现了完整的 LTE 物理层功能，无线性能优势突出。采用先进的多天线处理算法，支持 RX 路径上的多输入多输出(MIMO)处理，提高吞吐量；

④基带实现包括 RTL 中的硬件引擎和运行在公司专有的 ZSP 处理器核心上的物理层固件。数据路径架构和运行时间轴由硬件/固件(HW/FW)协同设计优化；

⑤基带向无线电提供了一个灵活的接口，以便它可以以最小的适应连接到第三方射频收发器 IP 或芯片。接口支持公司自研的 Cat1RFIP，为 Cat1 提供整体的系统解决方案；

⑥公司的自研协议栈软件覆盖了 MAC/RLC/PDCP/RRC 和 3GPP Release9 中定义的 NAS 中的所有功能。

Cat4/Cat1 数字调制解调器 IP，作为一个具有简单接口的软 IP 核心可以很容易地集成到系统级芯片中，它帮助客户在短时间内实现产品中的蜂窝通信。

12) 1GHz 以下 (Sub1G) 公用频段射频技术

Sub1G 公用频段射频技术利用该频段良好的无线信号传输特性和频段使用的开放性，根据实际应用场景，可灵活提供面向室外中长距离的物联网无线连接的功能，满足各种定制化需求。

芯原 Sub1G 公用频段射频技术的具体表征如下：

①芯原开发的 900MHz 频段射频技术基于 22nmFD-SOI 工艺，具有高性能低功耗的优势，可支持峰值发射功率达 20dbm，结合基带 IP 可实现完整的 802.11ah 的物理层功能，支持 2MHz/1MHz 带宽的 OFDM 调制方式，在实际应用场景中实测支持超过 300 米的传输距离和最高 7Mbps 的数据传输率；

②芯原开发的 400MHz 频段射频技术基于 SMIC55nm 工艺，同样可支持峰值发射功率达 20dbm，接收机具有高增益低噪声高动态范围的优势，可抗 400MHz 频段上常见的强干扰，支持 OFDM 调制和 GFSK 调制方式。

13) GNSS 多模多频段射频技术

芯原的 GNSS 多模多频段射频技术支持 1.6GHz 及 1.2GHz 两大国际通用卫星导航信号频段，完全覆盖北斗、GPS、GLONASS、GALILEO 各种模式，尤其可对北斗 B1、B2、B3 全频段支持。可根据实际应用需求进行配置，满足高精度导航或低功耗定位的各种场景。

芯原 GNSS 多模多频段射频技术的具体表征如下：

①芯原的 GNSS 多模多频射频 IP 基于 22nmFD-SOI 工艺设计，结合工艺特点在 0.8v 工作电压下侧重优化前端性能，噪声系数小于 2dB；

②根据不同卫星信号模式，可灵活配置中频及带宽，可将多种模式的信号同时接收并通过 A/D 采样输出；

③结合高精度导航基带模块，实测捕获 C/N0 指标可达 40dB，可满足各种高精度导航定位应用；

④针对高精度导航定位需求，在单通道射频 IP 基础上进一步拓展支持双通道并行射频，可同时接收 L1/L5 两个频段的卫星信号，提升基带算法性能；

⑤面向高精度导航定位应用，继续开发了多通道并行射频，支持 7 通道大带宽同时信号接收；

⑥面向低功耗导航定位应用，采用 FD-SOI 和 FinFET 工艺继续开发下一代多通道 GNSS 射频 IP。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增 126 件发明专利申请、16 件商标注册申请、30 件集成电路布图设计登记申请，共获得 28 件发明专利授权、9 件商标注册核准、33 件集成电路布图设计专有权授权。

截至报告期末，公司累计获得有效授权知识产权为 205 件发明专利、3 件实用新型专利、2 件外观设计专利、12 件软件著作权、140 件商标及 264 件集成电路布图设计专有权。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	126	28	589	205
实用新型专利	0	0	3	3
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	12	12
其他	46	42	450	404
合计	172	70	1,056	626

3、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	1,247,302,342.65	947,223,117.16	31.68
资本化研发投入	0.00	7,171,677.11	-100.00
研发投入合计	1,247,302,342.65	954,394,794.27	30.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	53.72	40.82	增加 12.90 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00	0.75	减少 0.75 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

公司报告期内研发投入情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	面向数据中心和 GPU-AI 计算的高性能图形处理器技术	47,297.05	16,038.54	16,038.54	-3D GPU 总体架构文档，详细架构文档，设计文档编写 -验证环境搭建，验证方案编写，验证用例开发 -性能模型和功能模型代码编写， Benchmark 性能分析 -硬件代码编写 -后端实现方案架构设计	-支持 16~32TFLOPs FP32 算力 -支持 20~120 TFLOPs FP16 算力 -支持 40~240 TFLOPs FP8 算力 -支持 40~240 TOPs INT8 算力 -支持 128~1536Texel/cycle 纹理处理能力 -支持 32~384Pixel/cycle 像素填充能力	国际先进	-大规模并行计算 -桌面显卡 -车载信息娱乐 -工业显示 -物联网及可穿戴设备

						-支持 Tensor core -支持 DX12 FL12 -支持 CUDA9.0 和 CUDA12.0 -支持 windows 操作系统		
2	支持先进视频格式和 AI 视频的视频处理器技术	25,512.44	7,868.96	7,868.96	-新一代的视频编码基础架构已在 H264、H265、AV1 上基本实现,编码质量和性能已有良好的提升 -开始新一代 Nano 架构的基础设计	-针对数据中心，建立新一代的视频编解码架构，提升编解码质量和性能，支持更高标准的视频编解码格式 -视频编码新增 VVC 标准支持 -视频解码新增 AV2 标准支持 -满足更广泛的视频领域需要：支持 YUV444/422 12bit 以及 LC-EVC 等编解码格式和规范 -针对 IoT、监控市场对高性价比编解码 IP 的基础需求，建立新一代 Nano 系列编解码 IP -全面优化设计，让国产手机芯片编解码 PPA 和视频编解码质量达到和超越国际先进水平	国际先进	-数据中心的图像分析卡 -视频转码卡 -监控终端设备 -视频播放和记录设备，包括手机、平板电脑、汽车、无人机、智慧物联网等 -自动驾驶方案的视频处理单元
3	面向数据中心和边缘服务器端高性能 AIGC 应用的神经网络处理器技术	23,189.41	7,693.53	7,693.53	-进行新一代架构更新 -规划下一代架构	-支持基于 PyTorch 和 Tensorflow 的推理和训练 -支持 INT4/INT8/INT16/FP8/FP16/BF16 等多种数据格式 -高效支持基于 Transformer 架构的大模型 -支持 2:4 结构化稀疏，并提升模型压缩比 -单核算力支持 0.5 到 200 TOPS，多核架构支撑更大算力	国际先进	-人工智能服务器 -人工智能边缘计算 -智能家居与智能监控 -语音及视觉处理 -物联网及可穿戴设备
4	数字信号处理器技术	28,921.38	2,496.61	26,691.06	-已向客户交付矢量 ZSP IP 核	-采用多发射的优化改进的 RISC 架构 -在先进半导体工艺条件下，频率可达 1GHz，单时钟周期可完成多达 128 个 16x16 bit 乘	国际先进	-计算机视觉，如图像识别、VSLAM 等 -5G 及其它宽带无线通信

						累加运算 -单时钟周期可完成 256 个 8x8bit 乘累加运 算/128 个 16x16 bit 乘 累加运算		的基带信号 处理，如卫星 通信基带芯 片等 -人工智能语 音处理
5	AI-图像 信号处理 器技术	24,017.04	9,053.99	9,053.99	-AI-ISP 产品规 格的定义 -AI 降噪算法的 研究 -AI-ISP 的架构 研究 -AI 降噪算法和 硬件实现 -AI-ISP 的架构 设计和硬件集成	-支持 AI 处理引擎的集 成 -支持 AI 降噪算法 -支持 AI-HDR, AI-Demosaic -高性能 Camera 子系统的 设计	国际 先进	-安防监控 -汽车辅助驾 驶 -智慧家庭 -AIoT 等含摄 像头的产品
6	高画质 AI 显示处理 器技术	13,285.32	3,216.29	3,216.29	-算法研发 -方案设计 -IP 设计实现	-基于深度学习的低功 耗、低成本超分辨率解 决方案 -云端到边缘端的高画 质解决方案(面向云桌 面、云游戏、网络会议 等应用) -低功耗显示 IP 技术和 系统解决方案	国际 先进	-AIoT -智能手机 -平板电脑 -桌面显卡 -桌面显示器 -电视领域 -智能座舱
7	基于 FLEXA 的 子系统技 术	8,533.53	2,419.71	8,211.87	-IP 设计实现及 性能测试，部分 技术已芯片化	-ISP+视频编码器：支 持 H.264、HEVC、JPEG 低延时视频捕获和编 码	国际 先进	-手机 -安防 -车载电子设 备 -带 AI 功能的 MCU/MPU -PC -游戏设 备 -AR 眼镜和 可穿戴设备 -无人机
8	数模混合 IP - 基于 格罗方德 22nm FD-SOI工 艺的高速 接口及模 拟 IP 平台	10,367.95	1,495.90	9,800.91	-IP 均通过硅验 证及格罗方德的 CPA 认证，大部 分 IP 已得到量 产验证	-在格罗方德 22nm FD -SOI 工艺平台上拥有 完备、可靠及自主可控 的 IP 产品平台 -IP 平台包括通用接口 IP、各类数模及模数转 换 IP，及各类用于 SoC 芯片设计的模拟 IP	国内 先进	-IP 授权 -芯片定制
9	数模混合 IP - 超低 功耗模拟 IP 平台研 发	9,306.95	283.52	8,058.32	IP 均通过硅验证 及格罗方德的 CPA 认证，部分 IP 已经得到量产 验证	-开发出具有超低功耗 的面向物联网 MCU 应 用的模拟 IP 平台 -整体功耗达到国内领 先	国内 先进	-物联网、可 穿戴设备等 对于功耗要 求高的产品
10	物联网连	7,432.38	3,632.05	6,226.37	-完成超低功耗	-IP 核心工作电压可降	国	-广域物联网

	接技术-低功耗蓝牙 IP 研发				BLE IP 子系统的功能和性能测试工作。子系统工作电压为 0.65v，并实现根据场景实时动态功耗管理 -更新 BLE 射频电路设计，继续优化 IP 的功耗面积 -开展数字基带系统架构优化，已完成系统设计和部分模块更新	低至 0.65v，射频 IP 面积进一步缩减 30%，并进一步提升抗干扰特性 -重构数字基带系统，进一步降低工作时钟和占用存储，优化功耗和面积	国际先进	-智慧城市 -智能交通 -智慧农业等
11	4G Cat1 射频 IP 研发	6,745.42	1,400.61	3,174.53	-完成第二轮 IP 测试芯片流片，并开展相应的验证工作 -完成 Cat1 标准信令测试平台搭建和测试，可支持 IP 验证的各项功能和性能测试	-支持 3GPP R14，符合 36.101 射频规格定义 -支持 FDD 和 TDD 模式，单天线接收 -集成完整的发射和接收链路以及时钟电源模块 -采用 22nm 工艺，工作电压 0.8v，可与数字基带单芯片集成	国内先进	-广域物联网 -智慧城市 -智能交通 -智慧农业等
12	物联网连接技术-多通道 GNSS 射频 IP 研发	3,141.68	1,087.15	2,591.19	-完成 IP 在 SoC 的测试验证，并开始进入量产准备阶段 -低功耗版本 IP 已完成 FD-SOI 22nm 工艺上的设计并流片，等待回片验证 -已开展下一代 IP 在 FinFET 工艺上的研发	-支持全球 4 种导航卫星制式：GPS、北斗、Galileo、Glonass -支持单通道、双通道及多通道多种配置 -第一代采用 22nm FD-SOI 工艺，工作电压低至 0.8v 并保持高性能，第二代采用 FinFET 工艺制程，进一步降低工作电压和功耗 -集成大带宽高精度 ADC，提供可靠抗干扰能力	国际先进	-高精度导航 -智慧农业 -智能驾驶
13	芯片定制技术	24,086.27	11,729.36	16,226.45	-已建立多种硬件仿真器和 FPGA 原型系统，支撑不同类型客户的复杂 SOC 芯片验证 -已基于当前多种硬件仿真器和 FPGA 原型系统，完成多个客	-结合现有的硬件仿真器/FPGA 原型系统，进一步强化软硬件整合能力 -进一步升级现有硬件仿真器和 FPGA 原型系统的容量规模，支撑更大规模 SOC，多芯粒 chiplet 的芯片验证工作	国际先进	-消费电子 -汽车电子 -计算机及周边 -工业 -数据处理 -物联网

					户的芯片验证和早期软件版本的交付 -已建立基于 IP 模型的 SOC 虚拟机平台并成功应用于客户项目			
14	基础软件平台	1,272.37	401.69	1,272.37	-Chromium, Linux 平台软件已完成所有功能开发 -FreeRTOS 已经搭建了系统软件框架，正在集成芯原 NPU IP -基于数据中心应用的视频编解码框架已集成了基于芯原 NPU 的 AI 图像质量提升方案 -项目已于报告期内完成投入并结项，基本完成项目目标	--Linux、FreeRTOS、Chromium、Android、Windows 在芯原自有 IP 或通用平台上的开发和支持 -软件开发验证平台-基于基础软件平台的视频、显示、音频等模块软件包开发	国内领先	-消费电子 -物联网 -汽车电子 -工业控制等
15	自动驾驶系统	2,500.47	1,126.05	2,500.47	-硬件平台底层系统功能开发 -基于机器深度学习的目标物体及车道线检测算法模型的研发 -人工智能模块和框架模型在硬件平台上的验证 -在原型验证的车辆上完成多算法集成、多传感器融合调试及初步验证，摄像头实时算法已实现疲劳检测、语音和面部识别等功能 -项目已于报告期内完成投入并结项，基本完成项目目标	-基于芯原机器深度学习技术的前视和周视算法模型的研发和验证 -多算法及多传感器融合集成开发验证 -Linux、Android 平台软件及多媒体组件开发	国内领先	-自动驾驶 -智能座舱 -车载信息娱乐
16	IOT 系统平台	3,576.47	1,420.14	3,576.47	-低功耗蓝牙整体解决方案已完成 BLE5.3 认证	-实现 AR/VR 及健康医疗领域的产业化落地	国内领先	-物联网 -可穿戴设备 -AR/VR

					-BLE 蓝牙 LE Audio 功能已完成初版和 demo - LE Audio 协议栈和音频 LC3 编解码器完成蓝牙 SIG 认证 -低功耗蓝牙 5.3 Mesh 完成蓝牙 SIG 认证 -项目已于报告期内完成投入并结项，基本完成项目目标		先	-健康医疗
17	Cat1.bis IP 系统	10,509.73	4,905.79	10,017.30	-基带芯片完成全部功能验证，达到设计目标 -基带算法持续优化中，PPA 优化方案已开展 -软件协议栈优化方案确定，合并原双 CPU 方案为单 CPU -一致性测试接近尾声 -射频、基带一体化子系统规划完成，开始初步测试	-优化数据路径中的基带硬件设计，以减少逻辑闸门数量和内存使用，实现下行 10Mbps/上行 5Mbps 吞吐量 -升级接收器算法以支持单输入单输出 (SISO)处理 -基于自有 ZSP G5 核完成物理层固件和高层协议栈执行，实现更好的性能和更低的功耗 -基于自有 ZSP G5 核，根据优化 PPA 的新目标，调整基带时钟频率 -优化协议栈软件，并在 ZSP G5 核上运行，减少代码/数据大小，减少内存使用 -升级节电机制，减少休眠模式下的漏电	国内领先	-车辆/资产追踪 -移动支付 POS 机 -共享设备的管理 -基础设施的远程控制
18	接口类 IP	10,570.48	2,884.27	2,884.27	-UCIe PHY 第一版开发已回片，即将进行封装和测试 -UCIe 控制器 IP 完成设计，即将和第二版 UCIe 物理层 IP 一起完成流片，实现整个 UCIe 子系统的验证和测试 -HSS_DSP_SERDES 架构设计已经完成，开始	-为构建复杂 SoC 或 Chiplet 提供可靠的接口技术，包括 UCIe 物理层和控制器、LPDDR 控制器、I3C 接口、以及高速 HSS_DSP_SERDES 解决方案等 -车规级 MIPI CD-PHY IP： - 取得功能安全 ASIL-B 证书 -车规级 MIPI CSI-2	国内领先	-Chiplet 应用 -数据中心 -ADAS 和自动驾驶 -AIGC 相关应用等 -车载视频传输 -工业视频长距离传输

					进行具体电路模块设计 - 车规级 MIPI CD-PHY IP: 功能安全分析已经完成。 功能安全审计工作已经开始 -车规级 MIPI CSI-2 Host 和 Device 控制器 IP' MPW 功能验证已经完成 功能安全设计已经启动 - A-PHY Source 和 Sink IP: 规划 A-PHY Source 和 Sink IP 的可靠性和一致性测试	Host and Device 控制器 IP: 取得功能安全设计 ASIL-B 证书 - A-PHY Source 和 Sink IP: 完成 IP 相关的可靠性测试 完成 IP 的一致性测试		
合计	/	260,266.34	79,154.16	145,102.88	/	/	/	/

情况说明

无

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	1,800	1,662
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	89.37	89.16
研发人员薪酬合计	115,707.09	97,380.01
研发人员平均薪酬	64.28	58.59

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	21
硕士研究生	1,574
本科	197
专科	8
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	1,047
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	497
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	196

50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	50
60 岁及以上	10

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
☐适用 ☒不适用

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、丰富的核心半导体 IP 积累，领先的芯片设计能力

芯原的主营业务为半导体 IP 授权业务和一站式芯片定制业务。通过 20 余年的高研发投入和深度积累，公司已经在半导体 IP 和芯片定制领域形成了丰富的技术池和服务经验。

公司拥有丰富的核心半导体 IP 积累，包括 GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP、Display Processing IP 这六类处理器 IP、智能像素处理平台、基于 FLEXA 的 IP 子系统，1,600 多个数模混合 IP 以及多种物联网连接（含射频）IP 等，并在 22nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个 FD-SOI 模拟及数模混合 IP，为国内外知名客户提供了 41 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 31 个项目已经进入量产，且累计向 42 个客户授权了 290 多个/次 FD-SOI IP 核。同时，利用现有设计平台和已有项目经验，公司可根据客户需求对数模混合 IP 进行定制，并针对具体应用场景进行架构和设计的深度优化，实现客户产品的差异化定制。

芯原还开发了 FLEXA 同步接口通信技术，用以高效地连接多个 IP。FLEXA 接口允许 IP 之间进行低延时、无 DDR 的数据交换，这使得芯原能够以 IP 子系统的形式提供创新的技术，将传统的处理器 IP 与嵌入式 AI 技术深度融合，实现低功耗和高性能的混合计算，超低延时的从摄像头输入到显示输出的数据路径，以及无需 DRAM 的无 DDR 系统。基于此，公司形成了包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案，进一步强化了公司核心技术的市场竞争力。

根据 IPnest 的最新统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六；根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。知识产权授权使用费收入的全球排名高于 IP 整体收入的全球排名，反映了公司的 IP 整体业务具有很好的成长性——随着后续客户产品的逐步量产，公司将进一步收取特许权使用费收入，公司 IP 授权业务的规模效应将进一步扩大。而拥有较为齐备的 IP 组合和较多的 IP 数量，使得芯原在产品功能和应用领域的多样性上

具有了更多的扩展空间、亦给予客户较为全面的选择，体现了公司在技术上的实力、积累和可靠性。同时，由于各类 IP 均来源于公司自主研发的核心技术，且在研发时考虑了各 IP 间的内生关联和兼容性，使得其具有较强的耦合深度、可控性和可塑性。

除了丰富的半导体 IP 外，公司还具有领先的芯片设计能力，拥有从先进的 5nm FinFET 到传统的 250nm CMOS 工艺节点芯片的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm 系统级芯片一次流片成功，多个 5nm/4nm 一站式服务项目正在执行。保持多种主流技术路线共同发展，有助于公司根据不同工艺节点和不同技术路线的特点，帮助客户采用能满足其应用场景和特定需求，并能在功耗、尺寸、性能、成本等各方面指标达到平衡的最优方案。同时，利用现有设计平台和已有项目经验，公司可根据客户需求对数模混合 IP 进行定制，并针对具体应用场景进行架构和设计的深度优化，实现客户产品的差异化定制。

此外，芯原的芯片设计流程也已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，通过这个认证将加速公司在电动汽车和智能汽车领域的战略布局。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的高级驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深度合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

2、全面布局 AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心和物联网领域，已占据有利市场地位

公司根据自身的技术、资源、客户积累，并结合市场发展趋势，已逐步在 AIGC、汽车电子、可穿戴设备、数据中心和物联网这 5 个领域形成了一系列优秀的平台化解决方案，并在上述应用领域取得了较好的业绩和市场地位。

① 在 AIGC 领域，芯原全球领先的 NPU IP 已在 82 家客户的 142 款芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、平板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货超过 1 亿颗。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。

公司基于约 20 年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的 GPGPU IP 可提供从低功耗嵌入式设备到高性能服务器的计算能力，以高度可扩展的 IP 核重新定义了计算市场，以满足广泛的人工智能计算需求。目前，芯原的 GPU 和 GPGPU-AI IP 在全球范围内获得了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。报告期内，公司还推出了全新 Vitality 架构的 GPU IP 系列，集成了诸多

先进功能，如一个可配置的张量计算核心（Tensor Core）AI 加速器和一个 32MB 至 64MB 的三级（L3）缓存，提供强大的处理能力和出色的能效表现，并支持多核扩展，广泛适用于云游戏、AI PC、独立显卡和集成显卡等应用领域。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，报告期内，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入(Token)。目前公司还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

② 在智能汽车领域，公司已耕耘多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。多家全球知名的汽车 OEM 厂商都采用了芯原的 GPU 用于车载信息娱乐系统或是仪表盘；芯原的神经网络处理器 IP 也已经获得了多家客户用于其 ADAS 产品；芯原的第一代 ISP IP 获得了 ISO 26262 汽车功能安全标准认证和 IEC 61508 工业功能安全标准认证；芯原的第二代 ISP 系列 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证；芯原的畸变矫正处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证；芯原的显示处理器 IP 获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。公司其他 IP 也正在逐一通过车规认证的进程中，并预计将在近期陆续通过各类车规认证。目前，公司的各类处理器 IP 获众多汽车芯片企业采用，例如，合肥杰发科技有限公司在其新一代智能座舱域控 SoC AC8025 中采用了芯原的高性能 IP 组合，包括 NPU IP、VPU IP，以及显示处理器 IP。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。目前，公司已为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

③ 在智慧可穿戴领域，芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和基于虚拟现实技术的智能眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低功耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。芯原还拥有面向 AR/VR 领域的极低功耗高性能芯片设计平台，可以打造适应不同功率模式的产品，满足超轻量实时在线、低功耗以及全性能的全场景应用。目前，已有超过 20 家核心智能手表芯片客户采用了芯原的 IP，并广泛应用于市面在售的各类主流智能手表品牌中。芯原正在着力 AI/AR 眼镜的技术平台优化和产业化，除了已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务之外，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。

芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，以期推动可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

此外，芯原正在全面搭建基于芯原技术的可穿戴系统生态。目前，专注于提供图形用户界面（GUI）软件服务的趣戴科技（QDay Technology）宣布加入芯原的全球手表 GUI 生态系统，双方共同开发适用于各种应用的智能手表 GUI 解决方案。芯原还与嵌入式系统领域领先的开源图形库 LVGL 达成战略合作，在 LVGL 库中支持芯原的低功耗 3D 和 VGLite 2.5D GPU 技术，旨在为广泛的嵌入式应用提供优化和扩展的图形处理能力；低功耗 AIoT 芯片设计厂商炬芯科技股份有限公司是首批采用这一解决方案的企业之一，其智能手表系统级芯片结合芯原低功耗 GPU 技术与 LVGL 图形库，提升新一代可穿戴设备的用户体验。

④ 在数据中心/服务器领域，芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 12 家的采用。目前，公司面向数据中心应用的视频转码平台项目进展顺利，第一代平台已于 2021 年第二季度完成研发工作，并以 IP 授权、一站式芯片定制业务等方式获得多家客户的采用，已完成适配并陆续量产；目前，基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K，增加了对 AV1 格式的支持，并新增了 AI 处理能力，此外，还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。

报告期内，芯原推出面向下一代数据中心的全新 VC9800 系列 IP，该系列 IP 具备高性能、高吞吐量和服务器级别的多码流编解码能力，可支持最高 256 路码流，并兼容所有的主流视频格式，包括新一代先进格式 VVC 等；该系列 IP 还可针对 AI 计算，与芯原的 NPU IP 实现无缝交互，达到了 OpenCV 级别的精度，并在视频处理子系统中引入了超分辨率技术，大幅提升了图像质量，可满足包括视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求。

⑤ 在物联网领域，芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台。例如，公司持续拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。目前上述所有射频 IP 已经完成 IP 测试芯片的流片验证，大部分已在客户芯片中与基带 IP 集成，形成完整的连接技术方案，应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术多年。目前，公司在 22nm FD-SOI 工艺上开发了超过 60 个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等，已累计向 42 个客户授权了 290 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 41 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 31 个项目已

经进入量产。公司将继续基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

3、战略布局 Chiplet 技术和应用，领跑基于 Chiplet 的 AIGC 和智驾系统赛道

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制业务的产业价值，拓展市场空间。目前，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，正在稳步推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。

公司在 Chiplet 领域已经取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCle 物理层接口，相关测试芯片已流片，即将返回进行封装和测试；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

4、领先的从硬件到软件的平台化服务能力，满足日益增长的系统级客户的需求

为更好地满足系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体对包含软件的整体解决方案的需求，芯原还将公司服务范围从硬件拓展至软件。通过为客户提供软件开发平台、面向应用的软件解决方案、软件开发包、定制软件、软件维护与升级等服务，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市场。软件支持服务可增强公司的议价能力，增加客户的合作粘性，扩大公司服务内容的范围，从而进一步扩大公司的业务发展空间。例如，基于芯原出色的软件设计和定制能力，公司与微软就 Windows 10 IoT 企业版操作系统开展合作，合作内容涵盖硬件加速器，以及对功能强大的嵌入式平台的长期支持。芯原利用自身的嵌入式软件设计能力和数十年推出成功产品的经验，使嵌入式应用开发人员和原始设备制造商（OEM）能够基于可信赖的操作系统，使用熟悉的开发和管理工具快速创建、部署和扩展物联网解决方案，并通过微软 Azure IoT 将设备无缝连接到云端。

通过将公司的半导体 IP、芯片定制服务和软件支持服务等全面有机结合，芯原可为客户提供

全面的系统级平台解决方案，有效满足了系统厂商、互联网公司、云服务提供商、车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片的需求。2024 年，芯原系统级客户（非芯片设计公司）所产生的收入占比约 40%，且连续 5 年保持在 30%以上。

在与大型互联网企业、云服务提供商等客户的合作中，公司的系统级平台解决方案与客户所提供的服务还可形成较为完整的按应用领域划分的生态系统，有助于为相关市场高效率地打造应用产品，帮助客户快速扩大生态范围。

5、独特的商业模式带来业务之间的紧密协同效应

芯原的一站式芯片定制业务和半导体 IP 授权业务之间具有较强的协同效应，有利于公司技术水平和服务能力的持续提高。两项主要业务之间的客户也可互相导入，共同促进公司研发成果的价值最大化。

对于客户而言，在一站式芯片定制业务中使用芯原自有 IP，与使用并集成不同第三方 IP 相比，在成本和设计效率等方面更具优势。同时在为客定制芯片的过程中，公司不但可收集和了解不同行业应用领域对 IP 各技术指标的需求，从而沉淀和打磨出更符合市场需求的 IP，也会根据客户需求定制新的 IP，从而持续丰富公司的 IP 资源库。

芯原在为客户提供半导体 IP 授权服务的过程中，优质的 IP 和服务逐步受到客户认可。当客户出现新的芯片定制需求时，基于已有合作基础，会优先考虑采用芯原的一站式芯片定制服务。

6、灵活的业务模式可服务多元化的客户群体，市场空间和潜力巨大

芯原的服务能力包括半导体 IP 授权、IP 定制、IP 平台授权、芯片设计服务、芯片量产服务、软件定制与支持、系统平台定制等。客户可根据自己的需求选择其中一项或者多项服务，这使得芯原的业务模式具有很强的灵活性，可面向集成电路的各类应用领域，广泛服务包含成熟的芯片设计公司和 IDM、新兴的芯片设计公司、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商、车企在内的各种类型的企业。

类别广泛的客户群体，给公司带来更多的业务机会和发展空间。包括与领先的芯片设计公司合作开发先进的技术，帮助平台化的互联网企业打造硬件生态系统等。这类合作将有助于提升公司的业务能力和核心竞争力，并降低应用市场波动带来的风险，使公司得以拓展更大的市场空间，具备更好的发展潜力。

7、晶圆厂中立策略更好地应对供应链风险

在产业链生产环节受到较大生产压力时，芯原晶圆厂中立的设计服务模式使得公司对供应链管理更为灵活，抗风险能力更为突出，这主要表现在：①公司晶圆厂中立的策略，这使得芯原可以和全球所有主流的晶圆厂合作，不受限于某一家公司的发展情况；②公司跟大多数晶圆厂超过

10 年或 15 年的长期合作关系，保持了良好的沟通；③在长期合作中，芯原建立了良好的商业信誉，供应商会按历史合作数据预留产能；④公司可以通过打包的方式拿到产能，有自己的资源池，通过内部资源再分配，对中小企业友好；⑤不同生产工艺的短缺时间和程度不一样，因芯原客户多样化，可以做一定的调整 and 平衡。

8、SiPaaS 商业模式具有“逆周期”属性

半导体的发展有正常的波动周期，一般在遭遇产业下行时期，芯片设计企业大多采取韬光养晦的策略，积极储备新产品等待产业复苏，而困难时期不便扩张，因此产业下行时期多需要寻求优质的芯片设计服务公司来进行合作；此外，产业下行时期也是收购半导体 IP 和半导体 IP 公司的良好时机。因此，芯原独特的商业模式在半导体产业下行时期也有潜力与机遇。

9、持续的高研发投入打造高竞争壁垒

芯原所处的集成电路设计行业，是集成电路产业的上游行业，相对产业链中其他行业而言，需要更早地进行针对性的布局 and 研发。因此集成电路设计行业呈现投资周期长，研发投入大的行业格局。近几年，全球排名前十的芯片设计公司的研发费用占营业收入比例大多维持在 20%-30%。公司持续多年对半导体 IP 技术及芯片定制技术进行布局 and 研发，近年来研发投入占营业收入的比重一直保持在 30%以上，且报告期内占比高达 89.37%的研发人员中，硕士及以上文凭的研发人员占比达 88.61%。因此，芯原的研发投入 and 研发能力一直保持在较高水平，以保持其半导体 IP 储备 and 一站式芯片定制业务的竞争优势，从而打造了高竞争壁垒。

10、丰富的人才储备

坚持引进 and 培养优秀人才是公司生存 and 发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。

根据长期技术发展战略 and 现有人才储备情况，在引进外部人才方面，公司不仅通过内部推荐、网络招聘等各种方式招募有经验的优秀人才，也通过每年线上校园招聘会、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术讲座，搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”、“海南大学生物医学工程学院-芯原医疗电子创新实验室”、“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”，以及成为东南大学信息科学与工程学院 and 海南大学生物医学工程学院的校外实习基地等，以此来吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生，为公司持续稳定发展提供人才储备。

在内部人才培养方面，公司不断实行完善有效的培养方案 and 公开透明的晋升机制，包括通过线上线下的技术 and 管理培训，提高员工的综合发展能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面提高员工的凝聚力。

截至 2024 年 12 月末，公司研发人员合计 1,800 人，研发人员的占比为 89.37%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达 88.61%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 26%，员

工平均年龄为 32 岁。基于上述行业及公司特征，公司的研发能力一直保持在较高水平，建立了理论知识扎实、研发实力强、经验丰富的研发团队，保持了业务的竞争优势，从而打造了高竞争壁垒。

2023 年全行业面临严峻挑战，应届毕业生就业形势不容乐观，公司通过合理的薪酬吸纳优秀毕业生，为未来的技术研发储备人才。2023 年下半年，公司招聘的 500 多名应届毕业生，相关人员均拥有硕士及以上学历，其中硕士 985、211 院校占比 94%，硕士 985 院校占比 70%。2024 年下半年招聘的 200 多名应届毕业生中，硕士 985、211 的占比为 97%，其中本硕都是 985、211 的占比 85%。得益于公司优异的招聘质量和高效的培训机制，2023 年招聘的应届毕业生对今年已经展开和正要承接的多个芯片大项目提供了必要的人力资源。

公司基于对行业周期的判断，一定规模人才储备能够帮助公司在竞争中抢占先机，吸引和培养未来的核心人才，增强企业的竞争力。公司逆势招聘优秀专业人才的战略有助于在行业复苏时快速抓住市场复苏机遇，实现收入增长。

得益于公司优秀的企业文化，公司人才稳定性保持于较高水平，2024 年，芯原中国大陆地区员工主动离职率为 2.1%，远低于中国大陆半导体行业平均约 9.4%的主动离职率（怡安翰威特人力资本调研数据）。

11、积极践行企业社会责任，ESG 成果突出

芯原一贯秉持“合规管制、以人为本、芯火燎原、关爱地球”的 ESG 理念，积极践行企业社会责任，包括人才选拔、培养和激励，技术创新和产业赋能等。公司积极响应国家“双碳”战略，立足本行业特点，携手供应链，将绿色低碳融入到技术提升中。此外，公司还主办或协办多个产业论坛和大赛，推动集成电路产业生态建设和产教融合。

2024 年，芯原荣登前程无忧“2024 中国典范雇主”榜单，同时获评“HR 管理团队典范”单项大奖，并在“2025 年人力资源管理杰出奖”评选中荣获“2025 中国杰出雇主”及“最佳培训实践奖”两项殊荣。此外，芯原荣膺猎聘 2024 上海地区年度非凡雇主、牛客网 2024 年度 NFuture 大学生最喜爱雇主，并在第四届“芯雇主”半导体行业人力资源优秀案例评选中荣获“年度雇主”奖。

芯原已连续三年披露企业社会责任报告，连续三年获得 WIND ESG 评级 A，连续两年获得“IC 风云榜‘企业社会责任奖’”，荣获毕马威中国“2022 年度 ESG 报告奖”，入选“2023 上市公司 ESG 创新实践案例”，并获得“2024 年浦东新区中外企业可持续发展 (ESG) 产业生态创新大赛优秀案例”和“2024 年浦东新区中外企业可持续发展 (ESG) 优秀案例”。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

（一）尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

☒适用 ☐不适用

1、经营业绩无法按计划增长的风险

2024年度，公司实现营业收入23.22亿元，较上年同期下降0.69%。由于产业下行周期客户项目短期有所减少，公司较以往加大了研发投入的比重，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6.01亿元，归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润为-6.43亿元。

若未来出现宏观经济下行、行业竞争加剧、上游原材料供应紧张或涨价、下游市场需求继续减少、重要客户或供应商与公司合作关系变动等对公司经营构成不利影响的变化，而公司未能采取有效应对措施，则可能存在经营业绩无法按计划增长或出现下滑的风险。

（三）核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

1、研发失败、产品或服务无法得到客户认同的风险

公司能否顺利开展研发活动并形成满足客户需求的产品或服务，对其正常经营乃至未来实现持续盈利具有重要作用，公司研发活动面临的风险主要包括研发方向与行业未来发展方向不一致的风险、集成电路设计研发风险、技术升级迭代风险等，详见本节之“（三）核心竞争力风险、（六）行业风险”相关内容。如出现上述风险从而导致研发活动失败，公司的产品或服务将面临难以满足客户需求、无法得到客户认同的风险，进而对其经营产生不利影响。

2、集成电路设计研发风险

公司的集成电路设计研发风险主要由于公司设计服务技术含量较高、持续时间较长，可能面临研究设计未能达到预期效果、流片失败、客户研究方向或市场需求改变等不确定因素而导致公司签署的服务合同存在较预期提前终止或延期支付的风险，可能会对公司未来的收入和盈利能力产生一定程度的影响。

3、技术升级迭代风险

集成电路设计行业下游需求不断变化，产品及技术升级迭代速度较快，芯片制程不断向28nm、14nm、7nm、5nm等先进制程演变。该行业仍在不断革新之中，且研发创新存在不确定性，公司在新技术的开发和应用上可能无法持续取得先进地位，或者某项新技术的应用导致公司现有技术被替代，将导致公司行业地位和市场竞争力下降，从而对公司的经营产生不利影响。

（四）经营风险

√适用 □不适用

1、研发人员流失风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。截至报告期末，公司拥有研发人员 1,800 人，占员工总人数的 89.37%。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等，将难以引进更多的高端技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，将对公司生产经营产生不利影响。

2、技术授权风险

半导体 IP 指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块，EDA 工具为芯片设计所需的自动化软件工具。公司在经营和技术研发过程中，视需求需要获取第三方半导体 IP 和 EDA 工具供应商的技术授权。报告期内，公司半导体 IP 和 EDA 工具供应商主要为新思科技和铿腾电子，如果由于国际政治经济局势剧烈变动或其他不可抗力因素，上述供应商均停止向公司进行技术授权时，将对公司的经营产生不利影响。

3、半导体 IP 授权服务持续发展风险

公司目前拥有 GPU、NPU、VPU、DSP、ISP、Display Processing 类处理器 IP、1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。报告期内，公司半导体 IP 授权业务收入为 7.36 亿元，占营业收入总额比例为 31.70%。公司未来半导体 IP 授权业务能否持续增长不仅取决于能否成功拓展新客户和继续与存量客户维持合作，还取决于公司拥有及未来将要研发的半导体 IP 在性能、用途等方面能否满足客户需求。若无法满足上述条件，则半导体 IP 授权服务存在难以持续发展的风险。

4、与芯思原利益冲突的风险

芯思原为公司的联营公司，与公司同属于集成电路行业企业，且公司的董事及高级管理人员 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、施文茜同时在公司和芯思原处担任职务。随着公司和芯思原的业务拓展，如未来因此导致公司与芯思原主营业务出现重大利益冲突，或芯思原在资产、人员、财务、机构、业务等方面不再具备独立性，亦或 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、施文茜在同时担任公司及芯思原职务时未能适当履职，均将会导致公司的利益受到损害。

5、海外经营风险

公司在美国、欧洲、日本、中国香港、中国台湾等地区设有分支机构并积极拓展海外业务。报告期内，公司来源于境外的收入金额为 8.69 亿元，占公司营业收入总额的 37.43%。海外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护等多种因素影响，随着公司业务规模的不断扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，会对海外

经营的业务带来一定的风险。

（五）财务风险

√适用 □不适用

1、商誉减值风险

截至报告期末，公司因2004年9月收购上海众华电子有限公司100%股权、2016年1月收购图芯美国100%股权，合计形成商誉1.82亿元。公司至少每年对收购形成的商誉执行减值测试，如果被收购公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，可能对公司的当期盈利水平产生不利影响。

2、应收账款余额较大及发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款账面余额为11.40亿元，占当期期末流动资产的比例为43.19%。随着公司经营规模的不断扩大，业务拓展的不断加快，应收账款金额可能进一步增加。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化从而导致个别客户财务状况恶化，则公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。

3、芯片定制业务毛利率波动风险

报告期内，公司一站式芯片定制业务收入为15.81亿元，占当期营业收入比例为68.09%。报告期内，公司一站式芯片定制业务毛利率为16.35%。随着技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、技术实力停滞不前或行业地位下降，将导致公司一站式芯片定制业务毛利率出现下降的风险。

4、所得税优惠政策变动的风险

报告期内，公司被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率；公司控股子公司芯原成都被认定为西部地区鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税；公司控股子公司图芯上海、芯原北京因满足小型微利企业的要求，对年应纳税所得额不超过100万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万但不超过300万的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司控股子公司芯原海南被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。公司控股子公司芯原南京被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。如果未来上述企业不能继续享受所得税优惠税率，或未来国家主管税务机关对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

（六）行业风险

√适用 □不适用

1、研发方向与行业未来发展方向不一致的风险

集成电路设计企业需要根据行业发展趋势进行前瞻性的研发设计，研发方向与行业未来发展方向是否一致较为重要，若公司未来不能紧跟行业主流技术和前沿需求，将有可能使公司技术研发方向与行业发展方向及需求存在偏差，无法满足下游客户的需求，从而对公司的经营产生不利影响。

2、行业增长趋势减缓或行业出现负增长的风险

根据市场研究机构 IC Insights 的最新报告显示，全部集成电路产业 2021-2026 年增速预期达 6.9%，其中逻辑电路以 7.9% 的增速领跑，主要是受汽车、工业等应用的高需求带动。未来如果行业增长趋势减缓或行业出现负增长，可能会在存量市场中出现竞争加剧、产品需求下降等导致行业参与者销售收入降低的情形。公司所处行业发生不利变化将有可能直接影响公司的业务收入，从而对公司的经营产生不利影响。

（七）宏观环境风险

√适用 □不适用

1、国际贸易摩擦风险

近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，逆全球化思潮出现。部分国家通过贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了客观不利影响，中国企业将面对不断增加的国际贸易摩擦和贸易争端。报告期内，公司来源于境外的收入占比较高，若未来与中国相关的国际贸易摩擦持续发生，可能会对公司的经营产生不利影响。

2、汇率波动风险

目前，公司在境外设立了多个分支机构，业务已覆盖美国、欧洲、日本、中国香港、中国台湾等境外市场。报告期内，公司来源于境外的收入金额为 8.69 亿元，占公司营业收入总额的 37.43%。如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

（八）存托凭证相关风险

□适用 √不适用

（九）其他重大风险

√适用 □不适用

1、法律风险

（1）知识产权风险

公司的核心技术为芯片定制技术和半导体 IP 技术，公司通过申请专利、集成电路布图设计专有权、软件著作权等方式对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，并在需要时取得第三方知识产权授权，避免侵犯他人知识产权，但无法排除竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，阻碍公司正常业务发展的风险。

若中美贸易摩擦持续恶化，美国政府将公司及境内子公司列入美国商务部工业安全局编制的实体清单，则芯原开曼、图芯美国无法向公司及境内子公司销售含有美国注册专利技术的产品；若美国政府将中国境内客户列入实体清单，则芯原开曼、图芯美国无法向中国境内客户销售有美国注册专利技术的产品。若上述两种情况发生，则会导致芯原开曼、图芯美国的美国注册专利所涉及的相关技术在相关客户产品上的使用受到一定限制，会对公司经营业绩造成一定影响。

（2）非专利技术和技术秘密等泄露风险

公司通过不断积累和演化已形成了较为丰富的非专利技术和技术秘密，其对公司发展具有重要意义。公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题，不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险。

（3）台湾分公司未完成投资者身份变更登记的风险

台湾分公司作为公司在中国台湾地区的销售与客户联络处，尚待取得台湾地区经济部投资审议司关于陆资投资者身份变更登记的许可，未取得该等许可可能会招致罚款、要求撤回投资、撤销或废止外国公司认许或登记等处罚。

2、内控风险

（1）股权分散、无控股股东和实际控制人的风险

公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。截至报告期末，公司第一大股东 VeriSilicon Limited 持股比例为 15.12%。公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

（2）子公司控制的风险

截至报告期末，公司共有 6 家境内控股子公司，8 家境外控股子公司，且业务范围覆盖境内外多个国家或地区，地域较为分散，公司可能存在对控股子公司管理不善而导致的内控风险。

（3）公司规模扩张带来的管理风险

自 2020 年公司首次公开发行股票并在科创板上市后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数将相应增加，需要公司在资源整合、市场开拓、技术研发与质量管理、内部控制等诸多方面进行调整优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司经营决策、组织管理、风险控制的难度也随之加大，公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23.22 亿元，同比下降 0.69%；2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-6.01 亿元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润-6.43 亿元。具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,321,885,572.72	2,337,996,408.69	-0.69
营业成本	1,396,323,107.77	1,291,724,278.39	8.10
销售费用	119,983,461.86	114,853,388.02	4.47
管理费用	122,283,801.14	119,446,242.40	2.38
财务费用	7,075,790.83	-4,888,181.11	不适用
研发费用	1,247,302,342.65	947,223,117.16	31.68
经营活动产生的现金流量净额	-345,990,209.33	-8,523,893.46	不适用
投资活动产生的现金流量净额	46,525,615.00	-426,196,042.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	248,131,929.88	356,581,231.92	-30.41

营业收入变动原因说明：具体内容详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

营业成本变动原因说明：主要由于本年芯片设计业务成本增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用与上年度基本持平。

管理费用变动原因说明：管理费用与上年度基本持平。

财务费用变动原因说明：主要由于长期借款利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：受研发人员人数增加影响，研发人力成本增加，研发费用较上年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本年交易性金融资产到期，导致收到的其他与投资活动有关的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年下降，主要由于本年偿还债务支付的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
☐适用 ☒不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

2024 年度，公司实现营业收入 23.22 亿元，同比下降 0.69%。报告期内，公司实现毛利 9.26 亿元，同比下降 11.54%。公司 2024 年度综合毛利率 39.86%，较上年同期下降 4.89 个百分点，主要由于收入结构变化及一站式芯片定制业务毛利率下降等因素所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
集成电路	231,697.56	138,759.59	40.11	-0.51	8.27	减少 4.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
知识产权授权使用费收入	63,285.92	6,509.56	89.71	-3.44	-21.02	增加 2.29 个百分点
特许权使用费收入	10,310.92	-	100.00	-6.00	-	增加 0.00 个百分点
芯片设计业务收入	72,479.40	63,149.64	12.87	47.18	49.73	减少 1.49 个百分点
量产业务收入	85,621.32	69,100.39	19.30	-20.09	-11.12	减少 8.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内销售收入	144,785.71	92,263.45	36.28	-19.46	-7.28	减少 8.37 个百分点
境外销售收入	86,911.85	46,496.14	46.50	63.59	62.26	增加 0.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司属于集成电路设计行业，面向社会经济中市场规模较大、使用场景较多、用户范围广泛

的主流行业及应用领域，包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等。报告期内，公司上述分行业、分产品、分地区等分析内容详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
芯片出货量	片	/	65,001	/	/	22.09	/

产销量情况说明

根据公司商业模式，公司根据客户需求按订单委托晶圆厂进行生产，自身不涉及晶圆生产及相关库存。为便于比较，芯片量产业务的出货量统一折算为 8 英寸晶圆口径。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集成电路	直接材料	107,660.75	77.59	97,477.10	76.06	10.45	
	直接人工	26,307.24	18.96	26,231.98	20.47	0.29	
	其他	4,791.60	3.45	4,455.51	3.48	7.54	
	合计	138,759.59	100.00	128,164.58	100.00	8.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
芯片设计业务	直接材料	35,363.36	25.49	13,046.18	10.18	171.06	
	直接人工	23,403.67	16.87	24,304.78	18.96	-3.71	
	其他	4,382.62	3.16	4,823.97	3.76	-9.15	
	合计	63,149.64	45.51	42,174.93	32.91	49.73	
量产业务	直接材料	67,231.49	48.45	76,874.80	59.98	-12.54	
	直接人工	1,583.66	1.14	1,347.50	1.05	17.53	
	其他	285.25	0.21	-474.47	-0.37	不适用	
	合计	69,100.39	49.80	77,747.83	60.66	-11.12	
知识产权	直接材料	5,065.91	3.65	7,556.12	5.90	-32.96	

授权使用费	直接人工	1,319.92	0.95	579.69	0.45	127.69	
	其他	123.73	0.09	106.01	0.08	16.72	
	合计	6,509.55	4.69	8,241.82	6.43	-21.02	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料和直接人工构成。其中，直接材料主要为采购晶圆、第三方 IP 等成本；直接人工主要为芯片设计项目人工成本。公司 2024 年主营业务成本较上年增加 8.27%，主要由于第三方 IP 成本及流片成本增加。芯片设计业务成本主要包括人工、晶圆及光罩、IP、封装测试服务等。2024 年芯片设计业务成本中直接材料及直接人工占比分别为 56.00%及 37.06%，构成比例较上年有所波动，主要由于报告期内第三方 IP 成本及流片成本增加。量产业务成本主要为直接材料，包括晶圆和封装测试成本。2024 年量产业务成本中直接材料占比 97.30%，较上年基本一致。知识产权授权使用费业务的成本主要为第三方 IP 成本和人工成本。报告期内知识产权授权使用费业务中直接材料及直接人工波动主要由于定制化知识产权需求增大，造成知识产权人工成本上升。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额103,300.40万元，占年度销售总额44.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

公司前五名客户

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	46,923.12	20.21	否
2	客户二	20,502.18	8.83	否
3	客户三	15,735.45	6.78	否
4	客户四	10,105.08	4.35	否
5	客户五	10,034.57	4.32	否
合计	/	103,300.40	44.49	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐适用 ☒不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额80,379.52万元，占年度采购总额67.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	21,377.67	17.87	否
2	供应商二	16,539.60	13.83	否
3	供应商三	14,929.33	12.48	否
4	供应商四	13,948.24	11.66	否
5	供应商五	13,584.69	11.36	否
合计	/	80,379.52	67.19	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、费用

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	11,998.35	11,485.34	4.47
管理费用	12,228.38	11,944.62	2.38
研发费用	124,730.23	94,722.31	31.68
财务费用	707.58	-488.82	不适用

具体变动原因分析详见本节“（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

4、现金流

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,599.02	-852.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	4,652.56	-42,619.60	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	24,813.19	35,658.12	-30.41

具体变动原因分析详见本节“（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”相关内容。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	11,227.57	2.43	40,013.04	9.08	-71.94	公司结构性存款和理财产品到期所致。
应收票据	2,026.27	0.44	6,261.80	1.42	-67.64	由于应收票据到期承兑所致。
预付款项	6,446.47	1.39	2,343.68	0.53	175.06	主要由于本期部分量产业务投产，公司预付了部分订单相关的光罩、晶圆、基板款项。
其他应收款	158.80	0.03	484.36	0.11	-67.21	由于本年末代垫款项下降所致。
存货	39,551.48	8.54	27,862.27	6.32	41.95	由于公司业务需求，年末在产品增加所致。
合同资产	24,516.09	5.30	9,597.91	2.18	155.43	主要由于部分芯片设计项目已确认收入未结算金额增加所致。
长期股权投资	100.04	0.02	505.67	0.11	-80.22	由于按权益法确认了联营企业亏损所致。
固定资产	72,082.60	15.57	50,511.16	11.46	42.71	由于本期临港研发中心部分房产交付计入固定资产所致。
在建工程	15.34	0.00	647.02	0.15	-97.63	主要由于本期部分软件开发项目及公司办公楼装修项目完工所致。
使用权资产	7,855.97	1.70	4,388.73	1.00	79.00	主要由于公司签订了部分办公楼租赁协议确认使用权资产所致。
无形资产	52,351.54	11.31	39,653.72	9.00	32.02	主要由于公司本年新增购置了软件使用权所致。
应付账款	16,316.59	3.52	9,606.84	2.18	69.84	主要由于本年项目需求，公司采购

						额在临近年末有所增加，由于年末部分款项尚未达到支付时点，因此应付账款余额增加。
合同负债	60,677.75	13.11	45,352.20	10.29	33.79	由于本年末已结算未实现收入及预收货款较上年末增加。
应交税费	3,741.81	0.81	2,677.75	0.61	39.74	本年末应交企业所得税及应交其他税金较上年增加。
其他应付款	8,133.52	1.76	2,771.16	0.63	193.51	由于本期无形资产采购增加，应付购置无形资产款增加。
一年内到期的非流动负债	43,449.31	9.38	16,721.11	3.79	159.85	主要由于一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	3,330.81	0.72	1,755.17	0.40	89.77	主要由于本年收到但尚未使用的研发项目相关政府补助增加所致。
租赁负债	4,452.80	0.96	2,226.61	0.51	99.98	主要由于公司签订了部分办公楼续租协议，相关租赁负债增加。
长期应付款	8,322.17	1.80	4,099.50	0.93	103.00	公司分期付款采购了无形资产，一年以上应付部分计入长期应付款。本年公司新增采购分期付款无形资产，长期应付款余额增加。
其他非流动负债	-	-	3,321.92	0.75	-100.00	主要为一年以上合同负债，本年末暂无一年以上合同负债。

其他说明

无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产12.93（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为27.92%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有人民币 7.39 亿元资产受限，主要系公司临港研发中心固定资产用以抵押本集团银行借款，以及被冻结的、待购买结构性存款的货币资金，海关进口关税及信用证保证金。

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司所处行业经营性信息分析具体内容详见本节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
300.00	1,300.00	-76.92%

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
理财产品	-	224,721.57	-	-	836,000,000.00	754,000,000.00	-	82,224,721.57

结构性存款	400,130,371.00	-79,371.00	-	-	830,000,000.00	1,200,000,000.00	-	30,051,000.00
合计	400,130,371.00	145,350.57	-	-	1,666,000,000.00	1,954,000,000.00	-	112,275,721.57

证券投资情况
☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

4、 私募股权投资基金投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

5、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司名称	主营业务	注册资本/已发行股本数	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	持股比例
芯原开曼	控股主体，无实质业务	5 万美元	73,395.38	28,636.15	-	2,270.85	100.00%
芯原美国	IP 授权业务、芯片定制业务、技术研发	2,215.8831 万美元	60,397.01	1,700.60	35,810.13	-1,299.92	100.00%
芯原香港	芯片定制业务	20 万港币	59,313.62	11,446.96	102,782.88	944.72	100.00%
图芯美国	IP 授权业务、技术研发	1,699.7356 万美元	31,460.46	30,361.10	7,352.03	-2,480.41	100.00%
芯原成都	技术研发	2,000 万元	20,877.05	12,616.35	49,614.29	3,289.11	100.00%
芯原科技	IP 授权业务、芯片定制业务、技术研发	50,000 万元	80,163.49	37,463.21	13,213.62	-5,237.89	100.00%
芯原南京	IP 授权业务、芯片定制业务、技术研发	10,000 万元	11,681.09	2,097.46	17,813.58	1, 181.79	100.00%
芯思原	技术研发及 IP 授权服务	10,666.67 万元	2,728.07	-3,200.78	1,976.51	-4,750.10	42.00%

（八）公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，公司所处的行业格局与趋势分析详见本节之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”相关内容。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

芯原坚持基础技术研发与应用技术升级同步进行，加强对具有复用性、关键性、先导性的新技术的预研，以夯实公司的核心技术基础。2025年，芯原将着力面向AIGC、智慧出行等领域推进Chiplet技术的迭代研发及产业化落地；针对AI、汽车、可穿戴等快速增长的关键应用领域需求持续研发、升级和优化半导体IP；升级基于先进工艺的系统级芯片定制平台（包括基础和应用软件平台）；推进基于FD-SOI工艺的低功耗物联网无线连接技术平台的研发与产业化；积极拓展市场的深度和广度；择机进行投资或并购；持续吸引和培养关键研发人才。

1、面向AIGC、智慧出行等领域推进Chiplet技术的迭代研发及产业化落地

作为全球领先的一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务供应商，Chiplet技术迭代研发及产业化落地是芯原发展的核心战略之一。芯原是中国首批加入UCIe产业联盟的企业之一，公司正在以“IP芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口IP、Chiplet芯片架构、先进封装技术等方面入手，面向AIGC和智慧出行等应用需求，持续推进公司Chiplet技术、项目的发展和产业化。上述举措将提高公司的IP复用性，增强业务间协同，增加设计服务的附加值，拓宽业务市场空间；进一步降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率，更深度绑定客户；并进一步提高公司盈利能力，实现竞争力升维。

具体来说，芯原根据AIGC、智慧出行等具体应用需求，正在持续推进关键功能模块Chiplet、Die-to-Die接口、Chiplet芯片架构、先进封装技术的研发工作。公司基于自有的GPGPU IP、NPU IP、UCIe物理层（PHY）等技术，所打造的AIGC和汽车智驾系统Chiplet芯片设计项目，目前已稳步取得阶段性进展，相关研发工作将持续推进。公司已在基于Chiplet的AIGC大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑。

为保障芯原Chiplet项目的顺利开展，公司还将持续与全球领先的晶圆厂、封装测试厂就Chiplet项目展开深入合作，尽早向市场推出Chiplet商用商品。例如，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将

与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

2、不断强化面向关键应用领域的核心半导体 IP 和一站式芯片定制技术

保持技术领先是芯原的立足之本，能吸引到顶尖人才和客户，塑造良好的品牌和声誉。芯原将持续对半导体 IP、系统级芯片定制平台和软件开发平台的高研发投入，形成一批具有自主知识产权的专利技术。

针对关键市场的技术发展趋势，芯原将不断丰富和优化自有的处理器 IP、射频 IP、IP 子系统和相关的 IP 平台解决方案等。例如，针对 AIGC 相关应用，公司在自有 NPU IP 全球市场占有率领先、GPU 技术储备深厚的基础上，进一步发展面向人工智能大算力应用，针对大语言模型、多模态模型进行优化的高性能 NPU、GPU、GPGPU，以及一系列创新的 AI 子系统；针对日益增长的高端汽车芯片需求，公司将按计划逐步推出满足汽车功能安全（FuSa）的 IP 产品组合；针对公司已深入布局的可穿戴市场，进一步优化低功耗 IP 性能，并推出与公司无线连接 IP 相结合的 MCU/MPU 整体解决方案，以及按应用场景驱动不同功耗和性能 IP 组合的高能效解决方案；针对视频转码服务器、AI 服务器、云桌面和云游戏等在内的下一代数据中心的先进需求，不断提升 VPU、GPU IP 的性能指标，进一步提升芯原在数据中心应用领域的市场地位等。此外，公司也将扩大与第三方 IP 的合作关系，为客户提供更加丰富和灵活的解决方案。

芯原将持续推进多款 5nm/4nm 芯片的设计研发，以及软硬件协同、芯片设计和封装设计协同的技术研发，并根据市场需求，持续研发和升级面向关键应用领域的芯片定制平台和系统级解决方案。例如，公司已推出并将持续优化功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程、基于该平台的 ADAS 功能安全方案，以及完整的自动驾驶软件平台框架等。通过不断迭代面向智慧可穿戴设备、智慧出行、数据中心、智慧物联网应用的系统级芯片定制平台，持续打造灵活且具有高复用性的平台化解决方案，进一步深度拓展垂直领域的行业客户，挖掘深度需求，不断精进和优化技术储备，从而进一步夯实市场地位。

此外，公司将择机在主要区域市场继续投资建立研发中心，充分考量并利用当地产业、人才政策优势和集成电路产业链的协同创新环境，吸引一批国内外一流的人才扎根，从而加快研发资金、技术、人才的整合及优化配置，实现研发能力的显著提升。

3、持续推进基于 FD-SOI 工艺的低功耗物联网无线连接技术平台的研发与产业化

芯原正在从扩展技术平台价值链和扩展专用垂直领域两个维度，持续在 FD-SOI 工艺上开发更多的面向物联网应用的平台化解决方案。

在扩展技术平台价值链方面，芯原将整合公司硬件和软件设计能力，提供完整的低功耗物联网无线连接技术平台解决方案和设计服务来扩大服务范围和市场空间；同时还将针对量产服务为客户进行相关 IP 技术的定制与适配，通过优化客户芯片的功耗和面积等，帮助客户实现产品差异

化发展，以保持芯原的市场竞争力，增加客户粘性，同时强化芯原与晶圆厂合作伙伴的合作深度；此外，芯原还将结合 FD-SOI 的先进工艺特性，持续开发新的无线连接技术，并加强与合作伙伴的战略合作关系，以保持市场领先性。

芯原将根据市场应用趋势，充分发挥 FD-SOI 技术在无线连接应用上的独特优势，持续开发针对如蜂窝物联网、Wi-Fi 6、卫星通信、毫米波雷达、助听器等应用的技术平台，拓展芯原在物联网、消费电子、工业应用、汽车、医疗健康等领域的战略布局。

4、持续推动产业生态发展，强化自身在产业链中的龙头地位

技术的产业化离不开生态的建设和发展。芯原一直秉持“水涨船高”的发展理念，持续推动产业生态的发展，通过加强业界交流、积极探索前沿技术创新和应用发展趋势、促进多方合作等方式，强化自身在产业链中的龙头地位。

芯原以 RISC-V International 金牌会员、OpenHW Group 理事会成员、Chips Alliance 理事会成员、中国 RISC-V 产业联盟理事长单位等身份，持续致力于推动中国集成电路产业生态发展，并定期举办松山湖中国 IC 创新高峰论坛、滴水湖中国 RISC-V 产业论坛、南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛、FD-SOI 产业论坛、芯原 CEO 论坛等行业高端论坛，促进芯片企业与应用厂商、投资机构的对接，推动芯片产业化落地和应用创新，并进一步发掘技术趋势与未来市场机遇。

5、择机投资、购买优秀的技术及团队，从而更好地进行资源互补

芯原在保持快速内生性发展的同时，考虑通过投资购买国内外先进技术、设计团队或拥有核心竞争力的半导体企业，从而更好地进行资源互补。芯原投资策略旨在加速收入增长、扩大技术组合，扩大目标市场并创造股东价值。公司过去在自动驾驶、FPGA、电视、RISC-V、AIoT、光纤通讯、5G 等领域有投资或购买布局，未来主要考虑投资购买前述领域、Chiplet 相关领域，以及拥有核心半导体 IP 的企业或该等 IP，来进一步扩充公司的技术资源库，提高公司的服务能力，扩大竞争优势。

6、积极开拓市场，与行业龙头企业建立良好合作关系，提升国内外品牌知名度及市场占有率

芯原将继续凭借先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件及系统解决方案的平台化服务能力，以及长期服务世界一流客户群体的经验基础和口碑，巩固其作为系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴的地位。对于现有重要行业头部客户，公司将通过持续的客户产品迭代升级、为同一客户的不同部门/产品线提供多样化的服务等方式，巩固和深化合作；同时，公司将积极开拓优质行业头部客户，通过双方的深度合作重点布局智慧可穿戴、AIGC、汽车、物联网无线通信、数据中心等行业应用领域，从而保持公司的市场敏锐度，以及业务与技术的领先性，成为头部客户重要的战略合作伙伴。

芯原将积极巩固并开拓全球市场，提升国内外品牌知名度及市场占有率。同时还将扩大销售

团队，提升服务质量，督促各区域销售团队和技术支持中心保持紧密沟通和协作，就近为客户提供相关销售及技术支持，以提高客户服务的响应速度和满意度。

7、持续吸引和培养关键研发人才

人才是芯片设计行业经营发展之根本。芯原将继续优化适应未来发展的组织，提升雇主品牌形象，加强人才引进、激励与发展的力度，并以优秀的企业文化留住人才。

芯原将通过吸引更多顶尖的芯片设计科学家和优秀的应届毕业生人才加入公司，来扩大其芯片设计人才库。公司在芯片设计方面广泛的技术专业知识、深刻的行业理解和丰富的应用场景也为培养和留下多技能的芯片设计人才创造了良好的环境。此外，公司将加强与顶尖大学和研发机构开展技术人才交流与研发合作，不断积聚全球化人才。

同时，公司将围绕员工需求，通过优化薪资结构、完善评估与考核体系，制定符合员工需求的股权激励计划等一系列措施，将公司利益与员工个人利益结合绑定，提高人均产出效率，控制关键人才流失。在人才培养上，公司还将进一步完善内部培训发展体系，通过多样化的线上线下技术和管理培训，着力发展关键岗位干部和核心技术人才，提高员工的综合能力。

（三）经营计划

☒适用 ☐不适用

为了保持公司半导体 IP 储备和一站式芯片定制业务的竞争优势，并根据发展战略进行研发布局以实现未来跨越式发展，使公司成为业界领先的芯片设计技术研发、授权和服务平台，公司将从技术研发、人才培养、资源整合这几个方面开展工作。具体的经营计划如下：

1、技术研发

在半导体 IP 业务方面，持续优化和丰富半导体 IP 产品系列，包括公司核心的图形处理器 IP、神经网络处理器 IP、视频处理器 IP、数字信号处理器 IP、图像信号处理器 IP 和显示处理器 IP 六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和物联网无线连接 IP（含射频）；基于自有的处理器 IP，推出创新的 AI-ISP、AI-Display、AI-VPU、AI-GPU、AI-DSP 等系列 AI 加速子系统解决方案，进一步扩大公司 IP 在 AI 应用领域的深度和广度；针对关键应用领域如 AIGC、数据中心、汽车、智慧可穿戴、物联网等的应用特点，进行技术优化和组合，以平台化的 IP 解决方案强化公司 IP 产品的竞争优势。

在一站式芯片定制业务方面，持续优化基于先进生产工艺的芯片设计与验证方法；继续推进 Chiplet 相关技术和项目的设计实现与产业化，包括关键功能模块 Chiplet、Die-to-Die 接口、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和汽车智驾系统的 Chiplet 芯片设计项目等；结合软件团队的优势，实现系统平台解决方案如数据中心视频转码、AI/AR 眼镜、自动驾驶/ADAS 等平台项目的产业化落地；加深与大型互联网企业、云服务提供商、车企等客户的合作，共同打造和完善按

应用领域划分的系统生态等。

2、人才培养

人才是公司发展的重要资源。随着公司临港研发中心的建成，公司上海研发布局已经由张江高科技园区单研发中心布局扩张至张江及临港双研发中心布局，有助于公司招募到更多优秀的人才以保持公司技术先进性，加快技术人才体系建设并完善公司战略布局。公司将根据未来发展战略目标，通过优质的校园招聘和社会招聘，引进相关的优秀人才。公司将通过进一步优化人力资源管理体系，如强化企业文化，制定科学高效的培训制度等，来提升员工的企业归属感和加强公司的人才梯度建设。公司还将不断优化绩效管理体系、依托资本市场制定长效的股权激励计划，充分调动员工的积极性，为公司创造更多价值。

3、资源整合

公司以芯片设计服务为主要业务，作为集成电路设计企业和制造企业之间的桥梁，在整个产业链中具有重要的沟通和衔接作用，因此对整个产业链的全局发展有着较为全面的认知。公司将充分利用这一优势，积极推进产业链上下游的合作，推动产业的生态建设，加强产业间的融合，提升公司的产业地位和整体竞争力。同时，公司还将继续依托自身平台化公司对行业发展趋势的全面理解，视业务需要择机进行与公司战略发展方向相一致的投资或并购。

（四）其他

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定制定了股东大会、董事会及监事会的议事规则等相关内部治理制度，确定了股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制并合法、有效运作。公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会就关联交易、业务发展等重大事项的决策提供咨询及建议，以保证董事会议事决策的专业化和高效化。

报告期内，公司持续完善公司治理结构及三会运作模式。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过议案 25 项；召开 7 次董事会，审议通过议案 54 项；召开 6 次监事会，审议通过议案 27 项。公司股东大会、董事会、监事会的通知、召集、召开、审议、表决程序及形成的决议均符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司进一步加强信息披露管理，加强与投资者的沟通。公司设置了专用电话和邮箱，与投资者建立了沟通的有效渠道，接受投资者的咨询和交流。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
☐适用 ☒不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况
☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2024 年 1 月 11 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2024 年 4 月 27 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2024 年 11 月 16 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 25 日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2024 年 12 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明
☐适用 ☒不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	董事长、总裁、核心技术人员	男	69	2019 年 3 月	2025 年 4 月	8,742,507	8,742,507	-	/	463.86	否
Wei-Jin Dai（戴伟进）	董事、首席战略官、副总裁、核心技术人员	男	66	董事、副总裁：2019 年 3 月；首席战略官：2024 年 12 月	2025 年 4 月	1,545,956	1,545,956	-	/	319.39	否
施文茜	董事、首席财务官、副总裁、董事会秘书	女	49	2019 年 3 月	2025 年 4 月	1,037,951	1,037,951	-	/	235.51	否
孙国栋	董事	男	48	2021 年 9 月	2025 年 4 月	-	-	-	/	-	否
陈晓飞	董事	男	49	2019 年 3 月	2025 年 4 月	-	-	-	/	-	是
陈洪	董事	女	56	2019 年 11 月	2025 年 4 月	-	-	-	/	-	是
陈武朝	独立董事	男	55	2019 年 3 月	2025 年 4 月	-	-	-	/	15.00	否

				月	月						
李辰	独立董事	男	49	2019年3月	2025年4月	-	-	-	/	15.00	否
王志华	独立董事	男	65	2019年3月	2025年4月	-	-	-	/	15.00	否
Zhiwei Wang (王志伟)	监事会主席	男	54	2019年3月	2025年4月	-	-	-	/	-	否
邹非	监事	女	40	2021年4月	2025年4月	-	-	-	/	-	否
石雯丽	人事行政 副总裁、职工代表监事	女	45	2019年3月	2025年4月	-	-	-	/	134.65	否
汪洋	首席运营官、副总裁	男	48	副总裁： 2019年3月；首席运营官：2024年12月	2025年4月	691,842	691,842	-	/	326.46	否
汪志伟	副总裁、核心技术人员	男	51	2020年10月	2025年4月	146,763	146,763	-	/	305.96	否
张慧明	核心技术人员	男	44	2022年9月	-	222,754	167,754	-55,000	二级市场卖出	249.15	否
杨海	核心技术人员	男	51	2022年9月	-	17,500	2,500	-15,000	二级市场卖出	151.89	否
David Jarmon (注1)	副总裁(离任)	男	66	2019年3月	2024年8月	-	-	-	/	83.70	否
Martyn Humphries	副总裁(离任)	男	66	2022年4月	2024年12月	15,000	15,000	-	/	258.04	否

(注1)											
合计	/	/	/	/	/	12,420,273	12,350,273	-70,000	/	2,573.62	/

注1: David Jarmon、Martyn Humphries 已分别于2024年8月、2024年12月离任公司高级管理人员。

姓名	主要工作经历
Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)	1956年出生, 美国国籍。美国加州大学伯克利分校电子计算工程学博士; 1988年至2005年, 历任美国加州大学圣克鲁兹分校计算机工程学助教、副教授、教授; 1995年至2000年, 任美国Ultima公司的创始人、董事长兼总裁; 2000年至2001年, 任美国思略共同董事长兼首席技术长; 2001年至2019年3月, 历任芯原有限执行董事、董事长; 2002年至今, 任芯原开曼董事; 2019年3月至今, 任公司董事长、总裁。
Wei-Jin Dai (戴伟进)	1959年出生, 美国国籍; 美国加州大学伯克利分校计算机科学学士、电子计算工程学硕士; 1985年至1991年, 任HewlettPackard工程经理; 1991年至1996年, 任Quickturn Design Systems工程总监; 1996年至2002年, 联合创办Silicon Perspective Corporation, 担任研发副总裁, 2002年Silicon Perspective Corporation被Cadence Design Systems收购; 2002年至2007年, 任Cadence Design Systems领先数字实现系统事业部Encounter产品线副总裁; 2007年至2016年, 任图芯美国总裁及首席执行官; 2016年加入公司, 现任董事、首席战略官、副总裁。
施文茜	1976年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 中国注册会计师, 英国特许公认会计师, 香港注册会计师, 美国注册会计师; 1998年至2001年, 任安永会计师事务所审计师; 2001年至2004年, 任华普信息技术有限公司财务分析经理; 2004年至2006年, 任菲尔创纳特种纤维产品有限公司财务总监; 2006年加入公司, 任芯原有限财务总监, 现任公司董事、首席财务官、副总裁、董事会秘书。
孙国栋	1977年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科毕业于北京理工大学计算机科学与工程系计算机应用专业, 研究生毕业于中央财经大学工商管理专业。2000年7月至2014年12月先后在国家开发银行营业部、人事局、湖北分行工作, 历任副处长、处长; 2014年12月参与筹建华芯投资管理有限责任公司, 任华芯投资管理有限责任公司人力资源部总经理; 2016年7月任华芯投资管理有限责任公司总监; 2021年1月兼任华芯投资上海分公司总经理。2021年8月至今, 任公司董事。
陈晓飞	1976年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士研究生学历, 中级经济师; 1998年至2002年, 任长江证券部门经理; 2002年至2008年, 任湘财证券部门总经理; 2008年至2009年, 任上海红林投资管理有限公司总经理; 2009年至2015年, 任齐鲁证券部门总经理; 2015年至今, 任兴橙投资执行董事; 现任公司董事。
陈洪	1969年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。硕士研究生学历; 1996年至2000年, 任武汉金丰大酒店有限公司人事行政经理; 2000年至2004年, 任武汉汉网高技术有限公司总经理助理; 2004年至2008年, 任上海富瀚微电子有限公司副总经理; 2008年至2012年, 任上海凡美服饰有限公司总经理; 2012年至2014年, 任上海才云贸易有限公司副总经理; 2014年至2017年, 任玖捌壹健康科技集团有限公司副总经理; 2017年至今, 任深圳嘉道谷投资管理有限公司董事长助理; 现任公司董事。
陈武朝	1970年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。博士研究生学历, 副教授, 中国注册会计师(非执业会员); 1995年至1998年, 任中华会计师事务所注册会计师; 1998年至今, 任清华大学副教授; 现任公司独立董事。

李辰	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师；2002年至今，任国浩律师（上海）事务所律师；现任公司独立董事。
王志华	1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授；1983年至今，历任清华大学助教、讲师、副教授、教授；1992年至1993年，任美国卡内基梅隆大学访问学者；1993年至1994年，任比利时鲁汶天主大学访问研究员；2014年至2015年，任香港科技大学访问教授；现任公司独立董事。
Zhiwei Wang(王志伟)	1971年出生，加拿大国籍。加拿大西安大略大学工商管理硕士；2005年至2006年，任 Intrawest Corporation 投资经理；2007年至2008年，任高盛高华证券有限责任公司经理；2009年至2017年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监、合伙人；2017年至今，任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；现任公司监事会主席。
邹非	1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于北京大学经济学院金融系。2008年至2013年，任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理；2013年至2015年，任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理；2015年至2021年，历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、风险与法律合规部副总经理、投资管理部副总经理；2021年至今，任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。
石雯丽	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历；2003年加入公司，历任行政助理、人事助理、人事主管、人事经理、人事高级经理、人事行政总监、人事行政高级总监、人事行政副总裁；现任公司职工代表监事。
汪洋	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权；天津大学电子工程学士，北京邮电大学工商管理硕士，天津大学工程博士在读；1998年至2000年，任北广电子集团有限责任公司工程师；2000年至2003年，任北京方正连宇通信技术有限公司部门经理；2003年至2006年，任 LSI Logic 北京办事处经理；2006年加入公司，历任总监、高级总监，现任首席运营官、副总裁。
汪志伟	1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年，任上海博达数据通信有限公司软件工程师；2002年至2003年，任智邦大陆科技有限公司软件开发课长；2003年至2006年，任微开半导体研发(上海)有限公司软件开发经理；2006年至2011年，任美博通通信技术(上海)有限公司软件开发高级经理；2011年至2017年，任美满电子科技(上海)有限公司多媒体部资深总监；2017年至2019年，任 Yuneec International Co.Ltd.研发副总裁；2019年加入公司，任副总裁、系统平台解决方案事业部总经理。
张慧明	1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年，任华为技术有限公司 ASIC 设计工程师；2007-2016年，任图芯芯片技术有限公司 IP 设计项目经理；2016年至今，任公司图形处理器产品副总裁。
杨海	1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年至2001年，任上海泰信科技有限公司软件工程师；2001年，任上海博达数据通信有限公司软件工程师；2001年至2005年，任上海海高通信发展有限公司软件经理；2005年至2007年，任微开半导体（上海）有限公司高级软件工程师；2007年至2008年，任超微半导体（上海）有限公司高级软件工程师；2008年至2011年，任美博通通信技术(上海)有限公司软件主管；2011至2017年，任美满电子科技（上海）有限公司高级软件经理；2017年至2019年，任翔升（上海）电子技术有限公司软件总监；2019年加入公司，任软件高级总监。
David Jarmon（离任）	1959年出生，美国国籍。夏威夷大学马诺阿分校工商管理硕士；1983年至1988年，任 Tektronix, Inc 技术员；1988年至1989年，任 Tangent Systems, Inc 高级应用工程师；1989年至1992年，任 Cadence Design Systems, KK 线路设计总监；1992年至1995年，任铿

	腾电子市场营销总监；1996 年至 1997 年，任 CooperandChyanTechnology 日本运营董事总经理；1997 年至 2000 年，任铿腾电子咨询专员；2000 年至 2002 年，任 SiliconPerspectiveCorporation 国际销售副总裁；2002 年至 2006 年，任铿腾电子客户向研发副总裁；2006 年至 2007 年，任 Certess 销售咨询顾问；2007 年至 2015 年，任图芯美国国际销售与发展资深副总裁；2016 年至 2024 年，任公司副总裁。
Martyn Humphries（离 任）	1959 年出生，美国国籍，曼彻斯特大学电气工程学士。1976 年至 1984 年，任 BritishAerospace 设计工程师；1984 年至 1990 年，任 AnalogDevices 应用工程师；1990 年至 1999 年，任 MemecOrganization 通信解决方案经理；1999 年至 2003 年，任 BroadcomCorporation 网络交换及安全业务高级总监；2003 年至 2005 年，在 NetlogicMicrosystems 负责网络交换解决方案工作；2005 年至 2006 年，任 VitesseSemiconductor 以太网产品部总经理；2006 至 2007 年，任 StaccatoCommunications 销售副总裁；2007 年至 2014 年，任 BroadcomCorporation 知识产权业务总经理、移动和嵌入式处理器业务总经理；2014 年至 2020 年，任 NXPi.MX 应用处理器业务总经理；2020 年至 2024 年，任公司副总裁。

其它情况说明
☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	VeriSilicon Limited	董事	2016 年	至今
Wei-Jin Dai（戴伟进）	VeriSilicon Limited	董事	2016 年	至今
施文茜	VeriSilicon Limited	董事	2018 年	至今
Zhiwei Wang（王志伟）	Jovial Victory Limited	董事	2014 年	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	生纳科技（上海）有限公司	董事长	2015 年	至今
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	芯思原	董事长	2018 年	至今
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	上海空绮贸易有限公司	执行董事	2022 年	至今
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	上海开放处理器产业创新中心	理事长	2024 年	至今
Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	杭州生纳健康科技有限公司	董事、经理	2024 年	至今
Wei-Jin Dai（戴伟进）	Zerro Power Systems	董事	2025 年	至今
汪志伟	深圳一清创新科技有限公司	董事	2021 年	至今
汪志伟	威视芯半导体（合肥）有限公司	董事	2021 年	至今
汪志伟	鹏瞰科技（上海）有限公司	董事	2021 年	至今
汪志伟	南京迈矽科微电子科技有限公司	董事	2022 年	至今
汪志伟	上海开放处理器产业创新中心	理事	2024 年	至今
汪洋	至成微科技（浙江）有限公司	董事	2022 年	至今
施文茜	芯思原	董事	2018 年	至今
石雯丽	共青城原和投资有限公司	执行董事，总经理	2019 年	至今
陈洪	上海嘉沙管理咨询有限责任公司	执行董事	2019 年	至今
陈洪	北京阿尤卡健康科技有限公司	董事	2019 年	至今
陈洪	思欣跃教育科技（上海）有限公司	董事、经理	董事：2018 年；经理：	至今

			2024 年	
陈洪	深圳嘉道谷投资管理有限公司	董事长助理	2017 年	至今
陈洪	嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021 年	至今
陈洪	上海良枢之志网络科技有限公司	董事	2020 年	至今
陈洪	生纳科技（上海）有限公司	董事	2021 年	至今
陈洪	上海鸿泰护理院有限公司	监事	2020 年	至今
陈洪	上海红峪投资有限公司	监事	2020 年	至今
陈洪	嘉道医养健康管理（上海）有限公司（曾用名：永泰红礪企业管理（上海）有限公司）	监事	2020 年	至今
陈洪	上海朗目企业管理有限公司	监事	2020 年	2024 年
陈洪	天津津南红礪领世郡医院有限公司	监事	2020 年	至今
陈洪	宁波市易镀商务咨询合伙企业（有限合伙）	法人代表	2022 年	至今
陈洪	上海源申金迈康复医院有限公司	董事	2023 年	至今
陈洪	上海联祥生物科技有限公司	执行董事	2023 年	至今
陈晓飞	上海兴橙投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年	至今
陈晓飞	上海概伦电子股份有限公司	董事	2020 年	至今
陈晓飞	共青城兴橙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年	至今
陈晓飞	共青城心成投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	共青城芯动力投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2024 年	至今
陈晓飞	共青城志同道合股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2023 年	至今
陈晓飞	广州兴橙私募证券投资管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2020 年	至今
陈晓飞	广州湾区智能传感器产业集团有限公司	法定代表人、董事长、经理	2021 年	至今
陈晓飞	常青半导体（湖北）有限公司	法定代表人、执行董事、经理、财务负责人	2021 年	至今
陈晓飞	上海兴橙科技有限公司	法定代表人、执行董事	2020 年	至今
陈晓飞	井冈山前橙似锦投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	广东国开兴橙股权投资基金管理有限公司	法定代表人、董事、	2020 年	至今

		经理		
陈晓飞	井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	井冈山橙心投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	井冈山泉城投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	井冈山橙意投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	共青城心悦投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020 年	至今
陈晓飞	安徽微芯长江半导体材料有限公司	董事	2020 年	至今
陈晓飞	广州增芯科技有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2021 年	至今
陈晓飞	广州广钢气体能源股份有限公司	董事	2021 年	至今
陈晓飞	国开集成电路（南京）有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2021 年	至今
陈晓飞	湖北省半导体产业投资基金管理有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2022 年	至今
陈晓飞	广东越海集成技术有限公司	法定代表人、董事长	2022 年	至今
陈晓飞	共青城海桐股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022 年	2024 年
陈晓飞	上海橙临芯伦科技发展有限公司	法定代表人、董事长	2023 年	至今
陈晓飞	广东越海三维集成技术有限公司	法定代表人、经理	2023 年	至今
陈晓飞	广东微技术研发中心有限公司	董事	2023 年	至今
陈晓飞	广东微技术制造有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2023 年	至今
陈晓飞	共青城矽平方投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2024 年	至今
陈晓飞	广州增翼集成电路制造有限公司	董事	2024 年	至今
陈晓飞	共青城矽立方投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2024 年	至今
孙国栋	华芯投资管理有限责任公司	总监	2016 年	2024 年
孙国栋	华虹半导体有限公司	董事	2020 年	至今
孙国栋	华虹半导体（无锡）有限公司	董事	2021 年	至今
孙国栋	上海华力集成电路制造有限公司	董事	2020 年	至今
孙国栋	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	董事	2021 年	至今
孙国栋	上海超越摩尔私募基金管理有限公司（原名：上海超越摩尔投资管理有限公司）	董事	2021 年	至今

孙国栋	至微半导体（上海）有限公司	董事	2021 年	至今
孙国栋	华虹半导体制造（无锡）有限公司	董事	2023 年	至今
陈武朝	清华大学	副教授	1998 年	至今
陈武朝	长鑫科技集团股份有限公司(曾用名：睿力集成电路有限公司)	独立董事	2021 年	至今
陈武朝	中国石油集团资本股份有限公司	独立董事	2023 年	至今
陈武朝	中信信托有限责任公司	独立董事	2023 年	至今
李辰	国浩律师（上海）事务所	律师	2002 年	至今
王志华	清华大学	教授	1997 年	至今
王志华	恒玄科技(上海)股份有限公司	独立董事	2019 年	至今
王志华	北京易迈医疗科技有限公司	董事	2017 年	至今
王志华	深圳市智听科技有限公司	董事	2018 年	至今
王志华	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	独立董事	2019 年	2024 年
王志华	灿芯半导体（上海）股份有限公司	独立董事	2021 年	至今
王志华	上海登临科技有限公司	董事	2021 年	至今
王志华	南宁亿康科技有限责任公司	其他人员	2001 年	至今
王志华	宸芯科技股份有限公司	独立董事	2022 年	至今
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014 年	至今
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011 年	至今
王志伟	Lnsght Power investments Limited（讯安投资有限公司）	董事	2011 年	至今
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事	2011 年	至今
王志伟	Happy Mountain Limited	董事	2014 年	至今
王志伟	Jovial Victory Limited	董事	2014 年	至今
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017 年	至今
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	Innovation Smart Limited	董事	2019 年	至今
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人	2017 年	至今
王志伟	深迪半导体(绍兴)有限公司(曾用名：深迪半导体（上海）有限公司)	董事	2019 年	至今
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014 年	至今
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016 年	至今
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP, LLC	董事	2016 年	至今
王志伟	WestSummit Capital Holdings, LLC	董事	2017 年	至今

王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018 年	至今
王志伟	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited	董事	2018 年	至今
王志伟	Anji Microelectronics Co., Ltd	董事	2013 年	至今
王志伟	中山联合光电科技股份有限公司（上市公司）	董事	2014 年	至今
王志伟	兆易创新科技集团股份有限公司（上市公司）	董事	2015 年	至今
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	董事	2017 年	至今
王志伟	前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司	总经理、执行董事	2017 年	至今
王志伟	苏州汉天下电子有限公司	董事	2021 年	至今
王志伟	Panorama Investment Limited	董事	2020 年	至今
王志伟	Innovation Pine Investment Limited	董事	2021 年	至今
王志伟	WestSummit Global Technology Fund IV GP, LLC	经理	2021 年	至今
王志伟	WestCreation Investment Limited	董事	2021 年	至今
王志伟	Burwood Investment Limited	董事	2022 年	至今
王志伟	Blanc Investment Limited	董事	2022 年	至今
王志伟	Enlighten Investment Limited	董事	2022 年	至今
王志伟	Innovation Glory Limited	董事	2022 年	至今
王志伟	Natlas Investment Limited	董事	2023 年	至今
王志伟	AltoBeam	董事	2015 年	至今
王志伟	Marmo Investment Limited	董事	2024 年	至今
王志伟	Phronesis Investment Limited	董事	2024 年	至今
王志伟	Abies Investment Limited	董事	2024 年	至今
王志伟	Inno Stellar Limited	董事	2024 年	至今
王志伟	Ample Harvest Investment Limited	董事	2024 年	至今
邹非	华芯投资管理有限责任公司	风险管理部 副总经理	2021 年	至今
邹非	苏州盛科通信股份有限公司	监事	2021 年	至今
邹非	上海硅产业集团股份有限公司	监事	2021 年	至今
邹非	中微半导体设备（上海）股份有限公司	监事	2021 年	至今
邹非	北京世纪金光半导体有限公司	监事	2021 年	至今
邹非	巽鑫（上海）投资有限公司	监事	2021 年	至今
邹非	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	监事	2022 年	至今
邹非	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	监事	2022 年	至今
邹非	紫光展锐（上海）科技有限公司	监事	2022 年	至今
邹非	无锡达益凯电子科技有限公司	执行董事	2021 年	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由公司股东大会批准后实施，公司高级管理人员薪酬由公司董事会批准后实施
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2022 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》；2024 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议，审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。董事、监事在公司任职的，按现有任职职务的薪酬待遇领取薪酬；公司每年为独立董事发放津贴，独立董事行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,172.57
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,490.25

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Wei-Jin Dai（戴伟进）	董事、首席战略官、副总裁	聘任	职务调整
汪洋	首席运营官、副总裁	聘任	职务调整
David Jarmon	副总裁	离任	到达退休年龄
Martyn Humphries	副总裁	离任	个人原因

注：公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 25 日分别召开第二届董事会第十八次会议、2024 年第三次临时股东大会，同意增设首席战略官、首席运营官作为公司高级管理人员，并聘任董事、副总裁 Wei-Jin Dai（戴伟进）为首席战略官，聘任副总裁汪洋为首席运营官。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第	2024 年 3 月	审议通过了：1、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司总

十三次会议暨 2023 年年度董事 会会议	29 日	裁 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划>的议案》；2、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；3、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；4、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；5、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；7、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年社会责任报告>的议案》；8、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；9、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；10、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》；11、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；12、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议案》；13、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》；14、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》；15、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；16、《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》；17、《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》；18、《关于公司对外担保额度的议案》；19、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；20、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；21、《关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》；22、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；23、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；24、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；25、《关于向上海银行股份有限公司浦东分行申请综合授信额度的议案》；26、《关于向国家开发银行股份有限公司上海分行申请研发项目贷款的议案》；27、《关于向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》；28、《关于向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》；29、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第 十四次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过了：1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
第二届董事会第 十五次会议	2024 年 5 月 28 日	审议通过了：1、《关于向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请综合授信额度的议案》
第二届董事会第 十六次会议	2024 年 8 月 8 日	审议通过了：1、《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案》；4、《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；5、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》；6、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案》；

第二届董事会第十七次会议	2024年10月30日	审议通过了：1、《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》；2、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》；3、《关于向中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请综合授信额度的议案》；4、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2024年12月6日	审议通过了：1、《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》；2、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；3、《关于增设首席战略官、首席运营官并修订公司章程的议案》；4、《关于聘任公司首席战略官、首席运营官的议案》；5、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议	2024年12月16日	审议通过了：1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；2、《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限、募集资金总额暨调整方案的议案》；3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》；4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》；7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；8、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

八、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)	否	7	7	2	0	0	否	4
Wei-Jin Dai (戴伟进)	否	7	7	1	0	0	否	4
施文茜	否	7	7	1	0	0	否	4
孙国栋	否	7	7	7	0	0	否	4
陈晓飞	否	7	7	7	0	0	否	4
陈洪	否	7	7	6	0	0	否	4
陈武朝	是	7	7	4	0	0	否	4
李辰	是	7	7	4	0	0	否	4
王志华	是	7	7	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	-
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

九、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：陈武朝，委员：陈晓飞、李辰
提名委员会	主任委员：王志华，委员：李辰、陈洪
薪酬与考核委员会	主任委员：李辰，委员：陈洪、陈武朝
战略与 ESG 委员会	主任委员：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民），委员：王志华、孙国栋

(二) 报告期内审计委员会召开8次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 29 日	第二届董事会审计委员会第四次临时会议	讨论关于 2023 年度初步审计结果及 2023 年度业绩预告事项	无
2024 年 2 月 22 日	第二届董事会审计委员会第五次临时会议	讨论关于 2023 年业绩快报及资产减值公告事项	无
2024 年 3 月 18 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	审议通过了：1、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；2、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；3、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；4、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；5、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》的议案；6、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》的议案；7、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案；8、关于公司对外担保额度的议案；9、	无

		关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案。同意将上述议案提交第二届董事会第十三次会议暨 2023 年年度董事会会议审议。	
2024 年 4 月 17 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	审议通过了：1、关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案，同意将上述议案提交第二届董事会第十四次会议审议	无
2024 年 7 月 1 日	第二届董事会审计委员会第六次临时会议	讨论关于 2024 年第二季度营业收入情况的自愿性披露公告事项	无
2024 年 7 月 26 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	审议通过了：1、关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案，同意将上述议案提交第二届董事会第十六次会议审议	无
2024 年 10 月 22 日	第二届董事会审计委员会第十四次会议	审议通过了：1、关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案，同意将上述议案提交第二届董事会第十七次会议审议	无
2024 年 12 月 25 日	第二届董事会审计委员会第七次临时会议	讨论关于 2024 年年度审计安排事项	无

(三) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 3 月 14 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	审议通过了：1、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案，同意将上述议案提交第二届董事会第十三次会议暨 2023 年年度董事会会议审议。	无
2024 年 7 月 29 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	审议通过了：1、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次第二个归属期归属条件成就的议案；2、关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，同意将上述议案提交第二届董事会第十六次会议审议。	无

(四) 报告期内战略与 ESG委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 3 月 19 日	第二届董事会战略委员会第七次会议（注）	审议通过了：1、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；2、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案；3、关于《芯原微电子（上海）股份有限	无

		公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案; 5、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案, 同意将上述议案提交第二届董事会第十三次会议暨 2023 年年度董事会会议审议。	
2024 年 7 月 29 日	第二届董事会战略与 ESG 委员会第八次会议	审议通过了: 1、关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》, 同意将上述议案提交第二届董事会第十六次会议审议。	无
2024 年 12 月 6 日	第二届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议	审议通过了: 1、关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案, 同意将上述议案提交第二届董事会第十八次会议审议。	无
2024 年 12 月 16 日	第二届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议	审议通过了: 1、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限、募集资金总额暨调整方案的议案; 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案; 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案; 4、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案。同意将上述议案提交第二届董事会第十九次会议审议。	无

注: 2024 年 3 月 29 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议暨 2023 年年度董事会, 审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》, 故此召开的相关会议即修改命名。

(五) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 12 月 5 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	审议通过了: 1、关于聘任公司首席战略官、首席运营官的议案, 同意将上述议案提交第二届董事会第十八次会议审议。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	506
主要子公司在职员工的数量	1,508
在职员工的数量合计	2,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研发人员	1,800
管理与行政人员	149
销售人员	37
运营人员	28
合计	2,014
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	26
硕士研究生	1,661
本科	305
专科	22
高中及以下	0
合计	2,014

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家的相关法律法规，基于保障员工合法权益并激励员工工作积极性的考虑，制定并落实了《员工手册》和《员工绩效考评制度》，通过规定薪酬政策、激励调整措施、工作时间、加班薪酬等，为员工建立了科学完整的薪酬管理和晋升体系。公司高级管理人员的薪酬由公司董事会讨论决定。

公司员工的薪酬采取月薪制，员工年终奖按照员工职级、个人绩效和公司绩效进行发放。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重企业文化的建设，用人文精神和人文关怀引导公司发展，关注员工的职业发展需求，针对不同岗位的专业技术需要，定期组织新员工培训、领导力培训和丰富的在线培训课程，不断提升员工的综合能力，关注员工的精神文化建设，将企业发展和员工个人发展相结合，让员工和公司共同成长。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司已在《公司章程》第一百八十一、第一百八十二、第一百八十三、第一百八十四、第一百八十五条中，对利润分配的基本原则、利润分配的具体政策（包括分配形式、期间间隔、发放现金及股票股利的具体条件等）、利润分配方案的审议程序、实施程序及变更等内容进行了明确。

公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内未对《公司章程》中现金分红政策内容进行修改。

报告期内，因公司合并报表累计未分配利润为-24.16 亿元，母公司财务报表累计未分配利润为-6.33 亿元，且经营性现金流量净额为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会审议通过，尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(二) 现金分红政策的专项说明

☒适用 ☐不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	☒ 是 ☐ 否
分红标准和比例是否明确和清晰	☒ 是 ☐ 否
相关的决策程序和机制是否完备	☒ 是 ☐ 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	☒ 是 ☐ 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	☒ 是 ☐ 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量（股）	标的股票数量占比（%）	激励对象人数	激励对象人数占比（%）	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,850,000	0.79	522	25.92	38.53
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,012,500	0.81	1,101	54.67	39.00

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：万股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格（元）	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划	385.0000	0	80.1250	44.3850	38.53	385.0000	166.7850

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划	公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面归属比例为 100%	7,290,202.90
2022 年限制性股票激励计划	公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为 0	-
合计	/	7,290,202.90

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024- 033、2024-034）

票激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等相关议案，同意：（1）公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一批次的 53 名激励对象获授的 7.4750 万股限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就；（2）由于部分 2020 年限制性股票激励计划激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 12.4500 万股；（3）由于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合归属条件后未能在 12 个月归属有效期内完成归属，因此对应批次未归属的 7.0000 万股限制性股票自动作废失效；（4）由于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期未能满足对应业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效，公司需要作废 2022 年限制性股票激励计划激励对象第二个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票 108.5000 万股；（5）由于部分 2022 年限制性股票激励计划激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 9.0450 万股；（6）由于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合归属条件后未能在 12 个月归属有效期内完成归属，因此对应批次未归属的 9.0200 万股限制性股票自动作废失效。	
2024 年 11 月 20 日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属完成登记手续，归属股票数量 44.3850 万股，上市流通时间 2024 年 11 月 27 日。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)（公告编号：2024-045）

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☒适用 ☐不适用

公司上市前制定、上市后实施了 2019 年股票期权激励计划，该计划已实施完毕。2024 年 1 月 16 日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 652,057 股上市流通，详情请查阅公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-001）；2024 年 3 月 4 日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 2,217,852 股上市流通，详情请查阅公司于 2024 年 2 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-009）；2024 年 7 月 1 日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 1,807,893 股上市流通，详情请查阅公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-025）；2024 年 9 月 23 日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 588,568 股上市流通，详情请查阅公司于 2024 年 9 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-036）；2024 年 11 月 6 日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 4,383,772 股上市流通，详情请查阅公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定及落实高级管理人员的业绩考核体系及考核指标。公司拥有完善的高级管理人员考评机制，根据其业绩指标进行综合考评，确定高级管理人员薪酬。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第二届董事会第二十一次会议暨 2024 年年度董事会审议通过了《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

十五、报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司共有 6 家境内控股子公司，8 家境外控股子公司。公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

十六、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、其他

☐适用 ☒不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司致力于建立健全 ESG 工作机制，努力与社会和环境和谐相融，创造长期稳定的社会、环境以及企业价值。公司董事会是 ESG 事宜的最高负责及决策机构，负责审议董事会各项 ESG 决议及审视 ESG 风险。董事会将原战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，并在管理层中设立跨部门协作的 ESG 工作组。战略与 ESG 委员会全权负责监管 ESG 事宜。ESG 工作组负责开展 ESG 的日常管理工作。公司重视 ESG 信息披露相关工作，由董事会监管社会责任暨 ESG 报告准备过程，战略与 ESG 委员会审阅年度社会责任暨 ESG 报告，确保信息披露的真实性与有效性。

报告期内，公司秉持可持续发展理念，多维度践行企业社会责任：在经营层面，持续优化绿色办公机制，强化研发创新体系，全面推进低碳低功耗设计；在社会参与方面，深化产教融合战略合作，积极参与公益慈善事业。通过系统性履行社会责任，公司不仅有效维护了股东、员工、客户等利益相关方的权益，更为推动行业绿色转型、促进资本市场健康发展以及社会可持续发展

作出了积极贡献。

二、ESG 整体工作成果

√适用 □不适用

(一)本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

√适用 □不适用

公司持续深化绿色运营理念，通过系统性举措降低资源能耗。例如：优先选用技术先进的节能型电气和电子设备，从源头减少电能损耗；根据业务需求动态调配服务器等相对耗能集中的设备提高设备复用率，实现高效利用；在客户解决方案中嵌入节能设计，优化产品全生命周期能耗表现；专注于低功耗的核心技术攻关，通过科技创新降低用户端能源消耗和材料浪费。

(二)本年度 ESG 评级表现

√适用 □不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
Wind ESG 评级	万得信息技术股份有限公司	A
中证 ESG 评级	中证指数有限公司	AA

(三)本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

√适用 □不适用

报告期内，公司凭借在环境、社会及公司治理（ESG）领域的卓越实践，持续获得资本市场认可，被纳入以下权威 ESG 主题指数成分股：中证 500ESG 领先指数、中证 800ESG 领先指数、中证浦东新区绿色 50ESG 指数等诸多指数。上述指数由中证指数有限公司编制或联合编制，聚焦成分股在 ESG 方面的综合表现，反映公司在节能减排、社会责任、治理效能等方面的行业领先地位。纳入 ESG 主题指数，体现了机构投资者对公司可持续发展能力的长期看好，并有助于吸引更多注重责任投资的资金关注。

三、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	/

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 √否

公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业，并不直接从事具体生产制造业务，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

公司不属于高耗能、高排放企业，经营过程中消耗的资源能源主要是水资源、电能和天然气，有少量的生活废水排放和因用电、用天然气产生的温室气体排放。

1、温室气体排放情况

√适用 □不适用

公司主要经营模式为芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）的轻资产模式，不涉及生产制造环节。公司主要的碳排放来源于因外购电力和天然气的使用。为践行绿色低碳发展理念，公司系统性推进节能减排措施，例如提高服务器的使用效率，减少单位算力的能耗；在办公等区域的设备开关处增加节能节电相关的提示标志，强化用电规范，避免待机能耗浪费；定期通过邮件、企业微信、微信等多渠道，向员工普及温室气体影响及节能知识提高员工环保意识，督促员工于日常工作中节能减排，并鼓励绿色设计理念的应用。

2、能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司的能源资源消耗主要包括电能、水资源、天然气等。公司积极推行绿色办公行动，在企业内部制定了绿色办公相关的管理制度，以及采用电子流程化审批，双面打印，使用节水型洁具与自动出水器，优化实验设计和测试流程，优先选择环保供应商等一系列绿色办公措施，将能耗指标纳入日常采购衡量标准中，不断提升环境资源使用率，最大限度地减少企业在运营过程中对环境带来的不利影响。

3、废弃物与污染物排放情况

□适用 √不适用

4、公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

报告期内，公司深入贯彻落实绿色发展战略，通过制度建设和文化培育双管齐下推动低碳运营。我们严格执行《安保管理制度》《办公室环境巡检管理制度》等规范制度，确保绿色办公要求落地见效。为响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，公司开展了一系列富有成效的实践活动：组织绿色办公宣导、举办环保月主题活动、开展公益跳蚤市场和闲置物品拍卖活动，同时加强技术培训提高研发效率，推进内部降本增效工作。在日常管理中，公司坚持开展环保知识的宣传，培育员工的绿色意识，通过制度约束与文化引导相结合的方式，推动企业与环境和谐发展，为实现可持续发展目标而不懈努力。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	绿色办公节能措施

具体说明

√适用 □不适用

公司主要经营模式为芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）模式，不涉及生产制造。在日常经营中，主要资源能源的消耗集中于水资源、电能和天然气，环境排放包括有少量的生活废水以及因使用电和天然气产生的温室气体。

为践行绿色低碳发展理念，报告期内公司重点推进以下节能减排措施：

第一，在设备采购环节优先选择技术先进的节能型设备，从源头降低电能消耗；

第二，根据业务部门实际需求，按需配置服务器等相对耗能集中的设备，并适当循环使用，有效提升高能耗设备的利用率；

第三，通过实行内部降本增效工作，系统性提升资源利用效率。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司持续深化绿色技术创新战略，重点推进基于 FD-SOI 工艺的低功耗物联网无线连接技术平台的研发与产业化。

公司通过低能耗的绿色技术的研发，帮助用户实现能源节约和材料减耗。2024 年芯原低功耗技术研发投入约 5,758 万元，低功耗技术收入约 58,226 万元，占主营业务收入约 25%。

芯原的低功耗芯片设计方法贯穿芯片的定义、软硬件设计，到最终实现的全流程。在智慧可穿戴领域，基于先进的 FD-SOI 工艺技术的物联网连接 IP 凭借超低功耗的特性，有力推动了可穿戴设备实现节能和小型化趋势。在数据中心/服务器领域，芯原研发的高效能、低功耗视频转码加速解决方案可最大限度减小芯片面积，大幅降低用户服务器的用电量和占地空间，有效实现节能减排，促进高性能芯片能效比提升。在智能家居领域，通过低功耗技术实现民用视频监控摄像头超低功耗运作，打造更为环保低碳的智能家居设备。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司关注环境与生态，重视当前全球气候变化对生态环境与物种生存的影响。报告期内，公司认养 38 亩梨树园、200 平公益桃林，持续开展“芯原林”项目，助力减少碳排放、建设绿色城

市。

(七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司意识到气候变化对日常经营可能带来的潜在风险，将气候变化相关议题纳入管理层的监督范畴，定期监测气候变化相关风险，确保充分了解相关议题的最新趋势，并计划开展提升应对气候变化能力的相关培训，增强在气候变化下抗风险的能力。

风险	应对措施	机遇
- 部分经营地夏季用电高峰期可能出现用电短缺问题； - 部分经营地季节性暴雨影响员工出行问题； - 部分经营地所处地震活跃带，可能出现人身伤害的风险。	- 公司储备应急电扇，有条件地组织员工居家办公，开放VPN，提供充足的后勤支持； - 每日监控天气预报、政策变动，如有异常，直接向管理层反馈并缩短决策时间，在暴雨发生前提前预防员工通勤困难情况； - 针对突发事件成立跨部门专案小组，第一时间制定应急预案，进行人员调配。	- 公司提高极端天气或自然灾害的抗风险能力可预防气候带来的人员及财产损失； - 公司通过建立应急响应机制、备份供应链和远程工作能力，提高公司在面对突发事件时的适应性和恢复力，建立气候韧性。 - 积极应对气候变化，践行可持续发展理念，将提升我们的企业形象和品牌价值，吸引更多注重可持续发展的消费者和投资者。

四、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，秉持着绿色发展、低碳发展的理念，公司尽量降低业务发展对环境带来的负面影响，亦积极创新开发低功耗技术，与客户和终端用户共同致力于节能减排和绿色发展。

公司拥有持续研发的能力，报告期内获评“中国芯”优秀支撑服务产品奖、中国集成电路创新联盟第七届“IC 创新奖”技术创新奖、中国 IC 设计成就奖“年度杰出 IC 设计服务公司”与“年度杰出产业影响力 IP 公司”，入选 2024 上海硬核科技企业 TOP100 榜单，积极培育和输出高价值专利成果，IP 产品（IP Portfolio 1.0）成为国家首批认定的专利密集型产品，用技术带动成果转化。此外，公司为推动集成电路行业整体发展，发挥行业先进团队的带头作用，持续积极主办或协办产业联盟、论坛、会议，牵头成立上海开放处理器产业创新中心，促进行业先进信息交流，协助构建创新发展的行业生态。

(二) 推动科技创新情况

公司致力于不断迭代技术，助力行业企业推陈出新。报告期内，在 AI 领域与谷歌合作开源项目 Open Se Cura 中，开发多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低功耗空间计算，并提供

优质、高效的 AIGC 输入（Token）；搭建基于芯原技术的可穿戴系统生态，趣戴科技（QDay Technology）宣布加入芯原的全球手表 GUI 生态系统，双方共同开发适用于各种应用的智能手表 GUI 解决方案；与嵌入式系统领域领先的开源图形库 LVGL 达成战略合作，在 LVGL 库中支持芯原的低功耗 3D 和 VGLite 2.5D GPU 技术，炬芯科技智能手表系统级芯片结合芯原低功耗 GPU 技术与 LVGL 图形库，提升新一代可穿戴设备的用户体验；推出车规级系列 IP 和芯片定制服务以助力汽车芯片的发展，公司的第二代 ISP 系列 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 和 ASIL D 认证，畸变矫正处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证，显示处理器 IP 通过了 ISO 26262 ASIL B 认证，其他 IP 也正在逐一通过车规认证的进程中。此外，公司还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。

(三) 遵守科技伦理情况

公司主要经营业务围绕芯片定制服务和半导体 IP 授权服务，不直接参与其应用的产品终端，不涉及科技伦理议题。

(四) 数据安全与隐私保护情况

公司严格保护企业信息安全及客户信息和隐私。公司已通过 ISO 27001:2013 信息安全管理体系认证，已制定《信息安全管理体系手册》《信息安全方针》《组织安全方针》《人员安全方针》《通信与操作管理方针》《个人信息管理制度》等一系列政策和文件，对公司运营存在信息安全和隐私泄露风险的各个环节，进行了人为和系统规定，保护公司信息资产，包括硬件、软件、数据、信息安全和客户知识产权防止由外部威胁或内部管理不当导致的泄露、破坏、篡改或丢失，确保业务连续，保护公司声誉，预防安全事件并将其影响最小化。具体措施包括：

（1）在设备安全上，公司使用标准化机房，安装了硬件防火墙，可有效防止黑客与计算机病毒的攻击；通过网络划分形成办公网络、生产网络、监控网络相互隔离，保证数据安全。IT 机房内配备 24 小时监控摄像，恒温空调，并加装 UPS 系统保证供电稳定。

（2）在运行安全上，公司专门成立有信息技术部门负责完善信息安全管理制度的定期对机房设备进行安全巡查。

（3）公司通过会议、专题培训形式向员工宣贯信息安全的重要性，使员工熟知公司《通用信息安全政策》。

2024 年，本公司未发生过与信息安全或与隐私保护相关的违法违规事件。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		

其中：资金（万元）	59.1	详见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）	-	
公益项目		
其中：资金（万元）	-	
救助人数（人）	-	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	42.06	详见下文“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况”
物资折款（万元）	-	
帮助就业人数（人）	-	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司捐赠高校教育基金会人民币 56.5 万元，收到了多所高校及其基金会的感谢信。同时，公司组织员工义卖并捐款支持海洋保护公益项目 1 万元、向麦田教育基金会“彩虹口袋”公益项目捐赠 1 万元、向凉山州螺髻山中学两位高一女生资助 6000 元重返校园完成学业。

此外，公司长期关注教育事业发展与行业技术进步，具体包括：

（1）技术课程进校园

公司在电子科技大学开设电路、版图、芯片物理设计等一系列课程，由芯原多位技术专家讲师授课，课程面向电子科技大学的所有在校研究生、大三学生。

（2）“芯原杯”电路设计大赛

报告期内，公司与高校进行合作，携手西安电子科技大学、电子科技大学举办 2024“芯原杯”电路设计大赛，以“生成式人工智能(AIGC)”为主题，吸引了来自西安、成都地区高校的 60 余支队伍参加；携手东南大学、南京大学举办了 2024“芯原杯”电路设计大赛-南京站，以模拟及射频电路设计为核心命题，吸引了国内 10 所高校的 65 支队伍参加。

（3）“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛

报告期内，公司面向全国多所高校，举办了 2024“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛，参赛团队基于芯原股份的 VeriHealthi 开发平台完成关键词检测算法。旨在培养学生在嵌入式芯片与系统设计方面的创新与实践能力。大赛共吸引了全国 7 大赛区，52 所高校的 278 支队伍报名参赛。

（4）全国大学生集成电路创新创业大赛

报告期内，公司冠名了由工信部主办的第八届全国大学生集成电路创新创业大赛数字与混合信号芯片设计赛道，聚焦“8 位高速 SAR ADC 设计”赛题，共有 210 支队伍参加初赛，75 支队伍进入分赛区决赛，22 支队伍入围全国总决赛。公司携手“全国大学生集成电路创新创业大赛”，以服务产业发展需求为导向，为打造产学研用协同创新平台，提升在校大学生创新实践能力、工

程素质以及团队协作精神，助力我国集成电路产业健康快速发展做出了突出贡献。

(5) 与高校共建实训基地

报告期内，芯原成都与四川大学共建实习实训基地，独家赞助电子科技大学计算机科学与工程学院主办的计算机科学拔尖学生培养基地 2024 年“成长伙伴”国际暑期学校活动，为西南交通大学举办 HRBP 主题讲座。芯原南京与东南大学信息科学与工程学院合作开展暑期实习、就业指导讲座。芯原海南获聘电子科技大学格拉斯哥海南学院工业顾问委员会成员，共同探索合作新路径。芯原股份受邀在北京大学集成电路学院和清华大学集成电路学院分别举办了学术讲座，参加上海交通大学集成电路学院专业分流宣讲活动，走进浙江大学举办就业指导讲座，深入合作人才培养。

(6) 改善贫困地区教育环境

报告期内继续参与麦田教育基金会发起的“彩虹口袋”公益项目，持续助力山区儿童美育，继续资助凉山失学学生，推进教育公平，共享优质教育。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	42.06	详见下文“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况”
其中：资金（万元）	42.06	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	消费帮扶、教育扶贫	详见下文“巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况”

具体说明

√适用 □不适用

公司贯彻落实党和国家关于乡村振兴的相关工作部署要求。报告期内，公司采取消费帮扶，采购内蒙古清水河县、四川简阳市禾丰镇、四川凉山雷波县和德昌县助农产品共计人民币 46.46 万元，作为员工福利发放，同时推进乡村振兴。此外，公司继续向麦田教育基金会发起的“彩虹口袋”公益项目捐赠 1 万元，持续助力山区儿童美育教育。芯原成都通过多次慈善义卖活动累计筹得人民币 27,867.87 元员工公益金，将其中人民币 6,000 元善款用于凉山州螺髻山中学两位高一女生资助，扶贫济困，为教育平权贡献力量。

(六) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

(七)职工权益保护情况

公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等经营所在地的法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，保障员工合法权益，按时足额发放员工薪酬、缴纳社会保险和住房公积金。公司坚持以人为本，推崇公正、关爱、分享与快乐（Fair、Care、Share、Cheer）的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

员工持股情况

员工持股人数（人）	1,053
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	52.28
员工持股数量（万股）	7,117.25
员工持股数量占总股本比例（%）	14.22

注 1：上述员工持股情况统计口径为公司通过 2019 年股票期权激励计划（包括上市前落实员工持股安排及带上市期权）、2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划累计向报告期末在册员工授出情况，不包含员工于二级市场自行买卖的情形。

注 2：员工持股人数占公司员工总数比例的计算基于 2024 年 12 月 31 日的公司总人数，员工持股数量占总股本比例的计算基于 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计口径。

(八)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据承接的客户的订单预测制定采购计划，确保服务交期及时、质量可控。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、质量控制等方面指标，选择符合要求的晶圆制造、封装测试及模组生产供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在服务交期、质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

(九)产品安全保障情况

公司是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业，生产制造环节由晶圆制造及封装测试企业代工完成。公司一直坚持为客户提供优质的服务，严格把控服务质量，注重安全管理，高度重视服务过程中及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，先后通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。报告期内，低功耗蓝牙整体 IP 解决方案通过 LE Audio 全部功能认证，显示处理器 IP 和畸变矫正处理器 IP 通过 ISP IP 通过车规和工规认证，芯片设计流程通过车规认

证。

截至报告期末，公司未发生任何安全事故。

(十) 知识产权保护情况

在知识产权保护方面，公司的核心技术均来源于长期的技术投入和自主创新，拥有独立的知识产权。针对核心技术，公司制定了严格的知识产权保护措施和制度，已形成一套包括专利、非专利技术、商标、软件著作权保护措施的知识产权保护体系，切实保护公司的创新成果。公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和相关技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。

公司尊重同行业其他公司的知识产权，主动规避知识产权纠纷，截至报告期末，核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷，报告期内未发生知识产权诉讼或仲裁情况。

报告期内，公司新增 126 件发明专利申请、16 件商标注册申请、30 件集成电路布图设计登记申请，共获得 28 件发明专利授权、9 件商标注册核准、33 件集成电路布图设计专有权授权。截至报告期末，公司累计获得有效授权知识产权为 205 件发明专利、3 件实用新型专利、2 件外观设计专利、12 件软件著作权、140 件商标及 264 件集成电路布图设计专有权。芯原的 IP 产品(IP Portfolio 1.0)，关联 20 项专利，成为国家认定的专利密集型产品。报告期内，公司主办 RISC-V 产业技术研讨会暨 RISC-V 专利导航成果发布会，发布 RISC-V 产业专利导航报告，分析研判 RISC-V 产业发展方向与趋势，为企业技术创新提供了重要参考。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主动承担并践行社会责任，专注于低能耗的绿色技术研发与应用，希望通过科技创新节约能源，实现可持续发展。坚持技术开源与共享，为全世界的客户与开发者提供卓越的一站式芯片定制和半导体 IP 授权服务。同时，公司重视当前芯片设计与先研技术的发展，牵头成立上海开放处理器产业创新中心，推动中国成为全球 RISC-V 技术创新和应用的引领者，同时在多个行业协会中担任重要角色，并每年筹办“滴水湖论坛”、“松山湖论坛”、“南渡江论坛”等行业交流会。

五、其他公司治理情况

(一) 党建情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，在党支部全体党员的共同努力下，公司各项党建工作有序开展，抓基层、打基础，抓重点、求突破，有效加强了支部基层党建工作。公司党支部充分发挥主观能动性，以党的思想建设丰富和深化企业文化，助力公司持续发展。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2023 年年度业绩说明会，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年半年度业绩说明会，于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	12	1、在上证路演中心以网络互动交流的方式召开 3 次业绩说明会；2、在进门财经通过网络及电话互动方式召开 6 场交流会议；3、在 2023 年年报、2024 年半年报、2024 年三季报编制“一图读懂”可视化报告，向投资者展现公司财报要点；
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	详见 https://www.verisilicon.com 投资者关系专栏。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，公司信息披露的指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息披露的指定报刊为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司通过内外部培训，持续加强董监高、董事会秘书及相关人员合规意识，同时建立完善《信息披露管理制度》等信息披露制度体系，保障法定信息应披尽披。同时，加强对公司业务与技术等核心信息的披露，通过内外部培训持续提升信息披露工作人员对公司业务与技术的理解度和信息披露水平，在保证技术秘密和商业秘密不泄露的前提下，披露内容力求详细、全面、准确，披露语言力求通俗易懂，避免大量使用专业术语或其他晦涩词汇，增强信息披露可读性。

报告期内，公司不断提升公司信息的披露透明度与及时性，共计披露定期报告 4 份，发布临时公告 58 个。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

公司股权结构比较分散，无控股股东和实际控制人，机构股东占比较高，机构股东类型包括公募基金、私募基金、证券、保险机构、QFII 等。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均有机

构投资者参与投票，参与率 100%。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国民法典》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等有关法律法规，建立《员工商业行为准则》，制定实施《Anti-Bribery and Anti-Corruption Compliance Policy 反贿赂与反腐败合规制度》，涉及公平交易、反贿赂反腐败、馈赠与款待等商业道德方面的内容，明确员工在内部管理及外部商业往来中应当遵守的基本原则及规定，确保员工能够在法律要求范围内秉承诚信、公平的原则开展业务。

公司已要求员工签署廉洁自律承诺书，建立了定期的培训和教育机制，并要求客户、商业合作伙伴等第三方承诺和遵守公司制定的相关合规政策。公司内审部负责日常业务流程合规检查，长期关注内外部关于商业贿赂和贪污的举报情况。公司业务流程规范透明，合作伙伴信誉良好。报告期内，综合评估商业道德相关风险处于较低水平。

此外，公司建立了员工、外部利益相关方的投诉举报制度和实施办法，并在公司官网公布了举报途径。

报告期内，本公司未发生贪污、受贿、行贿等方面的违规事件。

(六) 其他公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的	其他	VeriSilicon Limited	1、公司实现盈利后，本企业方可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的其他规定。2、上述限售期满后2年内，如本企业拟进行减持的，本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下统称“监管规则”）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。3、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。本企业所持	2019 年 9 月 10 日	是	锁定期满后两年	是	不适用	不适用

承诺与再融资相关的承诺			有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司本次发行上市时的股票发行价（以下简称“公司股票发行价”）；若公司在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。4、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。						
	股份限售	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	1、离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。2、公司实现盈利后，本人方可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺内容及《上市规则》的其他规定。3、在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。若本人不再担任公司董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。4、上述限售期满后2年内，如本人拟进行减持的，本人减持本人持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。5、本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。本人持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票发行价；若公司在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整。6、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019年9月10日	是	本人担任公司董事或高级管理人员期间和离职后6个月内；锁定期满后两年	是	不适用	不适用
	其他	香港富策、国家集成电路基	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关监管规	2019年9月	是	持有公	是	不适用	不

他	金、兴橙投资方、小米基金、共青城原厚、共青城原德、VeriVision LLC	则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	10 日		司股份期间			适用
其他	共青城原天、共青城原道、共青城原酬、共青城原勤、共青城原载、共青城原物、共青城原吉	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
其他	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、陈晓飞、范灏成、钱哲弘、汪洋、David Jarmon、石雯丽、张慧明	1、公司实现盈利后，本人自当年年度报告披露后次日起方可减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺内容及《上市规则》的其他规定。2、若本人在前述期间内因离职、职务变动等原因不再担任公司的董事、监事、高级管理人员和/或核心技术人员，本人亦将继续遵守前述承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	张慧明：2022 年 9 月 10 日、其他：2020 年 8 月 16 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
解决同业竞争	VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、香港富策、兴橙投资方	1、截至承诺函出具之日，本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。2、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（1）单独或与第	2019 年 9 月 10 日	是	自 2019 年 9 月 10 日至承诺方不再是单独	是	不适用	不适用

			三方以任何形式直接或间接从事与公司或其下属企业目前及今后进行的主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）； （2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权或权益。3、承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业/本人不再是单独或与关联方合计持有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人；（2）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对承诺函项下某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。4、“下属企业”：就承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行股份或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。			或与关联方合计持有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人、公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外），或国家规定对承诺函项下某项承诺的内容无要求时，相应部分			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						自行终止			
	解决同业竞争	国家集成电路基金	1、截至承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事与公司或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：不会通过设立或收购等方式直接或间接取得竞争企业的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控股性股权或控制性权益。3、承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是公司 5%以上股份的股东或其一致行动人；（2）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。4、“下属企业”：就承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，以及该其他企业或实体的下属企业。	2019 年 9 月 10 日	是	自 2019 年 9 月 10 日至承诺方不再是单独或与关联方合计持有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人、公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外），	是	不适用	不适用

						或国家 规定对 某项承 诺的内 容无要 求时， 相应部 分自行 终止			
解 决 关 联 交 易	VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、国家集成电路基金、香港富策、兴橙投资方	1、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业/本人将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业/本人将与公司依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和届时有有效的《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将严格遵照公允定价的原则实施。3、本企业/本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。4、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司或其他股东、债权人利益的行为。	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用	
分 红	公司	公司承诺将严格执行 2018 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的规定，实施积极地利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用	
其 他	IDG、IDG III、IDG IV、Jovial、Focuspower、Korus、Anemoi、Miven、SVICNo.25、SVICNo.33、合肥华芯、华电联网、嘉兴君朗、嘉兴君祥、	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予	2019 年 9 月 10 日	是	持有公 司股份 期间	是	不适用	不适用	

		浦东新兴、上海艾欧特、申毅创合、西藏德远、张江火炬、Intel、VantagePoint	以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份减持有新的规定，则本企业在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。						
其他		隆玺壹号	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019年9月10日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
其他		Han, Kuang-Chung（韩光中）、Hsu, Ming-Kang（许明刚）、Lee-Min Tsai、Margaret Tsai Cheng	1、本人减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本人减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺（如有）。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份减持有新的规定，则本人在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019年9月10日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
其他		公司	1、公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的本次发行上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、公司愿意承担违背上述承诺而产生的全部法律责任。	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
其他		公司首次申报时的董事、监事、高级管理人员	1、公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的本次发行上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

			公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出公司构成欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》的规定及中国证监会等有权部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。						
其他	公司		1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告，并在5个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	VeriSilicon Limited		1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促公司在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

			准或备案；督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。同时，本企业将根据上述股份回购措施的规定，依法购回公司上市后本企业减持的原限售股份，回购价格为市场价格或经证券监督管理部门认可的其他价格。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。						
其他	公司		若公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告，并在5个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，具体回购方案如下：1、在监管部门认定的有关违法事实之日起5个交易日内，公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知、进行公告；公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；3、回购数量：首次公开发行的全部新股；4、回购价格：公司股票已发行但尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司股票已上市的，回购价格不低于相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中，前10个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前10个交易日公司股票	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

			交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。						
其他	公司		公司承诺将加强募集资金的管理和运用，确保募集资金效益；扩大业务规模，全面提升公司的综合实力和核心竞争力，降低财务风险，增强公司盈利能力，充分保护中小投资者的利益，采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高回报能力，具体承诺如下：1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报公司已对本次发行上市的募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划，若本次募集资金投资项目顺利实施，将有利于提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域公司自成立以来，专注于为客户提供一站式芯片定制和半导体 IP 授权服务。未来公司将进一步扩大现有业务的市场规模，开拓新市场和新领域，并不断开发新技术新产品，使公司产品在技术水平上保持国内领先水平，从而持续提升公司的盈利能力。3、加强募集资金管理本次发行上市的募集资金到账后，公司将根据相关法律法规、规范性文件以及《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定开设募集资金专户，加强对募集资金的管理、使用和监督。4、加强经营管理和内部控制，降低公司运营成本，提升经营效率公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面控制公司经营和管控风险。同时，公司在日常经营中细化项目预算的编制，降低公司运营成本，提升公司业绩。5、优化投资回报机制公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

			利润分配政策的连续性和稳定性。						
其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	高级管理人员 Martyn Humphries：2022 年 4 月 27 日、董事孙国栋：2021 年 8 月 30 日、高级管理人员汪志伟：2021 年 2 月 1 日、其他董事、高级管理人员：2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用	
其他	公司	1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序，下同）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；（4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（5）如违反相关承诺给投资者造成损失并经中国证监会等有权部门认定应承担赔偿责任的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用	

		或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。						
其他	国家集成电路基金	1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（5）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	合肥华芯	1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

		须转股的情形除外；（4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（5）如违反相关承诺给投资者造成损失并经中国证监会等有权部门认定应承担责任的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。						
其他	Intel	1、根据监管规则的要求，如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业将向公司说明未履行承诺的原因并由公司向股东和社会公众投资者公开道歉；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（3）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。2、根据监管规则的要求，如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）向公司说明未履行的原因并由公司向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	VantagePoint	1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行本企业公开承诺事项的，本企业需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

			歉；（2）本企业应及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（5）本企业应向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将在适用法律规定的范围内依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本企业需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业应在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。（3）为避免疑问，仅当承诺人不遵守或违反承诺人对题述事宜的承诺时，才适用承诺函中的约束措施。在任何情况下，承诺人不对公司或其他股东或其他承诺方（包括公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，如适用）的任何不遵守或违反任何承诺的行为负责。						
其他	董事、监事、高级管理人员、VeriSilicon Limited、香港富策、兴橙投资方、嘉兴君祥、嘉兴君朗、浦东新兴、SVIC No.33、SVIC No.25、Jovial、西藏德远、IDG、IDG III、IDG IV、上海艾欧特、Anemoi、Focuspower、Miven、Korus、	1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技	张慧明：2022年9月10日、高级管理人员 Martyn Humphries：2022年4月27日、董事孙国栋：2021	否	长期	是	不适用	不适用	

		张江火炬、申毅创合、华电联网、共青城原天、共青城原道、共青城原酬、共青城原勤、共青城原厚、共青城原德、共青城原载、共青城原物、共青城原吉、VeriVision LLC、小米基金、隆玺壹号、Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)、Han, Kuang-Chung (韩光中)、Hsu, Ming-Kang (许明刚)、Lee-Min Tsai, Margaret Tsai Cheng、张慧明、范灏成	术人员调减或停发薪酬或津贴；(4)不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；(5)向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；(6)如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业/本人将继续履行该等承诺。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	年8月30日、高级管理人员汪志伟：2021年2月1日、其他主体：2019年9月10日					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2023年12月22日	否	长期	是	不适用	不适用
其他承诺	股份限售	Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)、Wei-Jin Dai (戴伟进)、施文茜、汪洋、汪志伟、Martyn Humphries	自2024年2月5日起6个月内不减持其直接持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份（详见公司公告编号为2024-006的相关公告）。	2024年2月5日	是	自2024年2月5日起6个月内	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目
财政部分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》。	无

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）审批程序及其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	255.00
境内会计师事务所审计年限	22 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈颂、黄宇翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5 年、5 年

单位：万元 币种：人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	45.00
保荐人	国泰海通证券股份有限公司	/

注 1：2024 年 2 月，公司变更持续督导机构，由海通证券股份有限公司担任公司持续督导机构。报告期初至 2024 年 2 月，由招商证券股份有限公司担任公司持续督导机构。

注 2：2025 年 4 月，海通证券股份有限公司存量客户与业务整体迁移并入国泰海通证券股份有限公司，海通证券股份有限公司承接的投资银行业务均由国泰海通证券股份有限公司完整承继，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☒本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

（三）其他说明

☒适用 ☐不适用

就 2019 年 11 月 19 日香港比特对芯原香港提起的诉讼，双方达成和解。双方签署 Settlement Agreement 后，已就申请终止诉讼向中华人民共和国香港特别行政区高等法院原讼法庭（以下简称“香港法院”）提交同意传票，并收到香港法院准予终止诉讼的裁定。香港法院裁定此诉讼案件终止，香港比特亦不能就同一诉讼理由再提起诉讼。

详情请查阅公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于子公司涉及诉讼事项达成和解暨收到终止诉讼裁定的公告》（公告编号：2024-027）。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议暨 2023 年年度董事会、2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》。详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司本年度预计发生的日常关联交易额度 3,500.00 万元（额度期限自董事会审议通过前述议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止），详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司本年度预计发生的日常关联交易额度合计 25,800.00 万元（额度期限自股东大会审议通过前述议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止）。详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-041）。

报告期内，预计的日常关联交易实际发生额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	报告期内发生金额

向关联人购买原材料	芯思原	2,600.00	371.90
	Alphawave	25,000.00	3,979.00
	威视芯	2,300.00	-
	湖南越摩先进半导体有限公司	6,000.00	1,819.08
	智瀚星途	300.00	175.00
	Silicon Box Pte Ltd	1,000.00	-
	鹏瞰集成电路（杭州）有限公司	1,800.00	256.66
	至成微科技（浙江）有限公司	700.00	-
	小计	39,700.00	6,601.64
向关联人销售产品、商品	芯思原	3,000.00	26.67
	南京迈矽科微电子科技有限公司	2,000.00	-
	至成微科技（浙江）有限公司	4,300.00	729.26
	智瀚星途	1,000.00	-
	兆易创新	3,000.00	742.53
	广州增芯科技有限公司	2,800.00	552.46
	威视芯	800.00	-
	上海华力集成电路制造有限公司	500.00	-
	小计	17,400.00	2,050.92
合计		57,100.00	8,652.56

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
芯原股份	公司本部	芯原香港、芯原开曼	全资子公司	1,000万美元	2020年10月30日	2020年10月30日	至芯原香港、芯原开曼的订单履行完毕或担保人在本担保项下担保人的总付款额达到担保限额	连带责任担保	否	否		/	否	

芯原股份	公司本部	芯原南京	全资子公司	30万元人民币	2021年4月15日	2021年4月15日	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	连带责任担保	否	否		/	否
芯原股份	公司本部	芯原香港	全资子公司	1,300万美元	2021年4月20日	2021年4月20日	不适用	连带责任担保	否	否		/	否
芯原股份	公司本部	芯原科技	全资子公司	25,000万元人民币	2022年7月4日	2022年7月4日	借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	连带责任担保	否	否		/	否
芯原股份	公司本部	芯原海南	全资子公司	1,300万美元	2024年2月27日	2024年3月1日	2027年2月28日	连带责任担保	否	否		/	否
芯原股份	公司本部	芯原香港	全资子公司	300万美元	2024年12月1日	2024年12月1日	主合同所约定的债务履行期届满之日起两年	连带责任担保	否	否		/	否
报告期内对子公司担保发生额合计					1.15								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					5.31								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					5.31								
担保总额占公司净资产的比例(%)					25.00								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0								

上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

注1：如涉及结算单位为美元的担保，汇率以7.1884进行折算；
注 2：担保日期显示为“不适用”的担保，其项下实际发生的还款期限可能发生变动，暂无法确定担保到期日，主合同债务根据协议约定清偿完毕后相关担保即终止。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	40,833.00	11,227.57	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000.00	0	0

其他情况
□适用 √ 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计	减值准备计提金额(如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	----------	--------	-------	----------	---------	-------	---------	----------	------------	--------------

															划	
浦发 银行	银行 理财 产品	5,000. 00	2024/1 2/4	2025/2 /20	自有 资金	银行 固收 产品	否	合同 约定	2%	9.31		5,000. 00	0	是	否	0
招商 银行	银行 理财 产品	3,000. 00	2024/1 1/27	2025/1 /24	自有 资金	银行 固收 产品	否	合同 约定	1.95%	5.10		3,000. 00	0	是	否	0
浦发 银行	银行 理财 产品	3,200. 00	2024/1 0/9	2025/2 /24	自有 资金	银行 固收 产品	否	合同 约定	2%	13.16		3,200. 00	0	是	否	0

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2020年8月13日	1,861,742,205.17	1,677,953,077.52	790,000,000.00	887,953,077.52	1,736,728,352.89	933,150,269.07	103.50	105.09	80,993,169.21	4.83	-
合计	/	1,861,742,205.17	1,677,953,077.52	790,000,000.00	887,953,077.52	1,736,728,352.89	933,150,269.07	/	/	80,993,169.21	/	-

注：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金拟用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。

其他说明
☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用
1、 募集资金明细使用情况
☒适用 ☐不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	研发	是	否	150,000,000.00	1,014,644.58	151,131,473.56	100.75	2024 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	192.96 万元
首次公开发行股票	智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台项目	研发	是	否	110,000,000.00	-	113,486,346.90	103.17	2022 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	215.78 万元（两项目

首次公开发行股票	智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	研发	是	否	110,000,000.00	-	111,664,603.67	101.51	2022 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	使用同一募集资金专户)
首次公开发行股票	智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	研发	是	否	120,000,000.00	-	118,967,830.18	99.14	2022 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	443.92 万元
首次公开发行股票	研发中心升级项目	研发	是	否	300,000,000.00	-	308,327,829.51	102.78	2022 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	93.77 万元
首次公开发行股票	永久补充流动资金	补流还贷	否	否	535,678,253.04	4,678,253.04	535,678,253.04	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	研发中心建设项目	研发	否	否	390,000,000.00	75,300,271.59	397,472,016.03	101.92	2024 年	是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	1,715,678,253.04	80,993,169.21	1,736,728,352.89	/	/	/	/	/	/	/	/	-

2、超募资金明细使用情况
√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	535,678,253.04	535,678,253.04	100.00	

研发中心建设项目	新建项目	390,000,000.00	397,472,016.03	101.92	
合计	/	925,678,253.04	933,150,269.07	/	/

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024 年 3 月 29 日	5,000.00 (含)	2024 年 3 月 29 日	董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会/股东大会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）	0.00	否

其他说明
无

4、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	12,232,033	2.45				-9,650,142	-9,650,142	2,581,891	0.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,404,062	2.28				-8,822,171	-8,822,171	2,581,891	0.52
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	11,404,062	2.28				-8,822,171	-8,822,171	2,581,891	0.52
4、外资持股	827,971	0.17				-827,971	-827,971	0	0.00
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	827,971	0.17				-827,971	-827,971	0	0.00
二、无限售条件流通股份	487,679,199	97.55				10,093,992	10,093,992	497,773,191	99.48
1、人民币普通股	487,679,199	97.55				10,093,992	10,093,992	497,773,191	99.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	499,911,232	100.00				443,850	443,850	500,355,082	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）2024年1月16日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 652,057 股上市流通，该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件流通股，详情请查阅公司于 2024 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-001）。

（2）2024年3月4日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 2,217,852 股上市流通，该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件流通股，详情请查阅公司于 2024 年 2 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-009）。

（3）2024年7月1日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 1,807,893 股上市流通，该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件流通股，详情请查阅公司于 2024 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-025）。

（4）2024年9月23日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 588,568 股上市流通，该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件流通股，详情请查阅公司于 2024 年 9 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-036）。

（5）2024年11月6日，公司首次公开发行前股票期权行权限售股 4,383,772 股上市流通，该部分股份由有限售条件股份转为无限售条件流通股，详情请查阅公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-039）。

（6）2024年11月27日，公司完成2020年限制性股票激励计划下 443,850 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的归属登记工作并上市流通，该部分股份为无限售条件流通股，公司新增股本 443,850 股，公司股本总数增加至 500,355,082 股，详情请查阅公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-045）。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内因上述限制性股票归属带来的普通股股份变动导致公司总股本、净资产、每股净资产有所增加，会对公司每股收益和加权平均净资产收益率等固定即期回报造成摊薄影响，由于公司资产规模较大，上述摊薄影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
DAI,WAYNE WEI-MING (注 1)	827,971	827,971	0	0	员工期权行权限售	2024 年 11 月 6 日
芯原员工期权行权 (注 2)	11,404,062	8,822,171	0	2,581,891	员工期权行权限售	期权行权登记后限售期三年
合计	12,232,033	9,650,142	0	2,581,891	/	/

注 1：DAI,WAYNE WEI-MING 限售股份为期权行权股份 827,971 股，于 2024 年 11 月 6 日解除限售条件。

注 2：员工期权行权股份不包含 DAI,WAYNE WEI-MING 期权行权股份，DAI,WAYNE WEI-MING 期权行权股份限售情况已单独列示，具体请见注 1。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

报告期内因实施股权激励计划导致公司股份总数、股东结构及公司资产和负债结构发生变化。报告期初资产总额 44.06 亿元，负债总额为 17.06 亿元，资产负债率为 38.72%；报告期末资产总额为 46.30 亿元，负债总额为 25.08 亿元，资产负债率为 54.16%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	26,418
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,327

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
VeriSilicon Limited	-	75,678,399	15.12	0	无	0	境外法人
富策控股有限公司	-	39,204,256	7.84	0	无	0	境外法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-	34,724,272	6.94	0	无	0	国有法人
共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）	-	24,523,402	4.90	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,902,965	22,740,465	4.54	0	无	0	其他
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	-	20,573,708	4.11	0	无	0	其他
上海浦东新兴产业投资有限公司	175,800	15,265,919	3.05	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,666,077	14,657,981	2.93	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	-1,817,578	13,851,023	2.77	0	无	0	其他
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	-10,201,732	13,380,647	2.67	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
VeriSilicon Limited	75,678,399	人民币普通股	75,678,399
富策控股有限公司	39,204,256	人民币普通股	39,204,256
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	人民币普通股	34,724,272
共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）	24,523,402	人民币普通股	24,523,402
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	22,740,465	人民币普通股	22,740,465
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	20,573,708	人民币普通股	20,573,708
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,265,919	人民币普通股	15,265,919
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	14,657,981	人民币普通股	14,657,981
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金	13,851,023	人民币普通股	13,851,023
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司－湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	13,380,647	人民币普通股	13,380,647
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司； 2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	19,837,500	3.97	3,718,800	0.74	22,740,465	4.54	0	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,090,119	3.02	175,800	0.04	15,265,919	3.05	0	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板	6,991,904	1.40	1,528,100	0.31	14,657,981	2.93	0	0

50 成份交易型开 放式指数证券投 资基金								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	芯原员工期权行权	2,581,891	2025 年 1 月 7 日	718,357	期权行权登记后限售期三年
			2025 年 7 月 28 日	1,863,534	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转
融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期
发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况
☐适用 ☒不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

1. 控股股东情况

一、法人

☐适用 ☒不适用

二、自然人

☐适用 ☒不适用

三、公司不存在控股股东情况的特别说明

☒适用 ☐不适用

公司股权相对分散，不存在控股股东。截至报告期末，如按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份登记口径计算，公司第一大股东 VeriSilicon Limited 的持股比例为 15.12%，公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定。

四、报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

2. 实际控制人情况

1. 法人

☐适用 ☒不适用

2. 自然人

☐适用 ☒不适用

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒适用 ☐不适用

公司股权相对分散，不存在实际控制人。截至报告期末，如按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份登记口径计算，公司第一大股东 VeriSilicon Limited 的持股比例为 15.12%，公司经营方针及重大事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定。

4. 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

3.控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
VeriSilicon Limited	Wayne Wei-Ming Dai (戴 伟民)	2016 年 6 月 16 日	MC312558	23,759.32	投资控股
情况说明	VeriSilicon Limited 为公司境外持股平台。				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(25)第 P05241 号

芯原微电子(上海)股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原上海”或“贵公司”)的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 企业合并形成的商誉的减值评估

事项描述

如财务报表附注所述，于 2024 年 12 月 31 日，贵公司因业务收购产生的商誉原值为人民币 181,673,277.96 元。如财务报表附注三、21 与附注四所述，贵公司对于商誉至少每年年度终了进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司进行恰当的财务预测以确定未来现金流以及确定现金流折现所采用的折现率等关键参数时会涉及管理层的重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值的评估作为关键审计事项。

审计应对

针对商誉减值，我们所执行的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价集团与商誉减值测试相关的关键内部控制，并测试其运行有效性；
- (2) 检查管理层认定商誉分摊至资产组的依据并评价其合理性；
- (3) 与管理层聘请的外部评估专家进行访谈，了解其相关资质，对其独立性和胜任能力进行评价；

(4) 在内部评估专家的协助下,复核并评价管理层及外部评估专家在减值测试所采用的评估方法、所使用的关键假设、未来现金流预测以及折现率等关键参数的合理性和恰当性。将预计未来现金流量与历史数据及其他支持性证据进行核对,并考虑其合理性;

(5) 获取管理层编制的包含商誉的资产组的减值测试详细计算表,并进行重新计算,复核其计算的准确性。

(二) 收入确认

事项描述

如附注所述,贵公司在 2024 年度的芯片设计业务收入为人民币 724,793,989.62 元,占期间主营业务收入比例为 31.28%。芯片设计业务收入金额重大且收入构成财务报表中的关键财务指标。根据财务报表附注披露的收入确认会计政策,贵公司提供的芯片设计服务在一段时间内确认收入。贵公司按项目归集实际发生的成本,期末根据每个项目实际发生的成本相比预算总成本的比例确定履约进度,根据项目合同收入和履约进度计算确认对应的芯片设计业务收入。芯片设计业务收入的准确性依赖于实际发生成本计量的准确性以及项目预算总成本编制的准确性。我们将芯片设计业务收入确认作为关键审计事项。

审计应对

针对芯片设计业务收入,我们所执行的审计程序主要包括:

(1) 询问贵公司管理层,查阅合同条款,评估贵公司芯片设计业务收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(2) 了解并评价贵公司与芯片设计业务收入确认相关的关键内部控制,包括由内部信息系统审计专家团队协助对信息系统的控制环境和涉及信息系统的自动控制进行测试;

(3) 检查芯片设计业务合同条款和成本预算资料,识别异常预计毛利项目,分析其合理性;对于金额较大的跨期项目,选取其中预算成本及预计收入有较大调整的项目,结合项目的实际完成及变更(如适用)情况,分析其预算成本及预计收入在不同期间变动的合理性,评估管理层对预计总收入和预算总成本的估计的适当性;

(4) 对已经发生的实际成本选取样本查看相应的支持性文件以测试实际成本计量的准确性以及是否计入正确的期间;

(5) 基于项目实际发生的成本以及预算成本计算履约进度,并根据各项目收入总金额重新计算各期间收入应确认金额,检查收入计算的准确性。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2024 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错报导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈颂

中国·上海 （项目合伙人）

中国注册会计师：黄宇翔

2025 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	746,936,585.63	688,780,004.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	112,275,721.57	400,130,371.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,262,703.21	62,618,020.73
应收账款	七、5	943,159,376.80	1,021,639,249.64
应收款项融资			
预付款项	七、8	64,464,655.72	23,436,759.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	1,587,995.67	4,843,578.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	395,514,800.55	278,622,683.88
其中：数据资源			
合同资产	七、6	245,160,930.38	95,979,081.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	108,833,220.80	141,894,324.69
流动资产合计		2,638,195,990.33	2,717,944,075.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,000,436.21	5,056,691.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	201,122,863.23	199,633,824.73
投资性房地产			

固定资产	七、21	720,825,971.90	505,111,613.96
在建工程	七、22	153,397.98	6,470,170.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	78,559,746.99	43,887,345.21
无形资产	七、26	523,515,404.89	396,537,174.64
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	181,673,277.96	179,045,744.16
长期待摊费用	七、28	30,984,493.90	31,095,376.07
递延所得税资产	七、29		
其他非流动资产	七、30	253,827,733.58	321,598,959.54
非流动资产合计		1,991,663,326.64	1,688,436,900.38
资产总计		4,629,859,316.97	4,406,380,975.42
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	163,165,886.05	96,068,423.33
预收款项			
合同负债	七、38	606,777,460.39	453,522,036.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	190,741,382.83	161,153,376.07
应交税费	七、40	37,418,106.15	26,777,484.40
其他应付款	七、41	81,335,178.31	27,711,609.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	434,493,142.34	167,211,117.55
其他流动负债	七、44	33,308,100.71	17,551,708.52
流动负债合计		1,547,239,256.78	949,995,756.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	832,552,665.76	659,611,343.09
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	44,527,984.11	22,266,072.78
长期应付款	七、48	83,221,735.16	40,994,966.23

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债	七、52	0.00	33,219,216.00
非流动负债合计		960,302,385.03	756,091,598.10
负债合计		2,507,541,641.81	1,706,087,354.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	500,355,082.00	499,911,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,089,816,091.73	4,065,238,348.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-51,516,446.79	-49,398,266.27
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-2,416,337,051.78	-1,815,457,693.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,122,317,675.16	2,700,293,620.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,122,317,675.16	2,700,293,620.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,629,859,316.97	4,406,380,975.42

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		580,892,970.34	395,772,586.93
交易性金融资产		80,144,135.76	300,043,287.67
衍生金融资产			
应收票据		20,262,703.21	62,618,020.73
应收账款	十九、1	1,392,822,794.40	1,518,171,414.28
应收款项融资			
预付款项		38,987,550.91	16,130,418.11
其他应收款	十九、2	313,827.39	7,009,130.34
其中：应收利息			
应收股利			
存货		196,213,471.16	58,404,361.45
其中：数据资源			

合同资产		191,337,270.72	77,039,812.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,730,150.93	129,039,615.70
流动资产合计		2,581,704,874.82	2,564,228,648.06
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	836,660,864.37	839,105,372.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		184,228,363.23	182,739,324.73
投资性房地产			
固定资产		52,117,238.09	29,886,063.91
在建工程		0.00	3,267,547.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,687,926.75	14,566,347.51
无形资产		263,492,075.07	218,565,031.17
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,991,871.13	5,225,181.13
递延所得税资产			
其他非流动资产		237,677,279.12	98,975,192.62
非流动资产合计		1,614,855,617.76	1,392,330,060.73
资产总计		4,196,560,492.58	3,956,558,708.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		423,039,053.70	217,024,388.97
预收款项			
合同负债		282,959,596.44	174,385,433.46
应付职工薪酬		74,674,101.04	61,878,156.12
应交税费		6,179,501.71	4,813,190.46
其他应付款		64,653,447.13	12,413,325.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		280,112,627.35	91,351,174.76
其他流动负债		22,452,514.95	6,555,796.41
流动负债合计		1,154,070,842.32	568,421,465.83
非流动负债：			
长期借款		597,023,193.35	359,441,281.37
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,794,258.24	4,001,738.77
长期应付款		6,360,705.80	3,386,801.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	33,219,216.00
非流动负债合计		620,178,157.39	400,049,037.38
负债合计		1,774,248,999.71	968,470,503.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,355,082.00	499,911,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,555,634,776.53	2,531,057,033.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-633,678,365.66	-42,880,059.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,422,311,492.87	2,988,088,205.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,196,560,492.58	3,956,558,708.79

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		2,321,885,572.72	2,337,996,408.69
其中：营业收入	七、61	2,321,885,572.72	2,337,996,408.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,899,365,903.54	2,474,485,649.45
其中：营业成本	七、61	1,396,323,107.77	1,291,724,278.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	6,397,399.29	6,126,804.59
销售费用	七、63	119,983,461.86	114,853,388.02
管理费用	七、64	122,283,801.14	119,446,242.40
研发费用	七、65	1,247,302,342.65	947,223,117.16
财务费用	七、66	7,075,790.83	-4,888,181.11
其中：利息费用		36,166,177.60	23,178,777.62
利息收入		15,826,902.53	11,885,814.13
加：其他收益	七、67	40,643,186.73	45,930,046.89
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	-529,301.75	-30,511,591.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,686,105.12	-32,757,234.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、70	-365,610.93	-20,544,818.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-38,904,022.35	-109,601,138.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,469,543.81	-19,421,516.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	796.50	-80,364.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		-583,104,826.43	-270,718,624.08
加：营业外收入	七、74	1,231,175.07	1,524,696.45
减：营业外支出	七、75	9,063.39	29,674.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-581,882,714.75	-269,223,602.01
减：所得税费用	七、76	18,996,643.75	27,243,122.16
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-600,879,358.50	-296,466,724.17
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-600,879,358.50	-296,466,724.17
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-600,879,358.50	-296,466,724.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-2,118,180.52	-569,370.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-2,118,180.52	-569,370.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	七、77	-2,118,180.52	-569,370.47
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-602,997,539.02	-297,036,094.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-602,997,539.02	-297,036,094.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	二十、2	-1.20	-0.59
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、2	-1.20	-0.59

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	1,458,606,275.25	1,629,620,357.27
减：营业成本	十九、4	897,614,938.74	889,871,015.21
税金及附加		836,339.50	886,707.80
销售费用		56,482,315.92	40,058,618.37
管理费用		64,561,835.70	56,925,820.06
研发费用		1,009,778,848.60	674,004,321.07
财务费用		-4,213,091.79	-16,037,427.38
其中：利息费用		20,372,641.10	7,274,915.95
利息收入		11,602,490.90	9,485,999.22
加：其他收益		21,787,661.80	19,142,942.10

投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	-1,705,568.32	-32,060,490.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,686,105.12	-32,757,234.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-410,113.41	-20,631,902.09
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-34,841,281.04	-50,957,973.20
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-4,767,001.78	-16,425,672.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	3,352.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-586,391,214.17	-117,018,442.59
加：营业外收入		18,550.00	123,191.50
减：营业外支出		4,556.45	233.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-586,377,220.62	-116,895,484.80
减：所得税费用		4,421,085.54	7,080,855.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-590,798,306.16	-123,976,340.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-590,798,306.16	-123,976,340.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			

六、综合收益总额		-590,798,306.16	-123,976,340.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,353,442,588.77	2,353,726,324.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,852,994.22	41,495,180.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	76,487,291.84	56,531,183.06
经营活动现金流入小计		2,438,782,874.83	2,451,752,687.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,211,879,955.14	1,047,524,172.65
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,291,371,298.96	1,159,656,218.23

支付的各项税费		50,793,991.67	54,956,159.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	230,727,838.39	198,140,030.76
经营活动现金流出小计		2,784,773,084.16	2,460,276,581.44
经营活动产生的现金流量净额		-345,990,209.33	-8,523,893.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,156,803.37	2,245,642.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		796.50	1,309.82
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,954,000,000.00	430,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,959,157,599.87	432,246,952.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	143,631,984.87	115,442,995.45
投资支付的现金	七、78	3,000,000.00	13,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,766,000,000.00	730,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,912,631,984.87	858,442,995.45
投资活动产生的现金流量净额		46,525,615.00	-426,196,042.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,100,138.91	83,643,896.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		496,200,000.00	427,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		513,300,138.91	511,543,896.87
偿还债务支付的现金		133,909,434.73	40,083,305.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	131,258,774.30	114,879,359.93
筹资活动现金流出小计		265,168,209.03	154,962,664.95
筹资活动产生的现金流量净额		248,131,929.88	356,581,231.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,915,481.51	1,506,936.82
五、现金及现金等价物净增加额		-42,417,182.94	-76,631,767.64
加：期初现金及现金等价物余额		685,252,510.99	761,884,278.63

额			
六、期末现金及现金等价物余额		642,835,328.05	685,252,510.99

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,481,903,268.55	1,366,722,448.44
收到的税费返还		0.00	93,960.66
收到其他与经营活动有关的现金		50,744,401.61	26,184,584.73
经营活动现金流入小计		1,532,647,670.16	1,393,000,993.83
购买商品、接受劳务支付的现金		680,689,854.88	778,348,795.37
支付给职工及为职工支付的现金		482,265,230.61	428,360,655.99
支付的各项税费		862,016.70	1,469,186.91
支付其他与经营活动有关的现金		663,614,400.49	456,383,550.20
经营活动现金流出小计		1,827,431,502.68	1,664,562,188.47
经营活动产生的现金流量净额		-294,783,832.52	-271,561,194.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,980,536.80	696,743.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	3,589.02
收到其他与投资活动有关的现金		1,510,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,513,980,536.80	100,700,332.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,800,833.62	79,288,115.27
投资支付的现金		3,000,000.00	13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,390,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,519,800,833.62	392,288,115.27
投资活动产生的现金流量净额		-5,820,296.82	-291,587,782.91
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		17,100,138.91	83,643,896.87
取得借款收到的现金		496,200,000.00	427,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		513,300,138.91	511,543,896.87
偿还债务支付的现金		88,088,097.74	16,065,587.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		39,778,113.31	45,981,878.81
筹资活动现金流出小计		127,866,211.05	62,047,466.35
筹资活动产生的现金流量净额		385,433,927.86	449,496,430.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		290,584.89	1,066,373.03
五、现金及现金等价物净增加额		85,120,383.41	-112,586,174.00
加：期初现金及现金等价物余额		395,772,586.93	508,358,760.93
六、期末现金及现金等价物余额		480,892,970.34	395,772,586.93

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	499,911,232.00				4,065,238,348.28		-49,398,266.27				-1,815,457,693.28		2,700,293,620.73		2,700,293,620.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	499,911,232.00				4,065,238,348.28		-49,398,266.27				-1,815,457,693.28		2,700,293,620.73		2,700,293,620.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	443,850.00				24,577,743.45		-2,118,180.52				-600,879,358.50		-577,975,945.57		-577,975,945.57
（一）							-2,118,180.52				-600,879,358.50		-602,997,539.02		-602,997,539.02

综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本	443,850.00				24,577,743.45								25,021,593.45		25,021,593.45
1. 所有者投入的普通股	443,850.00				36,534,963.72								36,978,813.72		36,978,813.72
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-12,587,070.32								-12,587,070.32		-12,587,070.32
4. 其他					629,850.05								629,850.05		629,850.05
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

4. 其他															
（四）所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）															
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
（五） 专项储 备															
1. 本期 提取															
2. 本期															

使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	500,355,082.00				4,089,816,091.73		-51,516,446.79				-2,416,337,051.78		2,122,317,675.16	2,122,317,675.16

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	497,750,682.00				3,977,289,554.48		-48,828,895.80				-1,518,990,969.11		2,907,220,371.57		2,907,220,371.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	497,750,682.00				3,977,289,554.48		-48,828,895.80				-1,518,990,969.11		2,907,220,371.57		2,907,220,371.57
三、本期增减变动金额（减	2,160,550.00				87,948,793.80		-569,370.47				-296,466,724.17		-206,926,750.84		-206,926,750.84

少以 “一”号 填列)														
(一) 综合收 益总额						-569,370.47				-296,466,724.17		-297,036,094.64		-297,036,094.64
(二) 所有者 投入和 减少资 本	2,160,550.00				87,948,793.80							90,109,343.80		90,109,343.80
1. 所有 者投入 的普通 股	2,160,550.00				159,568,374.86							161,728,924.86		161,728,924.86
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					-74,437,280.11							-74,437,280.11		-74,437,280.11
4. 其他					2,817,699.05							2,817,699.05		2,817,699.05
(三) 利润分 配														
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所														

有者 （或股 东）的 分配															
4. 其他															
（四） 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）															
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
（五） 专项储															

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	499,911,232.00				4,065,238,348.28		-49,398,266.27				-1,815,457,693.28		2,700,293,620.73	2,700,293,620.73

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

母公司所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	499,911,232.00				2,531,057,033.08					-42,880,059.50	2,988,088,205.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	499,911,232.00				2,531,057,033.08					-42,880,059.50	2,988,088,205.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	443,850.00				24,577,743.45					-590,798,306.16	-565,776,712.71
（一）综合收益总额										-590,798,306.16	-590,798,306.16
（二）所有者投入和减少资本	443,850.00				24,577,743.45						25,021,593.45
1. 所有者投入的普通股	443,850.00				36,534,963.72						36,978,813.72
2. 其他权益工具持有											

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-12,587,070.32						-12,587,070.32
4. 其他					629,850.05						629,850.05
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	500,355,082.00				2,555,634,776.53					-633,678,365.66	2,422,311,492.87

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	497,750,682.00				2,443,108,239.28					81,096,280.83	3,021,955,202.11
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	497,750,682.00				2,443,108,239.28					81,096,280.83	3,021,955,202.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,160,550.00				87,948,793.80					-123,976,340.33	-33,866,996.53
（一）综合收益总额										-123,976,340.33	-123,976,340.33
（二）所有者投入和减少资本	2,160,550.00				87,948,793.80						90,109,343.80
1. 所有者投入的普通股	2,160,550.00				159,568,374.86						161,728,924.86
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-74,437,280.11						-74,437,280.11
4. 其他					2,817,699.05						2,817,699.05
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	499,911,232.00				2,531,057,033.08					-42,880,059.50	2,988,088,205.58

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：沙乐

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”或“芯原上海”), 原名为思略微电子(上海)有限公司。思略微电子(上海)有限公司系由美国思略科技有限公司于 2001 年 8 月 21 日投资设立的有限责任公司(外国法人独资), 中华人民共和国外商投资企业批准证书编号为商外资沪张独资字(2001)1512 号。本公司于 2001 年 8 月 21 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 310115400082864(浦东)企业法人营业执照。2002 年 7 月, 母公司变更为开曼群岛设立的 VeriSilicon Holdings Co., Ltd (以下简称“VeriSilicon Cayman”)并更名为芯原微电子(上海)股份有限公司。2016 年 7 月份本公司再次发生股权变更, 母公司由 VeriSilicon Cayman 变更为 VeriSilicon Limited, 并于 2016 年 8 月取得统一社会信用代码为 91310115703490552J 的企业法人营业执照。本公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A, 法定代表人为戴伟民先生, 注册资本为美元 9,500,000.00 元, 实收资本为美元 9,500,000.00 元, 经营期限为 30 年。截至 2024 年 12 月 31 日, 本公司注册资本变更为人民币 500,355,082.00 元, 累计实收股本为人民币 500,355,082.00 元。芯原上海、VeriSilicon Cayman 以及其所属子公司合称为芯原集团或本集团。

根据本公司于 2019 年 8 月 20 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议, 并于 2020 年 7 月 22 日取得中国证监会同意注册(证监许可【2020】1537 号)文件。本公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板首发上市, 公开发行 4,831.9289 万股人民币普通股股票, 本公司变更注册资本为人民币 483,192,883.00 元。本次发行价格为每股人民币 38.53 元, 募集资金总额为人民币 1,861,742,205.17 元, 扣除本次发行费用后, 增加股本人民币 48,319,289.00 元, 增加资本公积人民币 1,625,707,530.43 元。

本公司实际控制人情况详见第十节、十四、1。

本集团实际从事的主要经营活动为集成电路的设计、调试、维护, 为集成电路制造和设计厂商提供建模和建库服务, 转让自有研发成果, 并提供相关技术咨询和技术服务, 非居住房地产租赁。

本集团合并财务报表范围参见第十节、十、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2024 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

☐ 适用 ☒ 不适用

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

6.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关的管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

7.1 控制的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

7.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，

视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团未发生共同经营的情形。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定方法参见附注二中记账基础和计价原则的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照

收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

11.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和其他应收款。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

11.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资

产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。除上述情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确认利息收入。

11.1.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

11.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、其他非流动资产和合同资产等项目以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据和合同资产等项目，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

11.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为

已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

11.2.3 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产和租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

11.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

11.3 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

11.3.1 金融负债的分类、确认及计量

本集团金融负债初始确认时全部划分为以摊余成本计量的金融负债，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

11.3.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

11.3.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团基于信用风险特征将应收票据划分为不同组合：

组合类别	确定依据
组合 1	承兑人为信用评级较高的银行的应收票据。

组合 2	承兑人为信用评级较低的银行的应收票据。
组合 3	国内企业承兑的应收票据

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团以共同风险特征为依据将应收账款分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将应收账款划分为不同组合：

组合类别	确定依据
R1	中国大陆大客户
R2	美国大客户
R3	中国台湾大客户
R4	欧洲大客户
R5	东亚大客户
R6	所有中小客户
R7	集团内关联方
R8	高风险客户

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的应收账款因信用风险显著不同而单项评估信用风险。

14、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将其他应收款划分为不同组合：

组合类别	确定依据
正常	信用风险自初始确认后并未显著增加
关注	信用风险自初始确认后已显著增加
损失	已发生信用减值

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

16.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在产品和产成品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

16.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

16.3 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用
合同资产的确认方法及标准
☒适用 ☐不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
☒适用 ☐不适用

本集团以共同风险特征为依据将合同资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将合同资产划分为不同组合：

组合类别	确定依据
R1	中国大陆大客户
R2	美国大客户
R3	中国台湾大客户
R4	欧洲大客户
R5	东亚大客户
R6	所有中小客户
R7	集团内关联方
R8	高风险客户

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
☒适用 ☐不适用

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的合同资产因信用风险显著不同而单项评估信用风险。

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐ 适用 ☒ 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

19.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他一方共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

19.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

19.3 后续计量及损益确认方法

19.3.1 按成本法核算的长期股权投资

本公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

19.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法
不适用。

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~44	-	2.27~5
电子设备、机器设备	年限平均法	2~10	-	10~50
器具及家具	年限平均法	2~5	-	20~50

22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、无形资产或长期待摊费用。各类在建工程结转为固定资产、无形资产以及长期待摊费用的标准和时点如下：

类别	结转为固定资产、无形资产或长期待摊费用的标准和时点
软件安装	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
装修工程	初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准

23、借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

24、生物资产

□适用 √不适用

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

无形资产包括非专利技术、第三方授权许可、客户关系、专利权、软件使用权、商标和内部开发技术。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内除客户关系采用双倍余额递减法之外其余采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。除了商标外，其他无形资产均系使用寿命有限的无形资产，其预计使用寿命及残值明细如下：

类别	摊销年限(年)及确定依据	残值率(%)
非专利技术	15，根据预期受益年限确定	-
第三方授权许可	1~10，根据合同约定期限确定	-
客户关系	12~15，根据预期受益年限确定	-
软件使用权	1~10，根据合同约定期限确定	-
专利权	5~20，根据专利权有效期限确定	-
内部开发技术	2~5，根据预期受益年限确定	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将无法预见该资产为集团带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限，综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为本集团带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，由管理层进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括直接从事研发活动人员的工资薪金和福利费用、折旧及摊销费用、使用权资产摊销费用、通讯费用、研发项目外部服务费用等。本集团以验证测试通过，生成测试报告作为划分研究阶段和开发阶段的具体标准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产、长期待摊费用是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法划分到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组，如包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出等。长期待摊费用按预计使用寿命以及合同期限并考虑续租期限后孰短进行摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集

团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐适用 ☒不适用

31、预计负债

☒适用 ☐不适用

当与亏损合同、未决诉讼等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、股份支付

☒适用 ☐不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

32.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

32.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不

利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

业务类型	业务内容
芯片量产业务收入	系本集团芯片产品销售而取得的收入。
芯片设计业务收入	系本集团根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产芯片样片(即样片流片)，最终将经过公司技术人员验证过的样片及相关技术信息交付给客户而取得的收入。
知识产权授权使用费收入	系本集团向客户提供一次性或者多次授权使用本集团的知识产权产生的收入。
特许权使用费收入	系客户使用本集团的知识产权授权生产及销售产品，按规定费率支付使用费产生的收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于知识产权授权使用费收入，尽管部分业务合同中约定了验收条款，但因本集团在相关产品以电子方式被放置于本集团加密的FTP(文件传输协议)服务器中以供客户下载且密钥以电子方式发送给客户时，已将商品的控制权转移给客户，对其并无继续管理权及实施有效控制的能力，且相关经济利益很可能流入企业，因此在该时点按照相关合同或协议约定的金额确认收入。

对于特许权使用费收入，当本集团每季度从被许可方收到生产量及销量报告，且相关经济利益很可能流入企业时，按照合同或协议规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

对于芯片设计服务收入，因其满足本集团所产出的商品具有不可替代的用途且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，故在一段时间内确认收入，采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

客户额外购买选择权包括针对未来商品或服务的其他折扣等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：(一)本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；(二)本集团能够主导第三方代表本企业向客户提供服务；(三)本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让

给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，本集团没有仅局限于合同的法律形式，而是综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：(一)本集团承担向客户转让商品的主要责任；(二)本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；(三)本集团有权自主决定所交易商品的价格；(四)其他相关事实和情况。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、合同成本

☒适用 ☐不适用

35.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

35.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

35.3 与合同成本有关的资产的减值损失

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项

差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

36.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分摊计入当期损益。

36.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，与本集团日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间，冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对房屋和机器设备等短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以

外的其他租赁为经营租赁。

1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

2 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

38.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

38.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对

于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

38.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部分别于 2023 年 10 月 25 日和 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》。	无	-

其他说明

经评估，本集团认为采用上述规定对本集团财务报表并无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。	6%(适用现代服务业下的研发和技术服务)以及 13%(产品销售)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	已缴流转税额	1%或 7%
企业所得税	应纳税所得额，应纳税所得额系按有关税法规定对本年税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以法定税率计算。	0%~43%
教育费附加/地方教育费附加	已缴流转税额	3%/2%/1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
芯原微电子(上海)股份有限公司	15%
芯原微电子(北京)有限公司(“芯原北京”)	20%
芯原微电子(成都)有限公司(“芯原成都”)	15%
图芯芯片技术(上海)有限公司(“图芯上海”)	20%
VeriSilicon Cayman	0%
芯原电子股份有限公司(“芯原台湾”)（注 2）	不适用
VeriSilicon (Hong Kong) Limited.(“VeriSilicon Hong Kong”)	16.5%
VeriSilicon Kabushiki Kaisha (“VeriSilicon Japan”)	43%
VeriSilicon, Inc. (注 1)	8.84%/21%
VeriSilicon EURL	26.50%
Vivante Corporation(“Vivante US”) (注 1)	8.84%/21%
芯原微电子(南京)有限公司(“芯原南京”)	15%
芯原微电子(海南)有限公司(“芯原海南”)	15%

VeriSilicon Microelectronics (Hong Kong) Limited	16.5%
(“芯原微电子香港”)	15%
芯原科技(上海)有限公司(“芯原科技”)(附注五、2)	20%

注 1: VeriSilicon, Inc.以及 Vivante US 使用美国的联邦税以及州税，税率分别为 21%和 8.84%。

注 2: 芯原台湾的清算程序，于 2021 年 12 月 6 日经台湾士林地方法院准予备查清算完结并于 2024 年完成银行账户注销，不再适用。

2、税收优惠

√适用 □不适用

芯原上海根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于 2020 年 11 月 18 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202031005701)，被认定为高新技术企业，自 2021 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。芯原上海于 2023 年 12 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202331004387)，有效期 3 年。

芯原上海、芯原成都、芯原南京及芯原海南根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税[2023]17 号)，芯原上海及芯原成都自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，芯原南京及芯原海南自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额的 15%，计提当期加计抵减额。

芯原南京根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2022 年 12 月 12 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202232015872)，被认定为高新技术企业，自 2022 年 12 月 12 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。

芯原北京根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第 8 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

图芯上海根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(2021 年第 8 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但

不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。芯原成都由成都高新技术产业开发区国家税务局认定为西部地区鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局制印《关于明确增值税减免增值税等政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 1 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，芯原北京及芯原海南按照当期可抵扣进项税额加 5%，抵减应纳税额。

由于芯原海南 2022 年度平均资产超过 5000 万元，年度应纳税所得额超过 300 万元，不再符合小微企业的定义，因此自 2022 年起至 2024 年，根据财税[2020]31 号《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，芯原海南属于注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，可减按 15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》(财税〔2020〕38 号)、《中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》(沪财发〔2020〕12 号)和《关于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区重点产业企业实质性生产或研发活动有关问题的公告》(2023 年第 1 号)有关要求，芯原科技由上海市经济和信息化委员会认定为临港新片区 2023 年第二批重点产业企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日减按 15%的税率征收企业所得税。

芯原海南根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局于 2024 年 12 月 3 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR20244600027)，被认定为高新技术企业，自 2024 年 12 月 3 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,461.49	61,504.46

银行存款	642,779,866.56	685,191,006.53
其他货币资金	104,101,257.58	3,527,493.61
存放财务公司存款		
合计	746,936,585.63	688,780,004.60
其中：存放在境外的 款项总额	124,899,655.62	195,067,771.47

其他说明

上述其他货币资金系被冻结的、待购买结构性存款的货币资金，海关进口关税、信用证保证金及受限制的政府补助款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,275,721.57	400,130,371.00	/
其中：			
结构性存款	30,051,000.00	400,130,371.00	/
理财产品	82,224,721.57		/
合计	112,275,721.57	400,130,371.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,073,245.63	41,621,784.69
商业承兑票据	14,189,457.58	20,996,236.04
合计	20,262,703.21	62,618,020.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	20,270,298.45	100.00	7,595.24	0.04	20,262,703.21	62,638,096.23	100.00	20,075.50	0.03	62,618,020.73
其中：										
组合1	6,075,052.69	29.97	1,807.06	0.03	6,073,245.63	40,403,927.86	64.50	11,243.73	0.03	40,392,684.13
组合2	-		-	-	-	1,230,151.00	1.96	1,050.44	0.09	1,229,100.56
组合3	14,195,245.76	70.03	5,788.18	0.04	14,189,457.58	21,004,017.37	33.53	7,781.33	0.04	20,996,236.04
合计	20,270,298.45	/	7,595.24	/	20,262,703.21	62,638,096.23	/	20,075.50	/	62,618,020.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
组合 1	6,075,052.69	1,807.06	0.03%
组合 2	-	-	-
组合 3	14,195,245.76	5,788.18	0.04%
合计	20,270,298.45	7,595.24	0.04%

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对应收票据进行内部风险等级评估，并基于信用风险特征将其分为 3 种风险等级，包括承兑人为信用评级较高的银行的应收票据(组合 1)、承兑人为信用评级较低的银行的应收票据(组合 2)、国内企业承兑的应收票据(组合 3)确定各组合应收票据的预期损失率。于 2024 年 12 月 31 日，本集团基于减值矩阵确认应收票据的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2024 年 12 月 31 日	未发生信用减值	已发生信用减值	总计
预计信用损失率	0.04%	-	0.04%
账面余额	20,270,298.45	-	20,270,298.45
减：预期信用损失准备	7,595.24	-	7,595.24
账面价值	20,262,703.21	-	20,262,703.21

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	20,075.50	7,595.24	20,075.50			7,595.24
合计	20,075.50	7,595.24	20,075.50			7,595.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
小于 6 个月	822,992,378.07	910,453,839.99
6 个月至 1 年	13,552,961.17	133,436,270.34
1 年以内小计	836,545,339.24	1,043,890,110.33
1 至 2 年	178,147,449.36	76,849,922.42
2 至 3 年	62,991,090.13	55,464,748.14
3 年以上		
3 至 4 年	55,236,349.69	2,833,080.00
4 至 5 年	2,875,360.00	714,482.72
5 年以上	3,735,639.99	2,990,342.78
合计	1,139,531,228.41	1,182,742,686.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账	111,073,202.03	9.75	111,073,202.03	100.00	-	91,763,304.21	7.76	91,763,304.21	100.00	-

准备										
其中：										
单项计提	111,073,202.03	9.75	111,073,202.03	100.00	-	91,763,304.21	7.76	91,763,304.21	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,028,458,026.38	90.25	85,298,649.58	8.29	943,159,376.80	1,090,979,382.18	92.24	69,340,132.54	6.36	1,021,639,249.64
其中：										
R1	645,245,595.34	56.62	20,392,165.89	3.16	624,853,429.45	745,982,214.43	63.07	18,447,466.40	2.47	727,534,748.03
R2	206,182,316.00	18.09	506,843.25	0.25	205,675,472.75	194,367,938.36	16.43	455,191.38	0.23	193,912,746.98
R3	35,476,572.67	3.11	319,383.12	0.90	35,157,189.55	11,257,927.14	0.95	36,767.60	0.33	11,221,159.54
R4	13,558,771.22	1.19	61,815.55	0.46	13,496,955.67	15,443,284.25	1.31	37,971.67	0.25	15,405,312.58
R5	1,656,622.82	0.15	12,275.77	0.74	1,644,347.05	24,545,051.31	2.08	70,590.97	0.29	24,474,460.34
R6	5,134,184.97	0.45	3,048,793.37	59.38	2,085,391.60	2,797,378.78	0.24	1,820,235.49	65.07	977,143.29
R8	121,203,963.36	10.64	60,957,372.63	50.29	60,246,590.73	96,585,587.91	8.17	48,471,909.03	50.19	48,113,678.88
合计	1,139,531,228.41	100.00	196,371,851.61	/	943,159,376.80	1,182,742,686.39	100.00	161,103,436.75	/	1,021,639,249.64

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款单项计提坏账准备	111,073,202.03	111,073,202.03	100.00	集团认为存在重大财务困难的客户相应的应收账款以及存在重大逾期的应收账款已发生信用减值，并单项计提了减值准备。
合计	111,073,202.03	111,073,202.03	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：应收账款组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
R1	645,245,595.34	20,392,165.89	3.16
R2	206,182,316.00	506,843.25	0.25
R3	35,476,572.67	319,383.12	0.90
R4	13,558,771.22	61,815.55	0.46
R5	1,656,622.82	12,275.77	0.74
R6	5,134,184.97	3,048,793.37	59.38
R8	121,203,963.36	60,957,372.63	50.29
合计	1,028,458,026.38	85,298,649.58	8.29

按组合计提坏账准备的说明：
☒适用 ☐不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)确定各评级应收账款的预期损失率。本集团基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期预期 信用损失(未发 生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生 信用减值)	合计数
2023 年 12 月 31 日	19,047,988.02	142,055,448.73	161,103,436.75
本年转入已发生信用减值	(835,813.35)	835,813.35	-
本年计提预期信用损失	3,080,002.27	33,145,224.19	36,225,226.46
本年转回预期信用损失	-	(1,873,428.77)	(1,873,428.77)
汇率变动的影响	306.64	916,310.53	916,617.17
2024 年 12 月 31 日	21,292,483.58	175,079,368.03	196,371,851.61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	161,103,436.75	36,225,226.46	1,873,428.77		916,617.17	196,371,851.61
合计	161,103,436.75	36,225,226.46	1,873,428.77		916,617.17	196,371,851.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额	应收账款和合同资产、其他非流动资产-应收知识产权授权费期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	89,521,494.75	17,970,281.21	33,916,609.76	141,408,385.72	9.01	4,550,711.89
客户二	61,789,973.95	12,832,533.13	49,008,606.40	123,631,113.48	7.88	3,978,615.38
客户三	59,551,694.52	23,923,773.35	-	83,475,467.87	5.32	41,815,630.79
客户四	77,491,603.05	-	-	77,491,603.05	4.94	190,492.07

四						
客	36,344,849.20	-	39,198,500.00	75,543,349.20	4.82	2,431,086.50
户						
五						
合	324,699,615.47	54,726,587.69	122,123,716.16	501,549,919.32	31.97	52,966,536.63
计						

其他说明
无。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	272,119,332.50	26,958,402.12	245,160,930.38	118,214,182.21	22,235,100.63	95,979,081.58
合计	272,119,332.50	26,958,402.12	245,160,930.38	118,214,182.21	22,235,100.63	95,979,081.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账	5,122,951.87	1.88	5,122,951.87	100.00	-	5,122,951.87	4.33	5,122,951.87	100.00	-

账准备										
其中：										
单项计提	5,122,951.87	1.88	5,122,951.87	100.00	-	5,122,951.87	4.33	5,122,951.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	266,996,380.63	98.12	21,835,450.25	8.18	245,160,930.38	113,091,230.34	95.67	17,112,148.76	15.13	95,979,081.58
其中：										
R1	206,225,268.35	75.78	6,276,565.67	3.04	199,948,702.68	67,619,988.80	57.20	1,612,739.13	2.39	66,007,249.67
R2	25,643,063.44	9.42	63,036.51	0.25	25,580,026.93	7,987,754.04	6.76	25,559.74	0.32	7,962,194.30
R3	3,889,512.49	1.43	35,015.91	0.90	3,854,496.58	458,155.46	0.39	1,496.30	0.33	456,659.16
R4	1,046,495.39	0.38	4,771.06	0.46	1,041,724.34	6,833,291.08	5.78	16,292.49	0.24	6,816,998.59
R8	30,192,040.96	11.10	15,456,061.10	51.19	14,735,979.86	30,192,040.96	25.54	15,456,061.10	51.19	14,735,979.86
合计	272,119,332.50	/	26,958,402.12	/	245,160,930.38	118,214,182.21	/	22,235,100.63	/	95,979,081.58

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合同资产单项计提坏账准备	5,122,951.87	5,122,951.87	100	集团认为存在重大财务困难的客户相应的合同资产以及存在重大逾期的合同资产已发生信用减值，并单项计提了减值准备。

合计	5,122,951.87	5,122,951.87	100	/
----	--------------	--------------	-----	---

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：合同资产组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
R1	206,225,268.35	6,276,565.67	3.04
R2	25,643,063.44	63,036.51	0.25
R3	3,889,512.49	35,015.91	0.90
R4	1,046,495.39	4,771.06	0.46
R8	30,192,040.96	15,456,061.10	51.19
合计	266,996,380.63	21,835,450.25	8.18

按组合计提坏账准备的说明
☒适用 ☐不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)确定各评级合同资产的预期损失率。本集团基于减值矩阵确认合同资产的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计数
2024 年 1 月 1 日余额	1,656,087.66	20,579,012.97	22,235,100.63
本年计提预期信用损失	4,722,675.65	-	4,722,675.65
汇率变动的影响	625.84	-	625.84
2024 年 12 月 31 日	6,379,389.15	20,579,012.97	26,958,402.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		

合同资产 坏账准备	22,235,100.63	4,722,675.65			625.84	26,958,402.12	
合计	22,235,100.63	4,722,675.65			625.84	26,958,402.12	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无。

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	52,438,100.90	81.34	18,587,322.29	79.31
1 至 2 年	4,750.00	0.01	3,853,394.72	16.44
2 至 3 年	3,296,502.33	5.11	979,398.59	4.18
3 年以上	8,725,302.49	13.54	16,644.35	0.07
合计	64,464,655.72	100.00	23,436,759.95	100.00

单位：元 币种：人民币

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于 2024 年 12 月 31 日本集团预付款项中账龄超过一年的主要款项是由于预定产能而向采购供应商支付的预付款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	12,387,108.39	19.22
第二名	11,082,526.53	17.19
第三名	8,612,838.53	13.36
第四名	3,296,000.00	5.11
第五名	3,143,296.00	4.88
合计	38,521,769.45	59.76

其他说明：
无。

其他说明
□ 适用 √ 不适用

9、 其他应收款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,587,995.67	4,843,578.97
合计	1,587,995.67	4,843,578.97

其他说明：
□ 适用 √ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□ 适用 √ 不适用

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□ 适用 √ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无。

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(11). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无。

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
小于 6 个月	277,644.00	444,109.05
6 个月至 1 年	1,751.00	3,232,761.14
1 年以内小计	279,395.00	3,676,870.19
1 至 2 年	212,170.75	190,610.56
2 至 3 年	180,627.92	330,311.03
3 年以上		
3 至 4 年	74,145.00	56,033.98
4 至 5 年	56,934.36	-
5 年以上	919,504.72	911,670.96
合计	1,722,777.75	5,165,496.72

(14). 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金、备用金及暂支款	842,509.65	694,290.41
应收采购返利折让款	814,985.35	803,001.61
代客户支付的特许权使用费	-	3,073,636.36
其他	65,282.75	594,568.34
合计	1,722,777.75	5,165,496.72

(15). 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	未来 12 个月内 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值)	合计数
2024 年 1 月 1 日余额	192,459.79	129,457.96	-	321,917.75
本年计提	8,031.94	750.24	-	8,782.18
本年转回	(166,114.09)	(31,310.18)	-	(197,424.27)
汇率变动的影响	-	1,506.42	-	1,506.42
2024 年 12 月 31 日余额	34,377.64	100,404.44	-	134,782.08

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	321,917.75	8,782.18	197,424.27		1,506.42	134,782.08
合计	321,917.75	8,782.18	197,424.27		1,506.42	134,782.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	814,985.35	47.31	应收采购返利折让款	大于 5 年	100,404.43
第二名	90,043.99	5.23	应收押金、备用金及暂支款	小于 6 个月	4,429.47
第三名	89,159.94	5.18	应收押金、备用金及暂支款	1 至 2 年	4,385.98
第四名	81,824.00	4.75	应收押金、备用金及暂支款	2 至 4 年	4,025.11

第五名	75,000.00	4.35	应收押金、 备用金及暂 支款	小于 6 个月	33.26
合计	1,151,013.28	66.82	/	/	113,278.25

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品	360,667,283.42	4,631,737.39	356,035,546.03	263,882,933.59	4,155,887.54	259,727,046.05
库存商品	40,133,126.04	653,871.52	39,479,254.52	19,342,435.98	446,798.15	18,895,637.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合 计	400,800,409.4 6	5,285,608.9 1	395,514,800.5 5	283,225,369.5 7	4,602,685.6 9	278,622,683.8 8

(2). 确认为存货的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	4,155,887.54	2,869,944.23	67,877.59	2,461,971.97		4,631,737.39
库存商品	446,798.15	264,476.25	2,078.39	59,481.27		653,871.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,602,685.69	3,134,420.48	69,955.98	2,521,453.24		5,285,608.91

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

闲置库存报废。

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

11、 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付短期租赁费	7,531.36	431,206.99
待摊费用	22,262,068.60	10,866,570.72
待抵扣增值税进项税	78,189,107.95	20,242,036.44
预缴税金	4,186,209.47	4,109,530.28
知识产权授权采购额度	-	104,482,368.38
预付再融资发行相关费用	4,188,303.42	1,762,611.88
合计	108,833,220.80	141,894,324.69

其他说明
无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
芯思 原微 电子 有 限公 司	5,056, 691.2 8	-		-5,686 ,541.3 3		629,8 50.05		-		-	-
上海 芯展 科技 有限 公司	-	1,000, 000.0 0		436.2 1		-		-		1,000, 436.2 1	-
小计	5,056, 691.2 8	1,000, 000.0 0		-5,686 ,105.1 2		629,8 50.05		-		1,000, 436.2 1	-
合计	5,056, 691.2 8	1,000, 000.0 0		-5,686 ,105.1 2		629,8 50.05		-		1,000, 436.2 1	-

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

2018年9月，本公司以现金方式认缴人民币5,600万元，与新思投资(中国)有限公司、上海吉麦企业管理中心(有限合伙)、西藏长乐投资有限公司共同成立芯思原微电子有限公司(以下简称“芯思原”)。芯思原注册地在合肥市高新区，法定代表人为戴伟民，注册资本为人民币一亿元。本公司分别于2018年9月和2019年3月支付认缴资本人民币600万元和5,000万元。截至2022年12月31日持股比例为56%。

2023年5月，芯思原签署增资协议，其中嘉兴芯谷投资合伙企业(有限合伙)新增认缴注册资本人民币333.33万元，合肥市天使投资基金有限公司新增认缴注册资本人民币333.33万元，共青城如愿投资合伙企业(有限合伙)新增认缴注册资本人民币2,666.67万元，三名股东共计新增认缴注册资本人民币3,333.33万元。增资后，本公司对芯思原的持股比例被稀释至42%，并相应调整长期股权投资的账面价值人民币2,581,865.46元。2024年12月，芯思原因实施股权激励确认股份支付费用及相应资本公积，本公司按照持股比例计算应享有的份额，并相应调整长期股权投资的账面价值人民币629,850.05元（2023年股权激励调整长期股权投资人民币235,833.59元）。截至2024年12月31日，芯思原董事会席位共五名，其中本公司占两席。对于公司主要经营事项的决策，需要由董事会全体董事过半数通过，本公司对其有重大影响，因此芯思原为本公司的联营企业并采用权益法核算。

2024年9月，本公司以现金方式认缴人民币100万元，与上海孚腾私募基金管理有限公司、上海临港科创投资管理有限公司、上海华虹投资发展有限公司、长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司、上海兆芯集成电路股份有限公司、西藏远识创业投资管理有限公司共同成立上海芯展科技有限公司(以下简称“芯展科技”)。芯展科技注册地在上海市普陀区，法定代表人为毕尚禹，注册资本为人民币1,000万元。本公司于2024年11月支付认缴资本人民币100万元。截至2024年12月31日持股比例为10%。芯展科技股权分布松散，董事会席位共七名，其中本公司占一席。对于公司主要经营事项的决策，需要由董事会全体董事过半数通过，本公司对其有重大影响，因此芯展科技为本公司的联营企业并采用权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	201,122,863.23	199,633,824.73
合计	201,122,863.23	199,633,824.73

其他说明：

√适用 □不适用

本集团将持股比例低，无重大影响的非上市公司股权投资以公允价值计量且其变动计入当期损益。上述股权投资预期持有超过一年，列示于其他非流动金融资产。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,825,971.90	505,111,613.96
固定资产清理		
合计	720,825,971.90	505,111,613.96

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	器具及家具	电子设备、机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	471,153,689.85	19,423,604.53	167,483,812.62	658,061,107.00
2.本期增加金额	205,478,264.64	3,959,384.51	46,824,465.60	256,262,114.75
(1) 购置	205,478,264.64	2,330,182.17	45,953,612.67	253,762,059.48
(2) 在建工程转入		1,580,071.07	755,125.93	2,335,197.00
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动的影响		49,131.27	115,727.00	164,858.27
3.本期减少金额		239,572.67	184,021.45	423,594.12
(1) 处置或报废		239,572.67	184,021.45	423,594.12
4.期末余额	676,631,954.49	23,143,416.37	214,124,256.77	913,899,627.63
二、累计折旧				
1.期初余额	17,019,072.89	12,317,032.31	123,613,387.84	152,949,493.04
2.本期增加金额	14,701,656.18	2,800,731.34	23,045,069.88	40,547,457.40
(1) 计提	14,701,656.18	2,754,742.46	22,944,049.65	40,400,448.29
(2) 汇率变动的影响		45,988.88	101,020.23	147,009.11
3.本期减少金额		239,273.26	184,021.45	423,294.71
(1) 处置或报废		239,273.26	184,021.45	423,294.71
4.期末余额	31,720,729.07	14,878,490.39	146,474,436.27	193,073,655.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	644,911,225.42	8,264,925.98	67,649,820.50	720,825,971.90
2.期初账面价值	454,134,616.96	7,106,572.22	43,870,424.78	505,111,613.96

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
临港研发中心部分房产	326,029,127.55

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	153,397.98	6,470,170.79
工程物资		
合计	153,397.98	6,470,170.79

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件安装	-	-	-	3,267,547.18	-	3,267,547.18
装修工程	153,397.98	-	153,397.98	3,202,623.61	-	3,202,623.61
合计	153,397.98	-	153,397.98	6,470,170.79	-	6,470,170.79

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
软件安装	4,837,000.00	3,267,547.18			3,267,547.18		100.00	已完工				自有资金
装修工程	19,500,000.00	3,202,623.61	6,513,333.43	2,335,197.00	7,227,362.06	153,397.98	68.96	进行中				自有资金
合计	24,337,000.00	6,470,170.79	6,513,333.43	2,335,197.00	10,494,909.24	153,397.98	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□ 适用 √ 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无。

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	电子设备、机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	101,039,886.47	2,138,493.26	103,178,379.73
2.本期增加金额	74,818,187.43		74,818,187.43
(1)增加	74,559,091.04		74,559,091.04
(2)汇率变动的影响	259,096.39		259,096.39
3.本期减少金额	48,156,312.47	710,789.09	48,867,101.56
(1)减少	48,156,312.47	710,789.09	48,867,101.56
4.期末余额	127,701,761.43	1,427,704.17	129,129,465.60
二、累计折旧			
1.期初余额	57,939,059.69	1,351,974.83	59,291,034.52
2.本期增加金额	39,307,320.16	428,977.45	39,736,297.61
(1)计提	39,191,983.46	428,977.45	39,620,960.91
(2)汇率变动的影响	115,336.70		115,336.70
3.本期减少金额	47,752,330.10	705,283.42	48,457,613.52
(1)处置	47,752,330.10	705,283.42	48,457,613.52

4.期末余额	49,494,049.75	1,075,668.86	50,569,718.61
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	78,207,711.68	352,035.31	78,559,746.99
2.期初账面价值	43,100,826.78	786,518.43	43,887,345.21

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

本集团租赁了多项资产，主要为办公室及设备租赁，租赁期为 3-5 年，本年计算等增量借款利率的加权平均值为 4.13%。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,578,400.24 元。低价值资产租赁费用为人民币 80,919.87 元。

本年度与租赁相关的总现金流出为人民币 43,083,888.50 元。

于 2024 年 12 月 31 日，本集团的短期租赁组合与上述租赁费对应的短期租赁相类似。

截至 2024 年 12 月 31 日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。

于 2024 年 12 月 31 日，本集团无尚未达到租赁期开始日的租赁。

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利	第三方	客户关	软件使	专利权	商标	内部开	合计
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

	技术	授权许可	系	用权			发技术	
一、账面原值								
1.期初余额	41,189,750.34	157,079,693.20	70,617,550.00	228,618,184.67	131,694,636.89	35,017,778.07	202,630,521.85	866,848,115.02
2.本期增加金额	354,095.00	69,022,910.12	929,763.28	207,321,909.05	1,989,012.90	423,623.44	-	280,041,313.79
1)购置		68,113,633.40		203,952,649.67				272,066,283.07
2)在建工程转入				3,267,547.18				3,267,547.18
(3)汇率变动的影响	354,095.00	909,276.72	929,763.28	101,712.20	1,989,012.90	423,623.44		4,707,483.54
3.本期减少金额				121,443,923.58				121,443,923.58
(1)处置				121,443,923.58				121,443,923.58
4.期末余额	41,543,845.34	226,102,603.32	71,547,313.28	314,496,170.14	133,683,649.79	35,441,401.51	202,630,521.85	1,025,445,505.23
二、累计摊销								
1.期初余额	30,148,752.02	106,364,815.41	65,421,041.00	147,458,010.97	81,164,902.82		39,753,418.16	470,310,940.38
2.本期增加金额	1,794,259.98	12,180,115.83	2,666,666.57	88,868,047.97	12,050,071.90	0.00	35,503,921.29	153,063,083.54
(1)计提	1,587,419.81	11,745,954.93	1,794,121.85	88,776,523.25	10,650,006.88		35,503,921.29	150,057,948.01
(2)汇率变动的影响	206,840.17	434,160.90	872,544.72	91,524.72	1,400,065.02			3,005,135.53
3.本期减				121,443,923.58				121,443,923.58

少金 额								
(1) 处置				121,443, 923.58				121,443,9 23.58
4.期 末余 额	31,943,0 12.00	118,544, 931.24	68,087,7 07.57	114,882, 135.36	93,214,9 74.72		75,257,3 39.45	501,930,1 00.34
三、减值准备								
1.期 初余 额								
2.本 期增 加金 额								
(1) 计提								
3.本 期减 少金 额								
(1)处 置								
4.期 末余 额								
四、账面价值								
1.期 末账 面价 值	9,600,83 3.34	107,557, 672.08	3,459,60 5.71	199,614, 034.78	40,468,6 75.07	35,441,4 01.51	127,373, 182.40	523,515,4 04.89
2.期 初账 面价 值	11,040,9 98.32	50,714,8 77.79	5,196,50 9.00	81,160,1 73.70	50,529,7 34.07	35,017,7 78.07	162,877, 103.69	396,537,1 74.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是24.33

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

使用寿命不确定的商标，每年均进行减值测试。商标的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的未来 5 年的财务预算确定，2024 年 12 月 31 日减值测试时采用 18.00%折现率 (2023 年：17.00%)，超过 5 年的现金流量按照递增的增长率 2.00% (2023 年：3.00%)为基础计算。该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键参数还有：基于该商标过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利。公司管理层认为上述关键参数发生的任何合理变化均不会导致商标的账面价值合计超过其可收回金额，故未计提任何减值准备。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置		
众华收购——芯片设计业务	2,981,092.50	-	-			2,981,092.50
Vivante 收购——图形处理器业务	176,064,651.66	-	2,627,533.80			178,692,185.46

合计	179,045,74 4.16	-	2,627,533. 80			181,673,2 77.96
----	--------------------	---	------------------	--	--	--------------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
众华收购——芯片 设计业务		0.00		0.00		0.00
Vivante 收购—— 图形处理器业务						
合计		0.00		0.00		0.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合 的构成及依据	所属经营分部及依 据	是否与以前年度保持一致
图形处理器业务—— 资产组 A	根据收购时产生商 誉的业务资产将其 分配至相关资产 组，资产组中包含 固定资产、无形资 产等	图形处理器业务	是
芯片设计业务——资 产组 B	根据收购时产生商 誉的业务资产将其 分配至相关资产 组，资产组中包含 固定资产、无形资 产等	芯片设计业务	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

为减值测试的目的，本集团根据收购时产生商誉的业务资产将其分配至相关资产组，其中收购上海众华电子有限公司时产生商誉的资产组为芯片设计业务的资产组，收购 Vivante US 公司时产生商誉的资产组为图形处理器业务的资产组。

分配到各资产组的商誉的账面价值如下：

	账面价值
2024 年 12 月 31 日	
图形处理器业务——资产组 A	178,692,185.46
芯片设计业务——资产组 B	2,981,092.50

合计	181,673,277.96
----	----------------

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
图形处理器业务——资产组 A	603,940,614.40	5 年	收入增长率 毛利率 折现率：18.50% (2023 年：17.00%)	收入增长率和毛利率：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预计估计预计销售额和毛利 折现率：基于资本资产定价模型	现金流量增长率：2.00% (2023 年：2.00%) 折现率：18.50% (2023 年：17.00%)	现金流量增长率：基于相关行业的长期平均增长率 折现率：基于资本资产定价模型
芯片设计业务——资产组 B	545,053,241.60	5 年	收入增长率 毛利率 折现率：18.50% (2023 年：17.00%)	收入增长率和毛利率：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预计估计预计销售额和毛利	现金流量增长率：2.00% (2023 年：2.00%) 折现率：18.50% (2023 年：17.00%)	现金流量增长率：基于相关行业的长期平均增长率 折现率：基于资本资产定价模型

				折现率： 基于资 本资产 定价模 型		
合计	1,148,993,856.00	/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	31,095,376.07	9,651,181.21	9,762,063.38		30,984,493.90
合计	31,095,376.07	9,651,181.21	9,762,063.38		30,984,493.90

其他说明：

无。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	4,527,081.98	984,538.35	5,243,965.88	1,146,379.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	62,572,294.07	13,608,064.37	60,465,885.66	13,218,405.41
预提费用	4,498,585.31	978,340.96	2,151,126.33	470,256.24
递延收益	4,732,564.01	1,029,226.06	8,663,921.49	1,894,013.88
租赁负债	12,981,205.02	2,823,119.66	12,708,491.61	2,778,194.55
其他	3,671,575.18	798,484.89	4,036,551.96	882,427.84
合计	92,983,305.57	20,221,774.29	93,269,942.93	20,389,677.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制企业合并资产公允价值调整	83,446,566.46	18,147,748.37	82,821,716.51	18,105,598.12
使用权资产	9,536,739.11	2,074,025.92	10,448,226.42	2,284,079.55
合计	92,983,305.57	20,221,774.29	93,269,942.93	20,389,677.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	20,221,774.29	0.00	20,389,677.67	0.00
递延所得税负债	20,221,774.29	0.00	20,389,677.67	0.00

(4). 未确认递延所得税资产明细

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,284,336,670.06	1,027,047,901.69
可抵扣亏损	2,615,236,229.47	1,426,530,921.34
合计	3,899,572,899.53	2,453,578,823.03

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	2,944,826.93	2,944,826.93	
2026	2,187,852.57	36,120,503.92	
2027	14,606,141.73	14,606,141.73	
2028	19,795,512.88	19,795,512.88	
2029	106,154,683.96	104,530,522.11	
2030 及以后	2,462,944,187.45	1,238,081,619.58	
无限期(注)	4,203,023.95	10,451,794.19	
合计	2,612,836,229.47	1,426,530,921.34	/

其他说明：

√适用 □不适用

根据本集团部分境外子公司所在国家地区的税法规定，企业可抵扣亏损没有抵扣时效，可以无限期抵扣。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租赁合同押金	11,934,223.25	587,071.47	11,347,151.78	11,819,592.24	576,846.43	11,242,745.81
预付房产购置款（注1）	-			217,216,633.30		217,216,633.30
预付无形资产采购款（注2）	90,000,000.00		90,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
预付基板材料采购款	-			33,139,580.43		33,139,580.43
应收	157,223,703.77	4,743,121.97	152,480,581.80			

知识产权授权费						
合计	259,157,927.02	5,330,193.44	253,827,733.58	322,175,805.97	576,846.43	321,598,959.54

其他说明：

注 1：所购置的房产系上海市木荷路 515 弄公共租赁住房，已于 2024 年 3 月交付转入固定资产。

注 2：本集团与某芯片设计公司签订了知识产权许可协议，该笔款项为此协议约定的预付采购款。根据合同规定，该知识产权授权许可预计于 2025 年分批交付。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	104,101,257.58	104,101,257.58	冻结	海关进口关税、信用证保证金、结构性存款扣款	3,527,493.61	3,527,493.61	冻结	海关进口关税、信用证保证金、政府补助专项资金
固定资产	634,873,096.59	634,873,096.59			443,448,866.91	443,448,866.91	抵押	长期借款抵押
合计	738,974,354.17	738,974,354.17	/	/	446,976,360.52	446,976,360.52	/	/

其他说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，该固定资产用于抵押长期借款人民币 299,894,568.00 元，详见第十

节，七、45。

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

☐ 适用 ☒ 不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	163,165,886.05	96,068,423.33
合计	163,165,886.05	96,068,423.33

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未实现收入及预收货款	606,777,460.39	453,522,036.80
合计	606,777,460.39	453,522,036.80

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	155,229,865.09	1,196,391,389.4	1,167,891,172.7	183,730,081.86

		8	1	
二、离职后福利-设定提存计划	5,923,510.98	98,197,594.14	97,109,804.15	7,011,300.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利		29,851,696.84	29,851,696.84	
合计	161,153,376.07	1,324,440,680.46	1,294,852,673.70	190,741,382.83

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	148,564,448.15	1,052,877,674.33	1,025,662,778.75	175,779,343.73
二、职工福利费				
三、社会保险费	3,646,655.13	75,003,003.37	74,285,274.70	4,364,383.80
其中：医疗保险费	3,589,017.12	73,025,707.92	72,360,370.72	4,254,354.32
工伤保险费	57,638.01	1,511,388.50	1,458,997.03	110,029.48
生育保险费	-	465,906.95	465,906.95	-
四、住房公积金	2,537,742.81	55,950,665.82	55,476,281.39	3,012,127.24
五、工会经费和职工教育经费	481,019.00	12,560,045.96	12,466,837.87	574,227.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	155,229,865.09	1,196,391,389.48	1,167,891,172.71	183,730,081.86

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,744,010.64	95,020,858.42	93,966,031.76	6,798,837.30
2、失业保险费	179,500.34	3,176,735.72	3,143,772.39	212,463.67
3、企业年金缴费				
合计	5,923,510.98	98,197,594.14	97,109,804.15	7,011,300.97

其他说明：

√适用 □不适用

设定提存计划：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按各公司所在地当地政策按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 95,020,858.42 元及人民币 3,176,735.72 元(2023 年：人民币 75,478,405.25 元及人民币 2,519,784.10 元)。于 2024 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 6,798,837.30 元及 212,463.67 元(2023 年 12 月 31 日：人民币 5,744,010.64 元及 179,500.34 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,309,725.64	4,046,073.33
消费税		
营业税		
企业所得税	7,478,804.10	3,285,929.76
个人所得税	10,972,180.35	10,393,548.40
城市维护建设税		
其他	13,657,396.06	9,051,932.91
合计	37,418,106.15	26,777,484.40

其他说明：
无。

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,335,178.31	27,711,609.92
合计	81,335,178.31	27,711,609.92

其他说明：
√适用 □不适用
无。

(2). 应付利息

分类列示
□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

分类列示

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购置固定资产款	9,925,433.61	5,574,476.29
应付购置无形资产款	48,173,190.24	3,405,696.06
代收代付的人才奖励补贴	100,000.00	552,903.00
专业服务费	8,942,250.03	9,540,822.80
应付保证金	1,595,813.17	1,902,535.93
应付网络设备费	4,506,145.28	1,452,245.29
其他	8,092,345.98	5,282,930.55
合计	81,335,178.31	27,711,609.92

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	311,693,951.87	94,753,625.44
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	37,350,881.35	20,392,750.41
1 年内到期的应付无形资产采购款项	85,448,309.12	52,064,741.70

合计	434,493,142.34	167,211,117.55

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待执行的亏损合同	11,164,253.99	11,805,305.09
员工赔偿	1,559,493.53	1,628,619.14
政府补助	20,584,353.19	4,117,784.29
合计	33,308,100.71	17,551,708.52

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

涉及政府补助的项目：

项目	2024 年 1 月 1 日	本年新增 补助金额	本年冲减 成本费用金额	2024 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
图像处理器开发项目	1,285,714.29	-	1,285,714.29	-	与资产相关
促进高质量发展项目	382,070.00	-	82,070.00	300,000.00	与收益相关
软件集成电路财政奖励	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	与收益相关
某芯片的设计与流片验证项目	-	3,643,600.00	1,409,100.00	2,234,500.00	与收益相关
2024 年图像信号处理器 IP 核项目	-	3,290,000.00	257,393.14	3,032,606.86	与收益相关
2024 年基于 RISC-V 的 SOC 芯片项目	-	15,280,000.00	2,662,753.67	12,617,246.33	与收益相关
2024 年 GPU-IP 核项目	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	与资产相关
产教融合示范项目	2,450,000.00	-	2,450,000.00	-	与收益相关
合计	4,117,784.29	25,663,600.00	9,197,031.10	20,584,353.19	

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	300,184,559.36	336,558,162.33
信用借款	844,062,058.27	417,806,806.20
减：一年内到期的长期借款	-311,693,951.87	-94,753,625.44
合计	832,552,665.76	659,611,343.09

长期借款分类的说明：

无。

其他说明

√适用 □不适用

2024 年 12 月 31 日，保证借款系由本集团母公司或第三方提供担保；抵押借款系芯原科技持有的创晶科技中心 T1 塔楼 4~15 层及上海市木荷路 515 弄公共租赁住房作抵押，其中公共租赁住房抵押尚未办妥。

2024 年 12 月 31 日，本集团未满足部分借款合同中约定的财务指标要求，该事项构成本集团未能履行相关借款协议的约定条款，并触发银行借款合同中的违约条款(以下简称“违约事项”)。该违约事项导致相关银行及其他金融机构有权要求本集团提前偿还相关借款全部本金及利息。该借款本金及利息于 2024 年 12 月 31 日余额共计人民币 77,474,497.50 元，其中包括一年内到期的长期借款本息合计人民币 17,216,555.00 元和原合同约定到期日为 2025 年 12 月 31 日之后的长期借款本息合计人民币 60,257,942.50 元。该长期借款本息合计人民币 60,257,942.50 元已在本年度财务报表中列示为一年内到期的非流动负债。

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

转股权会计处理及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	81,878,865.46	42,658,823.19
减：计入一年内到期的非流动负债	37,350,881.35	20,392,750.41
合计	44,527,984.11	22,266,072.78

其他说明：

无。

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	83,221,735.16	40,994,966.23
专项应付款		
合计	83,221,735.16	40,994,966.23

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付无形资产采购款（注 1）	160,323,148.34	85,431,046.07
减：一年内到期的应付无形资产采购款	85,448,309.12	52,064,741.70
小计	74,874,839.22	33,366,304.37
其他	8,346,895.94	7,628,661.86
合计	83,221,735.16	40,994,966.23

其他说明：

注 1： 为公司分期付款购买的软件使用权需要支付的款项，一年内到期需支付的部分计入一年内到期的非流动负债。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	-	33,219,216.00
合计	-	33,219,216.00

其他说明：

无。

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	499,911,232.00	443,850.00				443,850.00	500,355,082.00

其他说明：

根据 2020 年 12 月 25 日董事会审议通过 2020 年限制性股票激励计划(“2020 限制性股票计划”),截至 2024 年 12 月 31 日,本公司实际行权增加的投资款人民币 17,101,540.50 元。行权后增加股本人民币 443,850.00 元,增加资本公积人民币 16,657,690.50 元。

本年发生部分有限售条件流通股转换为无限售条件流通股共计 9,650,142 股,为限售股到期解禁。

54、 其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,983,825,207.76	36,534,963.72	-	4,020,360,171.48
其他资本公积	81,413,140.52	7,920,052.95	19,877,273.22	69,455,920.25
合计	4,065,238,348.28	44,455,016.67	19,877,273.22	4,089,816,091.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

所有者投入资本本年增加系投资者投入的资本人民币 36,534,963.72 元，均为限制性股票员工行权导致资本溢价。其中，员工行权的投资款增加资本公积人民币 16,657,690.50 元，以及员工行权对应其他资本公积转入资本溢价人民币 19,877,273.22 元。

以权益结算的股份支付本年增加系权益结算的股份支付在等待期内摊销导致，其中人民币 7,290,202.90 元计入资本公积。

其他本年增加系本年联营企业芯思原实施股权激励确认股份支付费用及相应资本公积，对公司资本公积的影响金额为人民币 629,850.05 元。

本年减少主要系员工行权对应其他资本公积转入资本溢价人民币 19,877,273.22 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险								

公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-49,398,266.27	-2,118,180.52				-2,118,180.52		-51,516,446.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外	-49,398,266.27	-2,118,180.52				-2,118,180.52		-51,516,446.79

币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-49,398,266.27	-2,118,180.52				-2,118,180.52		-51,516,446.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☐适用 ☒不适用

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,815,457,693.28	-1,518,990,969.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,815,457,693.28	-1,518,990,969.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-600,879,358.50	-296,466,724.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,416,337,051.78	-1,815,457,693.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,316,975,603.43	1,387,595,934.80	2,328,953,201.99	1,281,645,809.85
其他业务	4,909,969.29	8,727,172.97	9,043,206.70	10,078,468.54
合计	2,321,885,572.72	1,396,323,107.77	2,337,996,408.69	1,291,724,278.39

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	232,188.56		233,799.64	
营业收入扣除项目合计金额	491.00	出租固定资产	904.32	出租固定资产
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.21	/	0.39	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	491.00		904.32	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	491.00		904.32	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				

2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	231,697.56		232,895.32	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
芯片量产业务收入	856,213,206.26	691,003,928.10
芯片设计业务收入	724,793,989.62	631,496,440.32
知识产权授权使用费收入	632,859,199.20	65,095,566.38
特许权使用费收入	103,109,208.35	-
其他业务	4,909,969.29	8,727,172.97
合计	2,321,885,572.72	1,396,323,107.77

其他说明

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
芯片量产业务收入	根据合同约定的交付条款在交货时或签收时履行履约义务	根据具体合同约定	货物	是	0.00	产品质量保证
芯片设计业务收入	在某一时段内履行履约义务	根据具体合同约定	服务	是	0.00	无
知识产权授权使用费收入	在交付知识产权授权使用许可产品时履行履约义务	根据具体合同约定	知识产权使用许可	是	0.00	无
特许权使用费收入	在客户使用行为实际发生时履行履约义务	根据具体合同约定	版税	是	0.00	无
合计	/	/	/	/	0.00	/

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为24.06亿元。

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,105,505.36	2,392,383.35
教育费附加	902,359.54	1,025,307.14
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税及其他	2,787,961.43	2,025,576.08
地方教育费附加	601,572.96	683,538.02
合计	6,397,399.29	6,126,804.59

其他说明：

无。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	83,531,166.56	80,286,845.08
会议和市场费用	17,142,414.41	14,797,357.42
专业服务费	5,219,547.78	5,399,725.90
差旅交通费用	5,183,585.69	5,734,505.34
租赁及物业费用	1,422,976.83	1,354,298.30
办公费	1,687,778.66	1,929,790.75
股份支付费用	121,255.37	-871,104.19
折旧及摊销费用	808,267.88	795,296.12
使用权资产摊销	3,280,723.21	3,509,869.69
其他费用	1,585,745.47	1,916,803.61
合计	119,983,461.86	114,853,388.02

其他说明：

无。

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	82,744,416.79	82,711,971.32
咨询费	6,721,225.93	2,010,725.53
法律服务费	4,300,789.13	9,203,070.22
审计费	4,252,514.11	4,411,015.57
税务咨询费	2,472,318.56	2,868,478.25
差旅交通费用	3,107,057.36	3,466,266.94
通讯及办公费用	7,140,121.32	6,046,732.34
租赁及物业费用	835,678.43	620,061.95
股份支付费用	1,851,606.91	-498,685.92
折旧及摊销费用	3,422,368.98	3,683,191.23
使用权资产摊销	3,283,869.70	2,856,123.40
其他费用	2,151,833.92	2,067,291.57
合计	122,283,801.14	119,446,242.40

其他说明：

本集团的管理费用中包括本集团聘任的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(“德勤华永”)收取的财务报表和内部控制审计费用人民币 3,000,000.00 元，以及德勤华永及其网络成员所收取的非鉴证服务费用人民币 2,316,754.05 元。

65、 研发费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	893,998,489.04	711,480,321.68
折旧及摊销费用	170,132,007.73	125,540,410.95
使用权资产摊销	31,326,786.58	28,298,784.99
通讯费用	40,148,960.62	20,365,300.37
研发项目外部服务费用	14,478,070.19	17,140,175.58
办公及会务费用	18,612,250.68	14,275,795.36
差旅交通费用	6,533,912.12	9,449,623.83
租赁及物业费用	4,285,739.55	4,631,144.04
股份支付费用	4,366,272.04	4,322,372.28
测试费用	54,989,748.69	3,723,389.18
其他费用	8,430,105.41	7,995,798.90
合计	1,247,302,342.65	947,223,117.16

其他说明：

无。

66、 财务费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,166,177.60	23,178,777.62
减：利息收入	15,826,902.53	11,885,814.13

金融机构手续费	309,498.18	299,543.54
汇兑收益	-13,572,982.42	-16,480,688.14
合计	7,075,790.83	-4,888,181.11

其他说明：

其中本年度租赁负债的利息费用为人民币 3,090,380.81 元。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	6,917,953.54	8,961,655.00
南京江北新区产业扶持项目 补贴	10,000,000.00	10,000,000.00
南京江北新区促进集成电路 产业高质量发展补贴	-	8,000,000.00
其他	23,725,233.19	18,968,391.89
合计	40,643,186.73	45,930,046.89

其他说明：

政府补助主要系本集团收到的补贴款等。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,686,105.12	-32,757,234.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息 收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,156,803.37	2,245,642.71
处置其他权益工具投资取得的投资收 益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-529,301.75	-30,511,591.59

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	145,350.57	-252,259.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-510,961.50	-20,292,559.62
合计	-365,610.93	-20,544,818.76

其他说明：

无。

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	12,480.26	1,081.86
应收账款坏账损失	-34,351,797.69	-109,404,079.13
其他应收款坏账损失	188,642.09	-115,261.56
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
其他非流动资产信用减值损失	-4,753,347.01	-82,879.94
合计	-38,904,022.35	-109,601,138.77

其他说明：

无。

72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-4,722,675.65	-15,873,462.39
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,746,868.16	-3,548,054.02
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,469,543.81	-19,421,516.41

其他说明：

无。

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	796.50	-80,364.68
合计	796.50	-80,364.68

其他说明：

无。

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金/保险赔款收入	1,153,000.00	1,383,000.00	1,153,000.00
其他	78,175.07	141,696.45	78,175.07
合计	1,231,175.07	1,524,696.45	1,231,175.07

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	299.41	10,024.07	299.41
其中：固定资产处置损失	299.41	10,024.07	299.41
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金等其他支出	8,763.98	19,650.31	8,763.98
合计	9,063.39	29,674.38	9,063.39

其他说明：

无。

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,367,917.61	26,084,947.68
递延所得税费用		
汇算清缴差异	-371,273.86	1,158,174.48
合计	18,996,643.75	27,243,122.16

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-581,882,714.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	-87,282,407.21
子公司适用不同税率的影响	-19,107,057.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-24,542,626.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,678,608.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,253,392.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	224,792,504.25
股权激励行权的纳税影响	132,762.10

研发费用加计扣除的纳税影响	-75,557,922.56
汇算清缴差异	-371,273.86
调整以前期间的可抵扣亏损	-4,888,732.89
境外源泉扣缴所得税费用	12,396,182.95
所得税费用	18,996,643.75

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,826,902.53	11,885,814.13
政府补助补贴	59,388,833.19	43,018,391.89
收到员工行权个人所得税款	40,381.05	102,280.59
其他	1,231,175.07	1,524,696.45
合计	76,487,291.84	56,531,183.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	309,498.18	299,543.54
业务招待费	2,798,721.60	3,552,944.12
租赁费	6,544,394.81	2,344,331.05
测试费	54,989,748.69	3,723,389.18
通讯费	40,816,373.48	21,666,155.15
差旅和交通费	14,824,555.17	18,650,396.11
专业服务费及会议费用等	80,339,251.57	68,684,236.06
返还保证金	212,500.41	35,094,177.15
代为支付上年的员工行权个税	2,898,490.47	4,868,599.30
其他	26,994,304.01	39,256,259.10
合计	230,727,838.39	198,140,030.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	5,156,803.37	2,245,642.71
合计	5,156,803.37	2,245,642.71

收到的重要的投资活动有关的现金无。

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,631,984.87	115,442,995.45
投资支付的现金	3,000,000.00	13,000,000.00
合计	146,631,984.87	128,442,995.45

支付的重要的投资活动有关的现金无。

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品及结构性存款收到的现金	1,954,000,000.00	430,000,000.00
合计	1,954,000,000.00	430,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品及结构性存款支付的现金	1,766,000,000.00	730,000,000.00
合计	1,766,000,000.00	730,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
采购无形资产分期付款支付额	90,654,773.49	73,956,317.55
支付租赁费用	38,178,309.27	40,923,042.38
支付再融资发行相关费用	2,425,691.54	-
合计	131,258,774.30	114,879,359.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
长期借款（含一年内到期）	754,364,968.53	496,200,000.00	28,591,083.83	134,909,434.73		1,144,246,617.63
长期应付款（含一年内到期）	93,059,707.93		160,235,663.12	90,654,773.49	-6,029,446.72	168,670,044.28
租赁负债（含一年内）	42,658,823.19		77,398,351.54	38,178,309.27		81,878,865.46

到期)						
合计	890,083,499.65	496,200,000.00	266,225,098.49	263,742,517.49	-6,029,446.72	1,394,795,527.37

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-600,879,358.50	-296,466,724.17
加：资产减值准备	6,469,543.81	19,421,516.41
信用减值损失	38,904,022.35	109,601,138.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,400,448.29	34,108,649.48
使用权资产摊销	39,620,960.91	36,077,180.90
无形资产摊销	150,057,948.01	109,498,617.69
长期待摊费用摊销	9,762,063.38	6,304,214.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-796.50	80,364.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	299.41	10,024.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	365,610.93	20,544,818.76
财务费用（收益以“－”号填列）	28,333,746.97	16,329,718.35
股份支付费用	7,290,202.90	3,605,474.75
投资损失（收益以“－”号填列）	529,301.75	30,511,591.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-118,638,984.83	140,332,013.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-195,266,750.20	7,962,614.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	247,061,531.99	-246,445,106.75
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-345,990,209.33	-8,523,893.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
债务购置长期资产	169,249,376.82	74,308,914.28
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	642,835,328.05	685,252,510.99
减: 现金的期初余额	685,252,510.99	761,884,278.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-42,417,182.94	-76,631,767.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	642,835,328.05	685,252,510.99
其中: 库存现金	55,461.49	61,504.46
可随时用于支付的银行存款	642,779,866.56	685,191,006.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	642,835,328.05	685,252,510.99
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	104,101,257.58	3,527,493.61	海关进口关税、信用证保证金、结构性存款扣款
合计	104,101,257.58	3,527,493.61	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	266,344,659.19
其中：美元	35,626,665.30	7.1884	256,098,720.84
欧元	19,895.85	7.5257	149,730.34
港币	10,504,023.32	0.9260	9,726,726.81
人民币	369,481.20	1.0000	369,481.20
应收账款	-	-	4,165,371.72
其中：美元	579,457.42	7.1884	4,165,371.72
应付账款	-	-	682,898.00
其中：美元	95,000.00	7.1884	682,898.00
其他应付款	-	-	1,170,586.44
其中：美元	162,843.81	7.1884	1,170,586.44
一年内到期的非流动负债	-	-	53,723,381.39
其中：美元	7,473,621.58	7.1884	53,723,381.39
长期应付款	-	-	34,176,376.24
其中：美元	4,754,378.75	7.1884	34,176,376.24

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
VeriSilicon Cayman	开曼	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
芯原台湾(注)	中国台湾	新台币	不适用
VeriSilicon HongKong	中国香港	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSilicon Japan	日本	日元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSilicon, Inc.	美国	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSilicon EURL	法国	欧元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
Vivante US	美国	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
芯原微电子香港	中国香港	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
Verisilicon Vietnam	越南	越南盾	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币

注：芯原台湾的清算程序，于 2021 年 12 月 6 日经台湾士林地方法院准予备查清算完结。其与本公司的往来款已于 2024 年结算完毕。

82、 租赁

(1) 作为承租人

√ 适用 □ 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□ 适用 √ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√ 适用 □ 不适用

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,578,400.24 元。低价值资产租赁费用为人民币 80,919.87 元。

售后租回交易及判断依据

□ 适用 √ 不适用

与租赁相关的现金流出总额43,083,888.50(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变 租赁付款额相关的收入
临港研发中心部分房产	4,909,969.29	-
合计	4,909,969.29	-

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	3,921,672.73	2,532,497.13
第二年	1,376,822.89	1,264,245.86
第三年	164,264.01	-
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额	5,462,759.63	3,796,742.99

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

83、 数据资源☐适用 ☒不适用**84、 其他**☐适用 ☒不适用**八、研发支出****1、 按费用性质列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	893,998,489.04	718,165,297.03
折旧及摊销费用	170,132,007.73	125,540,410.95
使用权资产摊销	31,326,786.58	28,298,784.99
通讯费用	40,148,960.62	20,365,300.37

研发项目外部服务费用	14,478,070.19	17,140,175.58
办公及会务费用	18,612,250.68	14,275,795.36
差旅交通费用	6,533,912.12	9,449,623.83
租赁及物业费用	4,285,739.55	4,631,144.04
股份支付费用	4,366,272.04	4,322,372.28
测试费用	54,989,748.69	4,210,090.94
其他费用	8,430,105.41	7,995,798.90
合计	1,247,302,342.65	954,394,794.27
其中：费用化研发支出	1,247,302,342.65	947,223,117.16
资本化研发支出	0.00	7,171,677.11

其他说明：

无。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

2024年9月18日,本集团子公司 VeriSilicon Hong Kong 新设立全资子公司 VeriSilicon Vietnam，注册资本越南盾 1,256,000,000.00，本集团持股 100%。

2021年12月6日，芯原台湾的清算程序于经台湾士林地方法院准予备查清算完结。2024年自本集团子公司芯原台湾银行账户注销后，不再纳入合并范围。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
芯原北京	北京	人民币 4,928,974.00 元	北京	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
芯原成都	成都	人民币 20,000,000.00 元	成都	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
图芯上海	上海	人民币 1,515,180.00 元	上海	集成电路行业	100%		非同一控制下企业合并
VeriSilicon Cayman	开曼	美元 50,000.00	开曼	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
芯原台湾	中国台湾	新台币 1,070,000.00	中国台湾	集成电路行业	不适用	不适用	不适用
VeriSilicon Hong Kong	中国香港	港币 200,000.00	中国香港	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon Japan	日本	日元 10,000,000.00	日本	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon,Inc.	美国	不适用	美国	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon EURL	法国	欧元 2,000.00	法国	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
Vivante US	美国	不适用	美国	集成电路行业		100%	非同一控制下企业合并
芯原南京	南京	人民币 100,000,000.00 元	南京	集成电路行业	100%		设立
芯原海南	海南	人民币 50,000,000.00 元	海南	集成电路行业	100%		设立
芯原微电子香港	中国香港	港币 1.00	中国香港	集成电路行业		100%	设立
芯原科技	上海	人民币 500,000,000.00 元	上海	集成电路行业	100%		设立
VeriSilicon Vietnam	越南	越南盾 1,256,000,000.00	越南	集成电路行业		100%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

芯原台湾的清算程序，于 2021 年 12 月 6 日经台湾士林地方法院准予备查清算完结。其与本公司的往来款已于 2024 年结算完毕。

VeriSilicon Vietnam 设立于 2024 年 9 月 18 日，本集团持股比例 100%。 主要经营范围为集成电路的设计。

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芯思原微电子有限公司	合肥	合肥	集成电路行业	42%		权益法
上海芯展科技有限公司	上海	上海	集成电路行业	10%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	芯思原	芯展科技	芯思原
流动资产	18,335,881.97	10,004,591.64	55,121,423.12
非流动资产	8,944,818.68	-	16,490,186.88
资产合计	27,280,700.65	10,004,591.64	71,611,610.00
流动负债	57,670,114.69	229.58	53,156,780.90
非流动负债	1,618,420.45	-	4,461,285.15
负债合计	59,288,535.14	229.58	57,618,066.05
少数股东权益			
归属于母公司股东权益			
按持股比例计算的净资产份额		1,000,436.21	5,877,288.46
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			-820,597.18
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值		1,000,436.21	5,056,691.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			

营业收入	19,765,065.61	-	39,919,485.79
净利润	-47,501,021.42	4,362.06	-71,156,039.79
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-47,501,021.42	4,362.06	-71,156,039.79
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
芯思原	-	14,263,887.67	14,263,887.67

其他说明
无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0.00（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
图像处理器开发项目	1,285,714.29	-			1,285,714.29	-	与资产相关
促进高质量发展项目	382,070.00	-			82,070.00	300,000.00	与收益相关
软件集成电路财政奖励	-	1,050,000.00			1,050,000.00	-	与收益相关
某芯片的设计与流片验证项目	-	3,643,600.00			1,409,100.00	2,234,500.00	与收益相关
2024 年图像信号处理器 IP 核 项目	-	3,290,000.00			257,393.14	3,032,606.86	与收益相关
2024 基于 RISC-V 的 SOC 芯片项目	-	15,280,000.00			2,662,753.67	12,617,246.33	与收益相关
2024GPU-IP 核项目	-	2,400,000.00			-	2,400,000.00	与资产相关

产教融合示范项目	2,450,000.00	-			2,450,000.00	-	与收益相关
合计	4,117,784.29	25,663,600.00			9,197,031.10	20,584,353.19	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
南京江北新区产业扶持项目补贴	10,000,000.00	10,000,000.00
南京江北新区促进集成电路产业高质量发展补贴	-	8,000,000.00
其他	23,725,233.19	18,968,391.89
合计	33,725,233.19	36,968,391.89

其他说明：
无。

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使所有者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元，欧元有关。本集团的主要采购和销售以人民币计价结算。于 2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为美元、欧元及港币余额外，本集团的资产及负债主要以各主体的记账本位币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
美元余额		
货币资金	256,098,720.84	219,334,296.61
应收账款	4,165,371.72	1,897,780.65
应付账款	(682,898.00)	(1,607,772.90)
其他应付款	(1,170,586.44)	(1,542.68)
一年内到期的非流动负债	(53,723,381.39)	(38,186,886.29)
长期应付款	(34,176,376.24)	(19,064,698.46)
合计净头寸	170,510,850.49	162,371,176.93

人民币元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
欧元余额		
货币资金	149,730.34	156,365.33
其他应付款	-	(471,549.83)
合计净头寸	149,730.34	(315,184.50)

人民币元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
港币余额		
货币资金	9,726,726.81	732,865.47
其他应付款	-	(119,573.16)
合计净头寸	9,726,726.81	613,292.31

人民币元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
人民币余额		
货币资金	369,481.20	129,349.91

本集团密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本集团目前并未采用任何措施规避外汇风险

汇率敏感性分析

敏感性分析包括外部的应收款项，未包括对本集团境外子公司的应收款项。假设在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当年损益和所有者权益的税前影响如下：

人民币千元

项目	汇率变动	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		对利润总额的影响	对所有者权益的影响	对利润总额的影响	对所有者权益的影响

美元	对人民币升值 5%	8,525.54	8,525.54	8,118.56	8,118.56
美元	对人民币贬值 5%	(8,525.54)	(8,525.54)	(8,118.56)	(8,118.56)
欧元	对人民币升值 5%	7.49	7.49	(15.76)	(15.76)
欧元	对人民币贬值 5%	(7.49)	(7.49)	15.76	15.76
港币	对人民币升值 5%	486.34	486.34	30.66	30.66
港币	对人民币贬值 5%	(486.34)	(486.34)	(30.66)	(30.66)

1.1.2 利率风险

本集团因利率变动而引起的金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2024 年 12 月 31 日，本集团浮动利率借款金额为人民币 927,144,879.16 元。(2023 年 12 月 31 日：人民币 754,364,968.53 元)。本集团的政策是保持现有借款的利率情况。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：

项目	利率变动	人民币元			
		本年度		上年度	
		对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
长期借款	增加 0.3%	(2,781,434.64)	(2,781,434.64)	(2,263,094.91)	(2,263,094.91)
长期借款	减少 0.3%	2,781,434.64	2,781,434.64	2,263,094.91	2,263,094.91

1.2 信用风险

于 2024 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团于每个资产负债表日审核应收款及合同资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

于 2024 年 12 月 31 日，按欠款方归集的年末集团前五名的应收账款及长期应收知识产权授权费余额合计为人民币 446,823,331.63 元(2023 年：人民币 436,720,287.61 元)，占应收账款总余额的比例分别为 34.46 %(2023 年：36.92%)。本公司管理层已对上述客户的信用风险进行单独评估并

相应计提预期信用损失。除上述客户外，本公司无其他重大信用集中风险。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债及租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元			
2024年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上
应付账款	163,165,886.05	-	-
其他应付款	81,335,178.31	-	-
租赁负债(含一年内到期)	38,919,221.08	47,001,595.56	-
长期应付款(含一年内到期)	89,595,888.83	76,944,280.75	-
长期借款(含一年内到期)	311,693,951.87	730,456,049.09	102,096,616.67
合计	684,710,126.14	854,401,925.40	102,096,616.67
2023年12月31日			
应付账款	96,068,423.33	-	-
其他应付款	27,711,609.92	-	-
租赁负债(含一年内到期)	20,660,343.83	24,519,554.86	-
长期应付款(含一年内到期)	51,839,881.99	37,052,890.07	-
长期借款(含一年内到期)	94,753,625.44	553,511,151.31	106,100,191.78
合计	291,033,884.51	615,083,596.24	106,100,191.78

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		112,275,721.57	201,122,863.23	313,398,584.80
（一）交易性金融资产				
(1)银行理财产品投资		82,224,721.57		82,224,721.57
(2)结构性存款投资		30,051,000.00		30,051,000.00
（二）其他非流动金融资产				
(1)权益工具投资	-	-	201,122,863.23	201,122,863.23
持续以公允价值计量的资产总额		112,275,721.57	201,122,863.23	313,398,584.80

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

项目	2024 年 12 月 31 日的公允价值	2023 年 12 月 31 日的公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	82,224,721.57	-	现金流量折现法	预期收益率
结构性存款投资	30,051,000.00	400,130,371.00	现金流量折现法	预期收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	2024 年 12 月 31 的公允价值	2023 年 12 月 31 的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
权益工具投资	201,122,863.2 3	199,633,824.7 3	近期交易价格倒推 法、近期交易价格 或市场法	被投资单位最近融资 价格、波动率、情景 概率与可比公司市场 乘数

被投资单位最近融资价格、波动率与权益工具投资公允价值成正相关性。

上述第三层次公允价值计量项目变动如下：

项目	2023 年 12 月 31 日	转入 第三层次	当期利得 或损失总 额 计入损益	本年购买	2024 年 12 月 31 日	对于在 报告期末持有的 资产，计入损 益的 当期未实现利 得或 损失的变动
其他非流动金融资 产	199,633,82 4.73	-	(510,961.5 0)	2,000,000.0 0	201,122,86 3.23	(510,961.50)

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本集团之子公司构成情况，详见第十节，十、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本集团重要的合营或联营企业详见第十节，十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
芯思原	本集团的联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Wayne Wei-Ming Dai	董事长、总裁
芯思原微电子有限公司(“芯思原”)	联营企业
兆易创新科技股份有限公司(“兆易创新”)	本集团监事任该公司董事
生纳科技(上海)有限公司(“生纳科技”)	本集团总裁任该公司董事、本集团董事任该公司董事
Alphawave IP Inc. (“Alphawave”)	本集团总裁亲属任该公司董事
威视芯半导体(合肥)有限公司(“威视芯”)	本集团高管任该公司董事
DreamBig Semiconductor Inc.(“DreamBig Semi”)	本集团总裁亲属任该公司高管
至成微科技(浙江)有限公司(“至成微科技”)	本集团高管任该公司董事
上海宜心健康科技有限公司(“宜心健康”)(注1)	本集团董事曾任该公司董事
武汉环宇智行科技有限公司(“武汉环宇”)(注2)	本集团高管曾任该公司董事
湖南越摩先进半导体有限公司(“湖南越摩”)	本集团董事间接控制该公司
广州增芯科技有限公司(“广州增芯”)	本集团董事间接控制该公司并担任其董事长
鹏瞰集成电路(杭州)有限公司(“鹏瞰”)	本集团高管任该公司董事

其他说明

注1：公司董事(包括报告期内曾任职的董事)兼职担任董事的其他企业或该企业控制的企业，本公司董事已在2023年9月11日辞任相关董事职位。根据《上市公司信息披露管理办法》，自

2024 年 9 月 11 日起，本集团不再将上述公司作为本集团的关联方披露。

注 2：公司董事(包括报告期内曾任职的董事)兼职担任董事的其他企业或该企业控制的企业，本公司董事已在 2023 年 7 月 13 日辞任相关董事职位。根据《上市公司信息披露管理办法》，自 2024 年 7 月 13 日起，本集团不再将上述公司作为本集团的关联方披露。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	交易对手方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
芯思原	芯思原	研发服务	3,719,024.66	26,000,000.00	否	6,094,396.27
威视芯	威视芯杭州(注 2)	资产采购	-	23,000,000.00	否	8,424,893.41
生纳科技	生纳科技	零星采购	-	不适用	否	86,994.00
Alphawave	Alphawave	知识产权授权使用费成本	6,343,775.75	250,000,000.00	否	
	芯潮流(注 1)	知识产权授权使用费成本	33,446,181.00	同上	否	89,551,810.00
宜心健康	宜心健康	零星采购	133,551.50	不适用	否	81,610.00
武汉环宇	武汉环宇	资产采购	1,750,000.00			1,874,600.00
湖南越摩	湖南越摩	封测服务	18,190,816.70	60,000,000.00	否	1,435,954.20
鹏瞰	鹏瞰	资产采购	2,566,584.00	18,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芯思原	知识产权授权使用费收入	266,697.92	136,805.10
芯思原	芯片设计业务收入		14,469,562.03
威视芯	芯片设计业务收入		61,736.28

威视芯	知识产权授权使用收入		52,213.10
至成微科技	知识产权授权使用收入	138,354.63	185,189.48
至成微科技	芯片设计业务收入	7,154,279.39	9,447,796.11
DreamBig Semi	芯片设计业务收入	-	43,639.37
广州增芯	知识产权授权使用费收入	5,524,609.16	
兆易创新	芯片设计业务收入	7,425,281.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒适用 ☐不适用

注 1：芯潮流(珠海)科技有限公司(以下简称“芯潮流”)是 Alphawave 与北京智路管理的私募投资基金在境内设立的合资公司。芯潮流作为 Alphawave 相关 SerDes IP 主经销商，在公司与 Alphawave 合作框架协议期限内，从 2022 年起代替 Alphawave 作为公司交易对手方，向公司授权相关 SerDes IP。

注 2：威视芯半导体(杭州)有限公司(以下简称“威视芯杭州”)是威视芯 100%控股的全资子公司。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,584.13	2,933.43

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	交易对手方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芯思原	芯思原	13,703,308.39	433,075.62	10,734,710.86	265,499.54
应收账款	至成微科技	至成微科技	5,010,214.42	158,341.45	4,502,127.47	111,350.25
预付款项	芯思原	芯思原	2,027,602.56		-	
预付款项	威视芯	Whiz Display Inc	1,366,514.84		-	
预付款项	武汉环宇	武汉环宇			1,540,000.00	
预付款项	湖南越摩	湖南越摩	11,082,526.53		-	
其他	Alphawave	芯潮流			104,482,368.38	

流动资产						
------	--	--	--	--	--	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	交易对手方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Alphawave	Alphawave	3,590,805.00	-
应付账款	Alphawave	芯潮流	23,793,604.00	-
应付账款	湖南越摩	湖南越摩	6,241,539.23	411,789.60
应付账款	芯思原	芯思原	-	1,662,091.63
合同负债	广州增芯	广州增芯	5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的非流动负债	威视芯	威视芯杭州	2,440,710.00	5,164,402.34

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

本集团限售股票激励计划具体情况如下：

项目	2024 年度
年初发行在外的限制性股票期权总数	4,263,500
本年授予的限制性股票股数	-
减：本年行权的限制性股票数	443,850
减：本年失效的限制性股票数	1,738,250
年末发行在外的限制性股票总数	2,081,400
本年末发行在外的限制性股票行权价格的范围	人民币 38.53-39.00 元

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

对于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 21 日及 2022 年 10 月 27 日授予的限制性股票，本集团使用布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型确定权益工具的公允价值，股票期权授予期间输入至模型的参数如下：

项目	2020年12月25日授予
加权平均股票价格	人民币 76.10 元
加权平均行权价	人民币 38.53 元
预计波动率(注)	56.08%-57.38%
预计寿命	自授予日起 3 年
无风险利率	2.89%-3.00%
预计股息收益	-

项目	2021年8月3日授予
加权平均股票价格	人民币 72.00 元
加权平均行权价	人民币 38.53 元
预计波动率(注)	57.77%-60.13%
预计寿命	自授予日起 3 年
无风险利率	2.10%-2.75%
预计股息收益	-

项目	2021年12月20日授予
加权平均股票价格	人民币 74.80 元
加权平均行权价	人民币 38.53 元
预计波动率(注)	56.07%-61.34%
预计寿命	自授予日起 3 年
无风险利率	2.10%-2.75%
预计股息收益	-

项目	2022年1月21日授予
加权平均股票价格	人民币 63.65 元
加权平均行权价	人民币 39.00 元
预计波动率(注)	59.07%-61.32%
预计寿命	自授予日起 3 年
无风险利率	1.50%-2.75%
预计股息收益	-

项目	2022年10月27日授予
加权平均股票价格	人民币 52.51 元
加权平均行权价	人民币 39.00 元
预计波动率(注)	50.58%-57.93%

预计寿命	自授予日起 3 年
无风险利率	1.50%-2.75%
预计股息收益	-

注：预计波动率是根据本集团可比上市公司的历史股价波动计算得出。

其他说明

2020 年 12 月 25 日，本集团批准通过 2020 年限制性股票激励计划(“2020 限制性股票计划”)，对 444 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 308.20 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2021 年 8 月 3 日，2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，本集团批准通过向激励对象授予预留限制性股票的议案，对 62 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 41.20 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2021 年 12 月 20 日，2020 限制性股票计划规定的授予条件已成就，本集团批准通过向激励对象授予预留限制性股票的议案，对 27 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 35.60 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2022 年 1 月 21 日，本集团批准通过 2022 年限制性股票激励计划(“2022 限制性股票计划”)，对 1,099 名激励对象以人民币 39 元/股的授予价格拟授予 343 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

2022年10月27日，本集团2022限制性股票计划规定的2022年限制性股票授予条件已经成就，以人民币39元/股的授予价格向34名激励对象授予58.25万股限制性股票。根据计划，获得本次预留授予部分的限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	见第十节，十五、1
可行权权益工具数量的确定依据	本公司管理层的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	220,848,486.43

其他说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
限售股票激励计划	7,290,202.90	
合计	7,290,202.90	

其他说明

无。

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本承诺

人民币千元

	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	64,124	224,126

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团全资子公司 VeriSilicon EURL 于 2019 年 7 月收到前员工以公司未依法终止合同、未支付薪酬为由向法院提起诉讼，进入简易及标准诉讼程序，请求法院判决公司支付赔偿金共计欧元 246,000.00，该简易程序于 2020 年 11 月 6 日被驳回，同时标准程序仍在进行中。本集团已全额计提可能需支付的赔偿金及相关其他费用共计欧元 310,110.00。听证会已于 2021 年 4 月 20 日举行，程序聆讯要求被告提供更多证据。2021 年 12 月 10 日，法院公布一审判决，判决本公司支付赔偿金共计欧元 112,474.70，原告员工就该判决提起上诉，请求法院改判公司支付赔偿金共计欧元 143,735.72，本集团于 2022 年全额计提可能需支付的赔偿金及相关其他费用共计欧元 207,225.50。截至目前该上诉仍处于审理流程中，鉴于上诉时间较长，且受影响的因素较多，无法精准预计判决公布时间。由于终审判决尚未结束，本集团在 2024 年末依然保留了先前计提的预计负债。本集团将持续密切关注诉讼的发展情况。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

公司于2025年3月20日，通过中国证监会“关于2023年度向特定对象发行A股股票”的申请，截至本报告报出日，发行方案尚未确定。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、重要债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为一站式芯片定制服务、半导体IP授权服务及其他。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要为分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	一站式芯片定制业务	半导体 IP 授权服务	其他	合计
分部营业收入	1,581,007,195.88	735,968,407.55	4,909,969.29	2,321,885,572.72
分部营业成本	1,322,500,368.42	65,095,566.38	8,727,172.97	1,396,323,107.77
分部利润(亏损)	258,506,827.46	670,872,841.17	-3,817,203.68	925,562,464.95
税金及附加				6,397,399.29
销售费用				119,983,461.86
管理费用				122,283,801.14
研发费用				1,247,302,342.65
财务费用				7,075,790.83
加：其他收益				40,643,186.73
投资损失				-529,301.75
公允价值变动损失				-365,610.93
信用减值损失				-38,904,022.35
资产减值损失				-6,469,543.81
资产处置收益				796.50
报表营业利润				-583,104,826.43

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

人民币元

收入来源地	2024 年度	2023 年度
来源于境内的收入	1,452,767,074.34	1,806,725,972.63
来源于境外的收入	869,118,498.38	531,270,436.06
合计	2,321,885,572.72	2,337,996,408.69

人民币元

资产所在地	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
位于境内的非流动资产	1,462,819,767.50	1,127,124,078.77
位于境外的非流动资产	315,786,472.66	316,719,824.23
合计	1,778,606,240.16	1,443,843,903.00

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
小于 6 个月	1,295,809,141.19	1,439,811,330.54
6 个月至 1 年	13,513,744.35	107,276,502.37
1 年以内小计	1,309,322,885.54	1,547,087,832.91
1 至 2 年	144,894,875.17	29,801,665.82
2 至 3 年	28,114,278.32	5,490,578.82
3 年以上		
3 至 4 年	4,990,578.82	-
4 至 5 年	-	694,300.00
5 年以上	1,782,102.70	1,087,802.70
合计	1,489,104,720.55	1,584,162,180.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	30,776,487.11	2.07	30,776,487.11	100.00	-	12,624,132.80	0.80	12,624,132.80	100.00	-

其中：										
单 项 计 提	30,776,487.11	2.07	30,776,487.11	100.00	-	12,624,132.80	0.80	12,624,132.80	100.00	-
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,458,328,233.44	97.93	65,505,439.04	4.49	1,392,822,794.40	1,571,538,047.45	99.20	53,366,633.17	3.40	1,518,171,414.28
其中：										
R 1	611,018,251.68	41.03	19,969,996.95	3.27	591,048,254.73	722,531,134.56	45.61	17,870,223.47	2.47	704,660,911.09
						3,689,178.04	0.23	9,146.31	0.25	3,680,031.73
R 6	3,206,278.06	0.22	1,821,962.26	56.82	1,384,315.80	900,000.00	0.06	507,389.73	56.38	392,610.27
R 7	756,063,527.09	50.77		-	756,063,527.09	774,816,217.69	48.91			774,816,217.69
R 8	88,040,176.61	5.91	43,713,479.83	49.65	44,326,696.78	69,601,517.16	4.39	34,979,873.66	50.26	34,621,643.50
合 计	1,489,104,720.55	/	96,281,926.15	/	1,392,822,794.40	1,584,162,180.25	/	65,990,765.97	/	1,518,171,414.28

按单项计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款单项计提坏账准备	30,776,487.11	30,776,487.11	100.00	公司认为存在重大财务困难的客户相应的应收账款以及存在重大逾期的应收账款已发生信用减值，并单项计提了减值准备。
合计	30,776,487.11	30,776,487.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
R1	611,018,251.68	19,969,996.95	3.27
R6	3,206,278.06	1,821,962.26	56.82
R7	756,063,527.09	-	0.00
R8	88,040,176.61	43,713,479.83	49.65
合计	1,458,328,233.44	65,505,439.04	4.49

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司对非集团内关联方客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)，并确定各评级应收账款的预期损失率。本公司基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计数
2024 年 1 月 1 日余额	17,879,369.78	48,111,396.19	65,990,765.97
转入已发生信用减值	(805,094.99)	805,094.99	-
本年计提预期信用损失	2,895,722.16	27,628,060.01	30,523,782.17
本年转回预期信用损失	-	(232,621.99)	(232,621.99)
2024 年 12 月 31 日	19,969,996.95	76,311,929.20	96,281,926.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收账款 坏账准备	65,990,765.97	30,523,782.17	232,621.99			96,281,926.15
合计	65,990,765.97	30,523,782.17	232,621.99			96,281,926.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	其他非流动 资产-应收知 识产权授权 费年末余额	应收账款、合同 资产和其他非流 动资产-应收知 识产权授权费期 末余额	占应 收账 款、合 同资 产和 其他 非流 动资 产-应 收知 识产 权授 权费 期末 余额 合计 数的 比例 (%)	坏账准备期 末余额
客 户 一	463,689,518.52			463,689,518.52	25.02	
客 户 二	247,351,439.13			247,351,439.13	13.35	
客 户 三	89,521,494.75	17,970,281.21	33,916,609.76	141,408,385.72	7.63	4,550,711.89

客 户 四	61,789,973.95	12,832,533.13	49,008,606.40	123,631,113.48	6.67	3,978,615.38
客 户 五	59,366,889.52	23,923,773.35	-	83,290,662.87	4.49	41,723,871.89
合 计	921,719,315.87	54,726,587.69	82,925,216.16	1,059,371,119.72	57.16	50,253,199.16

其他说明
无。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	313,827.39	7,009,130.34
合计	313,827.39	7,009,130.34

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(5). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(6). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(10). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(11). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
小于 6 个月	208,604.00	3,918,076.42
6 个月至 1 年	-	3,153,487.65
1 年以内小计	208,604.00	7,071,564.07
1 至 2 年	19,200.00	5,000.00

2 至 3 年	5,000.00	38,705.00
3 年以上		
3 至 4 年	38,705.00	4,000.00
4 至 5 年	4,000.00	-
5 年以上	41,650.00	46,150.00
合计	317,159.00	7,165,419.07

(12). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项(注)	208,604.00	3,884,076.42
应收押金、备用金及暂支款	108,555.00	147,055.00
代客户支付的特许权使用费		3,073,636.36
其他		60,651.29
合计	317,159.00	7,165,419.07

(13). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	未来 12 个月内 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值)	合计数
2024 年 1 月 1 日余额	156,288.73	-	-	156,288.73
本年计提	26.33	-	-	26.33
本年转回	(152,983.45)	-	-	(152,983.45)
2024 年 12 月 31 日余 额	3,331.61	-	-	3,331.61

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(14). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	156,288.73	26.33	152,983.45			3,331.61

坏账准备						
合计	156,288.73	26.33	152,983.45			3,331.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

(15). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(16). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	208,604.00	65.77	应收关联方款项	小于 6 个月	-
第二名	38,076.00	12.01	应收押金、备用金及暂支款	3 至 4 年	1,873.04
第三名	20,000.00	6.31	应收押金、备用金及暂支款	大于 5 年	983.85
第四名	19,200.00	6.05	应收押金、备用金及暂支款	1 至 2 年	8.51
第五名	15,000.00	4.73	应收押金、备用金及暂支款	大于 5 年	6.65
合计	300,880.00	94.87	/	/	2,872.05

(17). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	835,660,428.16		835,660,428.16	834,048,681.20		834,048,681.20
对联营、合营企业投资	1,000,436.21		1,000,436.21	5,056,691.28		5,056,691.28
合计	836,660,864.37		836,660,864.37	839,105,372.48		839,105,372.48

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
芯原北京	5,061,914.26					-225,875.13	4,836,039.13	
芯原成都	28,858,977.83					2,657,291.40	31,516,269.23	
图芯上海	9,415,491.37						9,415,491.37	
VeriSilicon Cayman	241,085,981.99					-959,730.57	240,126,251.42	
芯原南京	30,655,062.59					140,061.26	30,795,123.85	
芯原海南	18,971,253.16						18,971,253.16	
芯原科技	500,000,000.00						500,000,000.00	
合计	834,048,681.20					1,611,746.96	835,660,428.16	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业											
芯思原	5,056,691.28			-5,686,541.33		629,850.05				-	
芯展科技		1,000,000.00		436.21						1,000,436.21	
小计	5,056,691.28	1,000,000.00		-5,686,105.12		629,850.05				1,000,436.21	
合计	5,056,691.28	1,000,000.00		-5,686,105.12		629,850.05				1,000,436.21	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

芯原上海在2016年6月分别从VeriSilicon Limited集团内公司VeriSilicon Cayman、VeriSilicon Hong Kong、Vivante US购买了芯原北京、芯原成都、图芯上海100%的股权。于合并日，芯原北京在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值为负，因此该长期股权投资的初始投资成本为零；芯原成都和图芯上海的长期股权投资的初始投资成本按照其合并日在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值确认。2016年12月，芯原上海对芯原成都追加投资人民币6,881,400.00元。

2018年5月芯原上海、芯原上海子公司VeriSilicon Shanghai Merger Sub Limited(“Merger Sub”)、VeriSilicon Limited以及VeriSilicon Cayman签订收购计划协议，由Merger Sub向VeriSilicon Limited收购其持有的VeriSilicon Cayman的100%股份，收购价格为美元1.73亿元，Merger Sub与VeriSilicon Cayman吸收合并，VeriSilicon Cayman为合并后的存续公司，最终成为芯原上海的全资子公司。

芯思原系2018年9月本公司参与投资的联营企业，因芯思原为本公司的联营企业，故采用权益法核算。

芯原南京成立于2020年05月08日，由芯原上海发起设立，为其全资子公司，注册资本人民币100,000,000.00元。截至2024年12月31日，芯原上海实际货币出资人民币30,000,000.00元。

芯原海南成立于2020年12月17日，由芯原上海发起设立，为其全资子公司，注册资本人民币50,000,000.00元。截至2024年12月31日，芯原上海实际货币出资人民币26,000,000.00元。

芯原科技成立于2021年10月29日，由芯原上海发起设立，为其全资子公司，注册资本人民币500,000,000.00元。截至2024年12月31日，芯原上海实际货币出资人民币500,000,000.00元。

根据本集团对股权激励计划中约定的业绩考核目标的实际完成情况及未来达标的预测，本年度冲回子公司预期未完成业绩考核批次的累计已确认的股份支付费用，相应减少母公司芯原上海长期股权投资。

芯展科技系 2024 年 9 月本公司参与投资的联营企业，因芯展科技为本公司的联营企业，故采用权益法核算。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,458,606,275.25	897,614,938.74	1,629,620,357.27	889,871,015.21
其他业务				
合计	1,458,606,275.25	897,614,938.74	1,629,620,357.27	889,871,015.21

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,458,606,275.25	897,614,938.74
合计	1,458,606,275.25	897,614,938.74

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
芯片量产业务收入	根据合同约定的交付条款在交货时或签收时履行履约义务	根据具体合同约定	货物	是	0.00	产品质量保证
芯片设计业务收入	在某一时段内履行履约义务	根据具体合同约定	服务	是	0.00	无
知识产权授权使用费收	在交付知识产权授权许可	根据具体合同约定	知识产权使用许可	是	0.00	无

入	可产品时履行履约义务					
特许权使用费收入	在客户使用行为实际发生时履行履约义务	根据具体合同约定	版税	是	0.00	无
合计	/	/	/	/	0.00	/

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-5,686,105.12	-32,757,234.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,980,536.80	696,743.34
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-1,705,568.32	-32,060,490.96

其他说明：

无。

6、其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	796.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	43,064,097.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,791,192.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,222,111.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

联营企业收到的政府补助	897,200.21	
减：所得税影响额	7,427,581.96	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	42,547,816.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

无。

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-24.98	-1.20	-1.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.75	-1.29	-1.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用